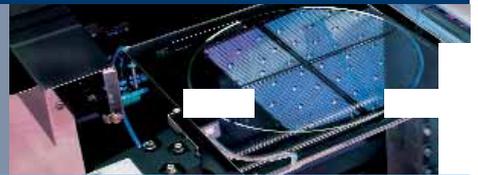
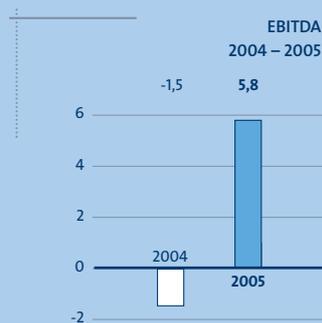
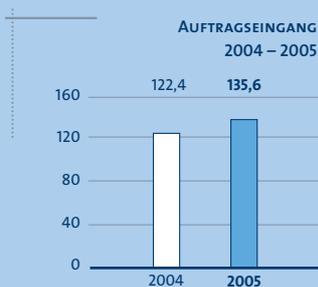
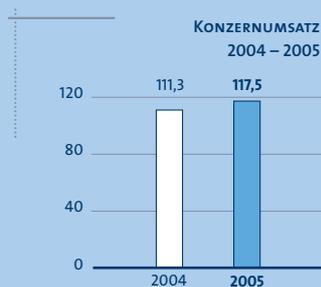


Geschäftsbericht 2005



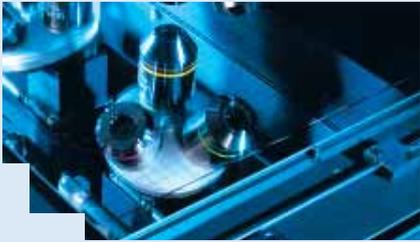
SÜSS MICROTEC AUF EINEN BLICK

in Mio. Euro	2005	2004	Veränderung in %
Umsatz und Auftragslage			
Auftragseingang	135,6	122,4	10,8 %
Auftragsbestand zum 31.12.	85,1	65,6	29,7 %
Umsatz gesamt	117,5	111,3	5,6 %
<i>Umsatz Europa</i>	41,6	32,5	27,9 %
<i>Umsatz Nordamerika</i>	42,1	31,8	32,5 %
<i>Umsatz Japan</i>	7,7	15,6	-50,9 %
<i>Umsatz sonstiges Asien</i>	26,1	30,9	-15,5 %
<i>Umsatz Rest of the World</i>	0,0	0,5	-100,0 %
Umsatzrendite in %	-7,0 %	-14,7 %	-
Rohertrag	47,0	47,2	-0,5 %
Rohertragsmarge	40,0 %	42,4 %	-
Herstellungskosten	70,6	64,1	10,1 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	9,0	8,5	5,9 %
EBITDA	5,8	-1,5	481,6 %
EBITDA-Marge	4,9 %	-1,4 %	-
EBIT	-4,2	-8,8	51,8 %
EBIT-Marge	-3,6 %	-7,9 %	-
Ergebnis nach Steuern	-8,2	-16,4	49,8 %
Ergebnis je Aktie	-0,52	-1,08	51,9 %
Bilanz			
Eigenkapital	84,2	83,4	0,9 %
Eigenkapitalquote	53,5 %	49,5 %	-
Eigenkapitalrentabilität	-9,8 %	-19,6 %	-
Bilanzsumme	157,3	168,4	-6,6 %
Net Cash	7,5	-1,0	824,6 %
Free Cash Flow	1,9	-1,5	227,7 %
Weitere Kennzahlen			
Investitionen	6,0	3,3	83,7 %
Investitionsquote	5,1 %	2,9 %	-
Abschreibungen	10,0	7,2	38,3 %
Mitarbeiter zum 31.12.	674	731	-7,8 %



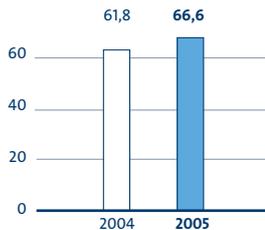
SEGMENTE

LITHOGRAFIE

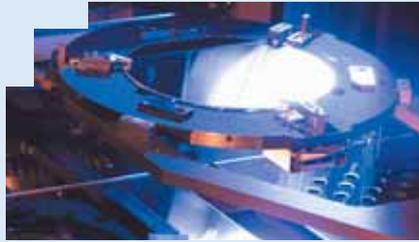


Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Produktionslinien Mask Aligner, Coater und Developer. Dieses Segment stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts der SÜSS-Gruppe dar und hat das größte Wachstumspotenzial. Adressierte Märkte: Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter.

SEGMENTUMSATZ
2004 – 2005

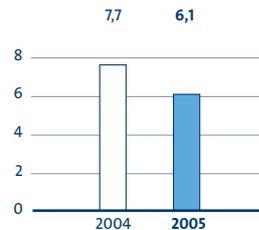


SUBSTRAT BONDER



Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Substrat Bondern, die zwei oder mehrere Trägermaterialien (Substrate) – meist Wafer – miteinander verbinden. Derzeit Phase der Marktdurchdringung. Anwendungen des Wafer Bondings werden in Zukunft wachsen. Adressierter Markt: Mikrosystemtechnik.

SEGMENTUMSATZ
2004 – 2005

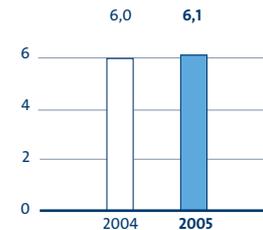


DEVICE BONDER



Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Device Bondern, die einzelne Elektronik-Bausteine hochgenau miteinander verbinden. Aufgrund der technischen Komplexität und der geringen Marktgröße schwächstes Segment der SÜSS-Gruppe. Adressierter Markt: Optoelektronik.

SEGMENTUMSATZ
2004 – 2005

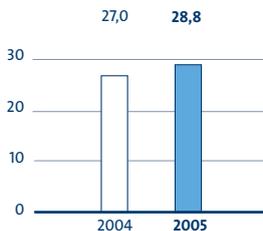


TEST SYSTEME

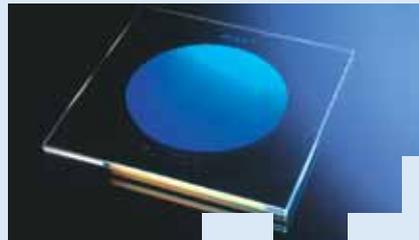


Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Test- und Prüfsystemen. Wenig zyklischer Geschäftsverlauf, moderates aber nachhaltiges Wachstum. Dieses Segment stellt rund ein Viertel des Geschäftsvolumens der SÜSS-Gruppe dar. Adressierte Märkte: Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter, Forschungsbereiche Chipproduktion.

SEGMENTUMSATZ
2004 – 2005

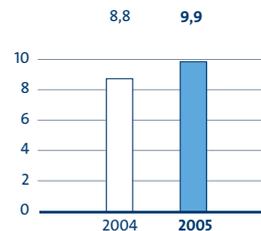


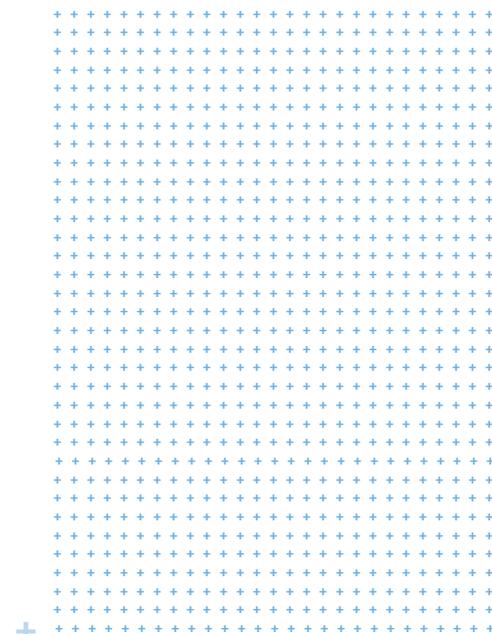
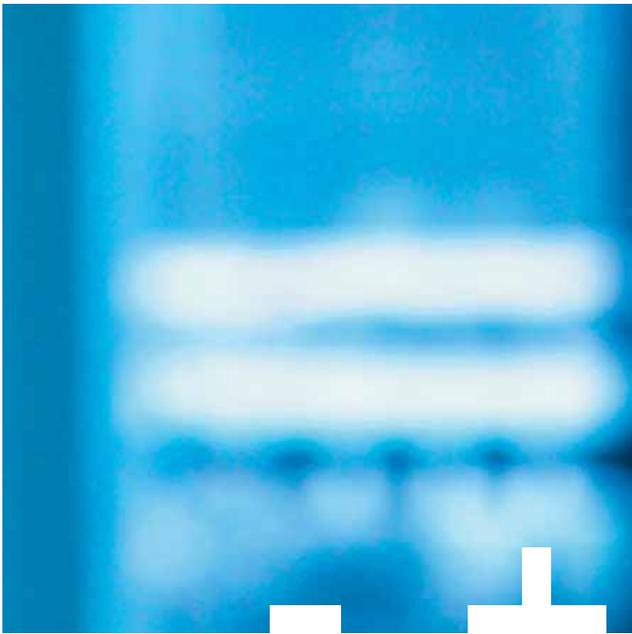
SONSTIGE



Beinhalten vor allem unser Geschäft mit den Masken für die Halbleiterindustrie in Palo Alto, USA. Daneben sind hier die Aktivitäten in der Mikrooptik (Neuchatel, Schweiz) und sonstige Bereiche angesiedelt. Auch das Geschäftsfeld C4NP ist derzeit in diesem Segment berücksichtigt – bis C4NP eine gewisse Umsatzgröße erreicht.

SEGMENTUMSATZ
2004 – 2005





INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

- 04 Vorwort des Vorstands
- 06 Bericht des Aufsichtsrats

INVESTOR RELATIONS

- 10 Die SÜSS MicroTec-Aktie
- 13 Corporate Governance Bericht
- 17 Unternehmenskalender

ÜBER UNS

- 20 Highlights 2005
- 22 Unsere Strategie
- 23 Nachhaltigkeit

CONSUMER MARKETS

- 24 SÜSS MicroTec-Produkte
- 25 SÜSS MicroTec macht das Leben leichter

LAGEBERICHT

- 30 Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
- 31 Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
- 32 Forschung und Entwicklung
- 34 Überblick über den Geschäftsverlauf
- 42 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- 48 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
- 48 Umwelt
- 49 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- 49 Risikobericht
- 57 Vorausschauende Aussagen

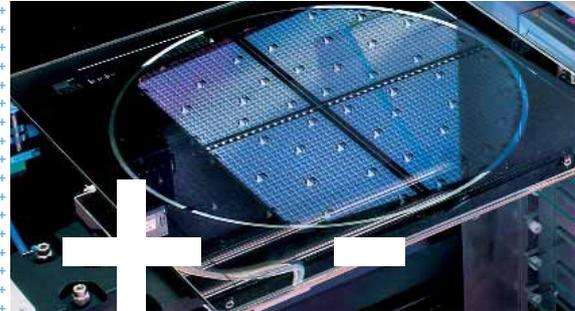
KONZERNABSCHLUSS

- 58 Konzerngewinn- und Verlustrechnung
- 59 Konzernbilanz
- 60 Konzernkapitalflussrechnung
- 62 Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung
- 64 Entwicklung des Konzernanlagevermögens 2005
- 66 Entwicklung des Konzernanlagevermögens 2004
- 68 Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern
- 68 Segmentinformationen nach Regionen
- 70 Anhang
- 113 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

- 114 Glossar
- 116 Kontakt



UNTERNEHMENSPROFIL



SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Hersteller von innovativem Produktions-, Verarbeitungs- und Test-Equipment für die Halbleiterbranche. Zum Produktportfolio gehören Beschichtungs- und Entwicklungssysteme, Vollfeld-Lithografiesysteme, Substrat Bonder, Device Bonder sowie Test- und Prüfsysteme.

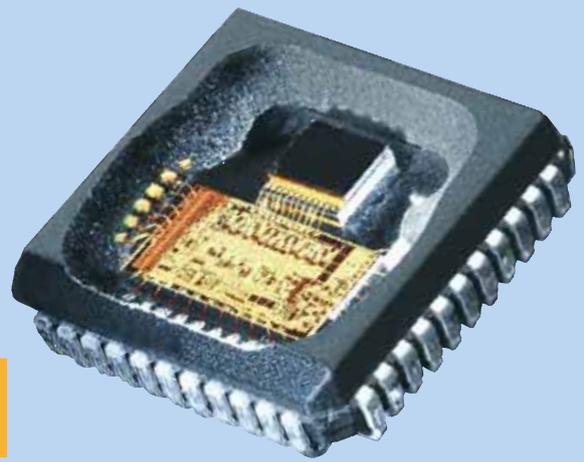
SÜSS MicroTec bedient hauptsächlich attraktive Märkten wie Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter. Bis heute wurden weltweit über 7.000 Systeme installiert.

Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec befindet sich in Garching bei München. Zum Konzern gehören sechs Produktionsstätten. Support bietet SÜSS MicroTec durch zahlreiche Verkaufs- und Servicezentren in Nordamerika, Europa und Asien.

Mit dem Mask Aligner hat bei SÜSS in den 50er Jahren alles begonnen. Der hier abgebildete MA300Plus erreicht Strukturen-„Größen“ von unter einem Mikrometer. Ein Mikrometer entspricht einem Tausendstel Millimeter – solche Dimensionen erfordern Präzisionsarbeit auf höchstem Niveau. Genau diese wird auch von den Sensoren erwartet, die mit Hilfe des Mask Aligners produziert werden.



Vom Mask Aligner...



...über den Chip...



...zum Airbag

+++ Airbags gehören mittlerweile zur Serienausstattung eines jeden Fahrzeugs. Im Streben nach immer weiterer Verbesserung der Sicherheit für die Fahrzeuginsassen werden ständig neue Airbags entwickelt und verarbeitet.

++

+



+ + Dr. Stefan Schneidewind, Vorstandsvorsitzender + +

VORWORT DES VORSTANDS

LIEBE AKTIONÄRE, MITARBEITER UND GESCHÄFTSPARTNER DER SÜSS MICROTEC AG,

SÜSS MicroTec hat ein ereignisreiches Jahr 2005 hinter sich. Es war in vielerlei Hinsicht ein Jahr des Wandels. Einerseits ist der Konzern durch einen Restrukturierungsprozess gegangen, der planmäßig im Geschäftsjahr 2005 endete. Die notwendige Schließung des Werkes im hessischen Aßlar ist abgewickelt, an den Standorten Garching bei München und Vaihingen wurden Prozesse optimiert. Der SÜSS MicroTec-Konzern ist dadurch effizienter geworden und wird moderner geführt. Kosten und Wertberichtigungen, die unter anderem auch in diesem Zusammenhang angefallen sind, haben das Ergebnis belastet. Andererseits erzielten wir im vierten Quartal mit rund 51 Millionen Euro den höchsten Auftragszugang seit dem zweiten Quartal 2001. Insgesamt blicken wir zuversichtlich in 2006 und sind überzeugt, dass wir mit der aktuellen Kostenbasis und der erfreulichen Auftragsituation auf dem richtigen Weg sind, wieder ein positives Ergebnis zu erreichen.

Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2005 haben wir die Rechnungslegung von US-GAAP auf International Financial Reporting Standards („IFRS“) umgestellt. In Folge dessen ergeben sich bei den Bilanz- und Ergebniskennzahlen Veränderungen im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen.

2005 erzielten wir rund 118 Millionen Euro Umsatz und damit knapp 6 Prozent mehr als im Vorjahr (111 Millionen Euro). Wegen erfolgreicher Endabnahmen von Kundenprojekten konnten wir unsere Umsatzprognose für 2005 von 107 Millionen Euro deutlich übertreffen. Der Auftragseingang, der wohl wichtigste Erfolgsindikator in unserer Branche, lag 2005 bei rund 136 Millionen Euro. Das sind 11 Prozent mehr als im Vorjahr (122 Millionen). Der Auftragsbestand stieg von rund 66 Millionen Euro im Vorjahr um 30 Prozent auf 85 Millionen Euro zum 31.12.2005. Diese positiven Entwicklungen zeigen die starke Nachfrage nach SÜSS MicroTec-Produkten und sind auch repräsentativ für den Geschäftsverlauf der Halbleiter-Ausrüster allgemein.

Da 2005 nochmals signifikante Sondereffekte anfielen, erzielten wir noch kein positives Ergebnis. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 8,2 Millionen Euro gegenüber minus 16,4 Millionen Euro in 2004. Auch das operative Ergebnis (EBIT) war mit minus 4,2 Millionen Euro negativ (2004: minus 8,8 Millionen Euro). Erfreulich ist, dass das Geschäftsjahr 2005 – erstmals seit 2001 – mit einem positiven EBITDA (5,8 Millionen Euro gegenüber minus 1,5 Millionen Euro 2004) abgeschlossen wurde.

► VORWORT DES
VORSTANDS

BERICHT DES
AUF SICHTSRATS



Stephan Schulak, Finanzvorstand

In den nächsten Jahren wollen wir profitabel wachsen. Dabei setzen wir unverändert auf unsere Hauptmärkte: Mikrosystemtechnik, Advanced Packaging und Verbindungshalbleiter. Ein großes deutsches Wirtschaftsmagazin kürte Ende 2005 zehn Technologien, die den Alltag erobern werden. An der Entwicklung und Herstellung fast all dieser Innovationen sind Equipment und Know-how von SÜSS MicroTec beteiligt. Einige Beispiele: Leuchtdioden (LEDs), Navigationssysteme in Handys, Fahrerassistenzsysteme in Autos. Diese Technologien sind nur dank Mikrosystemtechnik (Sensoren) oder modernen Chipverbindungen (Advanced Packaging) möglich. Für die Zukunft planen wir ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich zehn Prozent im Kerngeschäft.

Zusätzliche attraktive Wachstumschancen sehen wir in C4NP: In Kooperation mit IBM entwickeln wir derzeit das Produktions-Equipment. C4NP ermöglicht noch effizientere und umweltgerechte – weil bleifreie – Chip-Verbindung mit Advanced Packaging.

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG, wir möchten uns für Ihr Vertrauen in der Vergangenheit bedanken. Unseren Mitarbeitern sagen wir Dank für ihr großes Engagement und die kritisch-konstruktive Begleitung von Restrukturierung und Zukunftsausrichtung des Unternehmens. Bei unseren Aktionären bedanken wir uns für die Treue und das langjährige Interesse; wir werden auch weiterhin unsere offene und intensive Investor Relations-Arbeit fortsetzen und allen Aktionären größtmögliche Transparenz bieten.

Garching, im März 2006

Dr. Stefan Schneidewind
Vorstandsvorsitzender

Stephan Schulak
Finanzvorstand





+ + + Dr. Winfried Süss, Aufsichtsratsvorsitzender + + +

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2005 regelmäßig durch laufende schriftliche Berichterstattung sowie in sechs gemeinsamen Sitzungen zeitnah und umfassend vom Vorstand über den Geschäftsverlauf und die Planung der Gesellschaft und des SÜSS MicroTec-Konzerns unterrichten lassen und wesentliche Fragen der Geschäftsführung mit dem Vorstand erörtert. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand beraten und die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands überwacht. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen vom 22. März, 21. Juni, 26. September und 19. Dezember 2005 die eingetretenen Abweichungen des tatsächlichen Geschäftsverlaufs einschließlich des Auftragseingangs von der Planung und die dafür maßgeblichen Gründe ausführlich mit dem Vorstand erörtert. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über wichtige Geschäftsvorfälle, die sonstigen berichtspflichtigen Umstände und die von ihm für das Risikomanagement getroffenen Maßnahmen sowie über erkennbar gewordene geschäftliche Risiken unterrichtet.

In seiner Sitzung vom 22. März 2005 hat sich der Aufsichtsrat daneben schwerpunktmäßig mit dem Jahresabschluss 2004, der Vorbereitung der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005, der Personalentwicklung auf der zweiten Führungsebene der SÜSS-Gruppe und einem bei der SÜSS Microtec Lithography GmbH („SMTL GmbH“) durchgeführten Restrukturierungsprogramm befasst.

Eine am 15. Juni 2005 abgehaltene Sitzung des Aufsichtsrats stand ganz im Zeichen der strategischen Ausrichtung der Unternehmensgruppe.

Am 21. Juni 2005 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen statt. In der ersten Sitzung wurden die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die Restrukturierungsmaßnahmen bei der SMTL GmbH erörtert und Beschlüsse zu Personalangelegenheiten gefasst. In seiner zweiten Sitzung vom selben Tag bestätigte der Aufsichtsrat

seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter und regelte die Zusammensetzung seiner Ausschüsse.

Am 26. September 2005 bildeten erneut die laufende Geschäftsentwicklung und das Restrukturierungsprogramm bei der SMTL GmbH den Schwerpunkt der Beratung des Aufsichtsrats.

Demgegenüber standen in der Sitzung vom 19. Dezember 2005 der Ausblick auf den Jahresabschluss 2005 und die Diskussion der Unternehmensplanung für 2006 im Mittelpunkt der Diskussion des Aufsichtsrats. Zudem richtete der Aufsichtsrat einen Technologieausschuss ein, dem die Herren Heinz, Prof. Dr. Heuberger und Dr. Süss (Vorsitzender) angehören.

Mit Ablauf der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 schied Herr Dr. Thomas Sesselmann aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat dankt ihm für seine jahrelange engagierte Mitarbeit. Die SÜSS-Gruppe schuldet Herrn Dr. Sesselmann Dank für zahlreiche wertvolle Ratschläge und Hinweise. Die Hauptversammlung hat am 21. Juni 2005 Herrn Peter Heinz, M.B.A. aus Waterbury, Vermont, USA an Stelle von Herrn Dr. Sesselmann zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats, dem Herr Dr. Süss als Vorsitzender sowie die Herren Schlytter-Henrichsen und Dr. e. h. Görtz als Mitglieder angehören, hat sich in drei Sitzungen mit Personalangelegenheiten des Vorstands befasst, die Entscheidungen des Aufsichtsrats in Personalangelegenheiten vorbereitet und dem Gesamtaufichtsrat über das Ergebnis seiner Beratungen berichtet.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, dem Herr Schlytter-Henrichsen als Vorsitzender sowie die Herren Dr. Schücking und Dr. Süss als weitere Mitglieder angehören, hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in drei Sitzungen unter anderem mit



VORWORT DES
VORSTANDS► BERICHT DES
AUFSICHTSRATS

folgenden Fragen befasst:

- Auftrag an den Abschlussprüfer;
- Unabhängigkeit des Abschlussprüfers;
- Vergütung des Abschlussprüfers;
- Rationalisierungsmaßnahmen;
- Projekt C4NP; sowie
- Finanzierung der SÜSS MicroTec-Gruppe (einschließlich der Kapitalerhöhung 2005).

In diesen Angelegenheiten hat der Prüfungsausschuss die Entscheidungen des Gesamtaufwirtsrats vorbereitet und den Gesamtaufwirtsrat über das Ergebnis seiner Beratungen unterrichtet.

Die Sitzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrats haben teilweise in Form von Telefonkonferenzen stattgefunden.

In seiner Sitzung vom 19. Dezember 2005 hat der Aufsichtsrat erneut die Effizienz seiner Tätigkeit überprüft. Interessenkonflikte zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Gesellschaft sind bei der Arbeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2005 nicht zu Tage getreten.

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005, der nach den als IFRS bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2005, der Lagebericht und der Konzernlagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2005 wurden durch den von der Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Jahresabschluss der

Gesellschaft zum 31. Dezember 2005 sowie den gemäß § 315 a des Handelsgesetzbuchs nach den als IFRS bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellten Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2005, den Lagebericht und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2005 geprüft. An der Verhandlung des Aufsichtsrats über die genannten Vorlagen haben die beiden zuständigen Wirtschaftsprüfer des Abschlussprüfers teilgenommen. Sie haben dem Aufsichtsrat mündlich über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat die genannten Vorlagen und die Feststellungen des Abschlussprüfers mit den Vertretern des Abschlussprüfers und dem Vorstand erörtert und die Vorlagen gebilligt. Der Aufsichtsrat erklärt hiermit, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung gegen die von ihm geprüften Vorlagen keine Einwendungen zu erheben sind. Auch die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind aus der Sicht des Aufsichtsrats nicht zu beanstanden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2005 ist damit festgestellt. Mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2005 ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsgesellschaften für ihren im Geschäftsjahr 2005 gezeigten Einsatz für die Gesellschaft und den SÜSS MicroTec-Konzern.

Garching, im März 2006

Der Aufsichtsrat



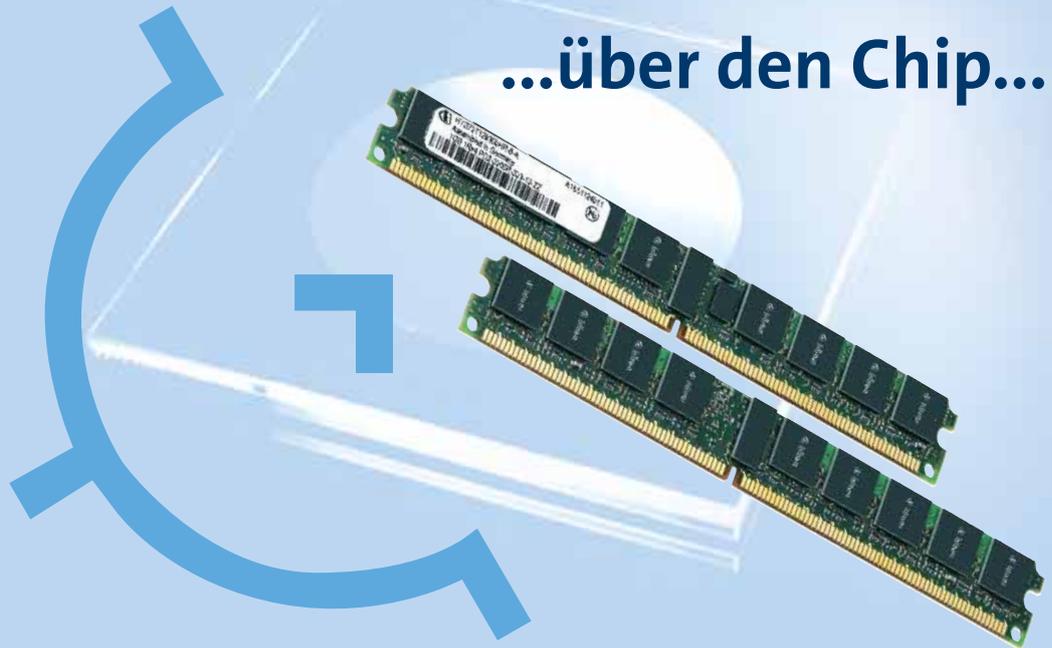
Dr. Winfried Süß
Vorsitzender

Der LithoPack300 ist die größte Anlage im SÜSS MicroTec-Produktportfolio. Hier sind die Prozessschritte Beschichtung, Belichtung und Entwicklung in einem Gerät vereint. Wafer mit einem Durchmesser von 300 Millimetern, auf welchen sich Tausende Chips befinden, werden vollautomatisch prozessiert. Das spart Zeit und Kosten und garantiert erstklassige Ergebnisse. ++



Vom **LithoPack 300**

...über den Chip...



...zum Notebook

+ + Kleine, leichte, leistungsstarke und dennoch erschwingliche Notebooks machen nicht nur Geschäftsleute mobil, sondern ermöglichen auch einen kleinen Online-Chat aus dem Café oder ein spannendes Spiel unterwegs.

+ +

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE

ENTWICKLUNG DER AKTIENMÄRKTE WELTWEIT

Die wichtigsten Indizes befanden sich im Aufwind. Während die amerikanischen Aktienmärkte (Dow Jones: minus 0,6 Prozent) uneinheitlich schlossen, konnten die Indizes in Japan (Nikkei 225: plus 40,6 Prozent) und in Europa (Euro STOXX 50: plus 20,6 Prozent) zum Teil deutliche Kursaufschläge verzeichnen. Der deutsche Aktienmarkt entwickelte sich ungeachtet eines schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds äußerst erfreulich. Hauptursachen hierfür waren das niedrige Bewertungsniveau deutscher Aktien im internationalen Vergleich, positive Unternehmensnachrichten nach umfangreichen Restrukturierungen und Bilanzbereinigungen in den Vorjahren sowie vielschichtige Erwartungen im Zusammenhang mit den im Mai 2005 überraschend angekündigten Bundestagsneuwahlen.

ÖLPREIS DOMINIERT DIE BÖRSEN WELTWEIT

Der Ölpreis ist 2005 stetig gestiegen. Damit rückten Aktien aus dem Segment erneuerbare Energien (Solar, Wind und nachwachsende Rohstoffe) in den Fokus vieler Anleger. Halbleiterunternehmen konnten diesem Trend nicht folgen und entwickelten sich im Vergleich schwächer. Insbesondere Unternehmen, die im Prime Standard in der Industriegruppe „Semiconductor“ gelistet sind, mussten einen Abschlag von durchschnittlich 9 Prozent hinnehmen.

TECDAX OHNE SÜSS MICROTEC

Die SÜSS MicroTec-Aktie entwickelte sich im Jahresverlauf 2005 schwächer als die Vergleichsindizes. Im Juni 2005 wurde im Rahmen der Neuordnung des TecDAX die SÜSS MicroTec-Aktie aus diesem Auswahlindex genommen. Grund war die unterdurchschnittliche Entwicklung der Marktkapitalisierung. Kapitalmarktteilnehmer zeigten sich vom Jahresergebnis 2004, den angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen und dem Ausblick für 2005 enttäuscht. Obgleich im Jahresverlauf Erfolge im C4NP-Geschäft und in der Neuausrichtung vermeldet werden konnten, war der Kursverlauf schwach. Im Januar 2006 vermeldeten wir für das vierte Quartal 2005 einen überaus hohen Auftragseingang sowie eine deutliche Umsatzsteigerung. Der Kurs stieg daraufhin allein im Januar 2006 um rund 54 Prozent an und ließ die Vergleichsindizes deutlich hinter sich.

HOHES INTERESSE AN DER KAPITALERHÖHUNG

Im August 2005 führten wir eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für bis zu 1.456.084 Stückaktien durch. Der Bezugspreis betrug 4,90 Euro pro Aktie. 644.571 Stückaktien wurden auf Grund des Bezugsrechtes bezogen. Die verbleibenden Aktien konnten bei institutionellen Investoren platziert werden. Aus dieser Kapitalerhöhung flossen dem Unternehmen rund 6,8 Millionen Euro zu.

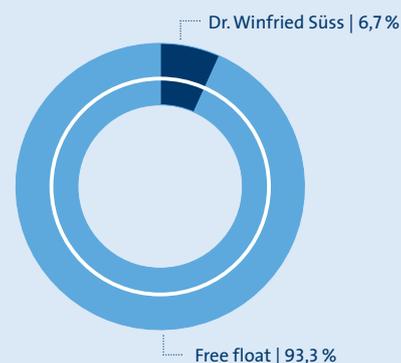
LIQUIDER HANDEL

Der durchschnittliche Tagesumsatz der SÜSS MicroTec-Aktie lag im Berichtsjahr an allen deutschen Börsen bei rund 136.545 Stück (Vorjahr: rund 87.459). Insgesamt wechselten rund 35,5 Millionen Aktien den Besitzer. Damit stieg das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen um 56 Prozent. Die Handelbarkeit ist so auch für institutionelle Anleger gewährleistet – nach Angaben der Deutschen Börse zählte die SÜSS MicroTec-Aktie 2005 zu den 20 meistgehandelten Aktien im Technologie-Segment der deutschen Börse.

ERFOLGREICHE INVESTOR RELATIONS ARBEIT

SÜSS MicroTec sucht im Sinne einer offenen dialogorientierten Kommunikation aktiv das Gespräch mit den Kapitalmarktteilnehmern. Anleger erhalten Informationen zeitnah, kontinuierlich und weitaus häufiger als lediglich zu den Pflichtterminen

AKTIONÄRSSTRUKTUR in %



SÜSS MicroTEC-AKTIE indexiert



SÜSS MicroTEC-AKTIE in Euro



der Berichtssaison. Dies ist wichtiger und wesentlicher Bestandteil einer transparenten, regelmäßigen und nachvollziehbaren Kommunikation mit dem Finanzmarkt. So intensivierten wir durch zahlreiche Maßnahmen den Kontakt mit der Financial Community: Wir trafen institutionelle Anleger an verschiedenen Finanzplätzen in Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz. Auf Roadshows präsentierten wir die Unternehmensstrategie, den Stand der Kostensenkungsmaßnahmen und die Wachstumschancen. Ferner nahmen wir an vier Investorenkonferenzen teil und der Vorstand führte zahlreiche Einzelgespräche mit Investoren.

Ziel von Investor Relations ist, neben dem weiteren Ausbau der Analysten-Coverage, die Aktionärsbasis zu verbreitern und dabei sowohl institutionelle wie auch private Anleger für die SÜSS MicroTec-Aktie zu gewinnen. Insgesamt sehen wir eine weiter erhöhte Transparenz als zentrale Herausforderungen für die Kommunikation mit den Kapitalmärkten. Obgleich wir für den

Geschäftsbericht 2004 vom LACP, San Diego, USA, dreifach ausgezeichnet wurden, werden wir die Berichtsqualität weiter verbessern. Mittel- bis langfristig ist es unser formuliertes Ziel, wieder Teil des TecDAX zu werden.

COVERAGE AUSGEWEITET

Die positive Resonanz auf einer Investorenkonferenz im Dezember und die aufwärtsgerichtete Kursentwicklung im Januar 2006 zeigt, dass es dem Vorstand gelungen ist, institutionellen Investoren das attraktive Investmentprofil der SÜSS MicroTec überzeugend zu präsentieren. Zum Anfang des Geschäftsjahres 2006 gelang es, die Deutsche Bank von der Aufnahme der Analysten-Coverage zu überzeugen. Derzeit geben acht Häuser regelmäßig Studien zu unserem Unternehmen heraus.

Einen aktuellen Stand der Analysen stellen wir unseren Anlegern unter www.suss.de zur Verfügung.

NEUE GESETZLICHE ANFORDERUNGEN UMGESETZT

Eine Herausforderung für die Investor Relations-Arbeit stellten im Jahr 2005 vor allem zwei neu eingeführte Gesetze dar: Das Gesetz zur Einführung von Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG) und das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) führten zu umfangreichen Änderungen und damit verbundenen internen Maßnahmen, vor allem im Hinblick auf die Organisation der jährlichen Hauptversammlung.

Wir bedanken uns bei allen Aktionären und Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen. In zahlreichen Einzelgesprächen haben wir auch mit unseren Privataktionären einen offenen Dialog gepflegt. Diesen wollen wir auch 2006 fortsetzen und verpflichten uns weiterhin zu höchster Transparenz und aktueller Information.

Informationen zu Aktie und Hauptversammlung, unsere Unternehmensberichte, Directors' Dealings und der Finanzkalender werden stets aktuell auf unserer Website www.suss.de veröffentlicht. Auf Wunsch versenden wir aktuelle Informationen auch gerne per E-Mail oder Post.

AKTIENKENNZAHLEN

WKN	722670
ISIN	DE 0007226706
Reuters-Kürzel	SMHG.F
Bloomberg-Kürzel	SMH GR
Anzahl ausgegebener Aktien	16.792.968
Jahresanfangskurs	5,68
Jahresschlusskurs	4,72
Prozentuale Jahresentwicklung	-16,91 %
Durchschnittliches Handelsvolumen / Tag 2005	136.545
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Designated Sponsor (ab 01.01.06)	HSBC Trinkaus & Burkhardt
Jahreshoch / -tief	3,61 / 6,35

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

UMSETZUNG

Das Ziel des Corporate Governance Regelwerks ist eine gute und verantwortliche Unternehmensführung, transparent für den Aktionär und die Öffentlichkeit. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG setzen die Standards des Regelwerks aktiv um und sehen den Corporate Governance Kodex als wichtigen Teil der Unternehmenskultur. Bereits 2002 wurde eine Corporate Governance Beauftragte berufen, die direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet.

SÜSS MicroTec war von Beginn an führend bei der Umsetzung der Corporate-Governance Richtlinien. Bereits 2004 erfüllten wir 93 Prozent aller Anforderungen und Anregungen und belegten Platz drei im Gesamtranking TecDAX einer Studie der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Seither wird die Corporate Governance in der SÜSS MicroTec AG in regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Der Corporate Governance Kodex beinhaltet derzeit über 70 Empfehlungen, zu welchen ein Unternehmen gem. § 161 Aktiengesetz jährlich eine Erklärung über etwaige Abweichungen abgeben muss. Die Entsprechenserklärung, der der aktuelle Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 2. Juni 2005 zugrunde liegt, wurde in der Vorstands- und Aufsichtsratsitzung im Dezember 2005 verabschiedet und der Öffentlichkeit umgehend auf unserer Homepage zugänglich gemacht.

Gemäß dieser Erklärung entspricht die SÜSS MicroTec AG den Empfehlungen des aktuellen Deutschen Corporate Governance Kodex und wird diesen voraussichtlich auch künftig entsprechen – mit den folgenden zwei Ausnahmen (im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Änderungen ergeben):

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in **Ziffer 3.8** bei Abschluss einer Directors and Officers Liability Insurance (Haftpflichtversicherung), einen angemessenen Selbstbehalt für die Organe der AG zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt. Das verantwortungsvolle Han-

deln aller geschäftsführenden Organe wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert. Es ist deshalb auch keine Vereinbarung eines organspezifischen Selbstbehalts geplant.

In **Ziffer 5.4.7** empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern sowie eine Vergütung für die Mitgliedschaft und den Vorsitz in Ausschüssen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats vor. Die Mitgliedschaft in Ausschüssen wird dadurch berücksichtigt, dass für die Teilnahme an Sitzungen eines Ausschusses ein Sitzungsgeld gezahlt wird. Der Vorsitz in Ausschüssen wird nicht besonders vergütet. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt angemessen vergütet wird.

Von den Anregungen des Corporate Governance Kodex können die Unternehmen auch ohne Erklärungspflicht abweichen. Wir ermöglichen unseren Aktionären und der Öffentlichkeit eine größtmögliche Transparenz und legen die vier Abweichungen von den Anregungen im Folgenden offen:

- Der Stimmrechtsvertreter ist während der Hauptversammlung nicht erreichbar.
- Die Hauptversammlung kann bisher noch nicht via Internet verfolgt werden. Im Hinblick auf zusätzliche Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung derartiger Maßnahmen abgesehen.
- Bislang sind die Bestellperioden der Aufsichtsräte noch nicht flexibilisiert.
- Der Aufsichtsrat erhält keine auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Vergütungskomponente sondern eine feste Vergütung. Um die Überwachungsaufgaben zweckgemäß und unabhängig durchführen zu können, erhält der Aufsichtsrat eine vom Unternehmenserfolg abhängige Vergütung für nicht zielführend.

Auch in diesem Jahr werden Aufsichtsrat und Vorstand der SÜSS MicroTec AG wieder eine Entsprechenserklärung gemäß dem dann aktuell geltenden Kodex abgeben.



♦ MA6, Belichtungseinheit

UNABHÄNGIGKEIT DER MITGLIEDER DES AUFSICHRATS

Es bestanden keinerlei Interessenkonflikte von Mitgliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nach der Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsrats hinreichend unabhängig.

VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHRATS

Gemäß dem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung 2002 sieht die Satzung die folgende Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats vor: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500,00 für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse eine feste Vergütung in Höhe von EUR 15.000,00 p. a. für das einfache Mitglied, EUR 45.000,00 p.a. für den Vorsitzenden und EUR 22.500,00 für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Darüber hinaus haben die Mitglieder des Aufsichtsrats mit einer Ausnahme keine Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten. Die Rechtsanwaltssozietät CMS Hasche Sigle, deren Partner das Aufsichtsratsmitglied Dr. Christoph Schücking ist, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr für ihre Beratungsleistungen für Unternehmen der SÜSS MicroTec-Gruppe insgesamt 72.687,11 Euro erhalten.

Auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats entfallen die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Beträge:

	Vergütung in 2005	Auslagen- ersatz	Sonstige Zahlungen (MwSt etc.)
Dr. e. h. Horst Görtz	7.669,37	2.306,33	MwSt 1.227,10 abzgl. 853,00 D&O Versicherung
Peter Heinz*	3.834,69	6.849,34	MwSt 613,55 abzgl. 342,00 D&O Versicherung
Prof. Dr. Anton Heuberger	7.669,37	3.166,95	MwSt 1.227,10 abzgl. 853,00 D&O Versicherung
Thomas Schlytter-Henrichsen	11.504,06	1.355,23	MwSt 1.840,65 abzgl. 1.280,00 D&O Versicherung
Dr. Christoph Schücking	7.669,37	1.370,68	MwSt 1.227,10 abzgl. 853,00 D&O Versicherung
Dr. Thomas Sesselmann**	3.834,69	446,55	abzgl. 511,00 D&O Versicherung
Dr. Winfried Süß	–	1.052,37	–

* ab 21. Juni 2005

** bis 21. Juni 2005

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der SÜSS MicroTec haben die Aufsichtsratsmitglieder auch für das Geschäftsjahr 2005 auf die Sitzungsgelder sowie auf die in der Hauptversammlung 2002 beschlossene Erhöhung der Vergütung und der Aufsichtsratsvorsitzende auf die gesamte Vergütung verzichtet.

ANTEILSBESITZ VON ORGANMITGLIEDERN UND DIESEN NAHE STEHENDEN PERSONEN

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie diesen nahe stehende Personen halten zum 31. Dezember 2005 Aktien bzw. Optionen der SÜSS MicroTec AG wie folgt:

Vorstand	Aktien	Optionen
Dr. Stefan Schneidewind	6.571	69.648
Stephan Schulak	13.000	80.286

Aufsichtsrat:	Aktien
Dr. Winfried Süß	1.131.000
nahestehende Personen i.S. § 15a WpHG	147.443
Thomas Schlytter-Henrichsen	6.909
Dr. e. h. Horst Görtz	3.894
Peter Heinz	1.338
Prof. Dr. Anton Heuberger	–
Dr. Christoph Schücking	500

Folgende Veräußerungen und Erwerbe von SÜSS-Aktien durch Organmitglieder und diesen nahe stehende Personen sind der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2005 mitgeteilt worden:

Dr. Winfried Süß	
09.05.	Kauf von 56.000 Aktien
10.05.	Kauf von 13.000 Aktien
11.05.	Kauf von 10.000 Aktien
12.05.	Kauf von 21.000 Aktien
13.05.	Kauf von 6.000 Aktien
Dr. Stephan Schneidewind	
23.06.	Ausübung von 6.000 Aktienoptionen
22.08.	Ausübung von 571 Bezugsrechten
Stephan Schulak	
22.11.	Ausübung von 40.000 Aktienoptionen
23.11.	Verkauf von 27.000 Aktien

GRUNDZÜGE DES VERGÜTUNGSSYSTEMS DES VORSTANDS

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats legt die Vorstandsvergütung fest. Das Aufsichtsratsplenum berät und überprüft regelmäßig die Vergütungsstruktur.

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands besteht aus fixen und variablen Komponenten.

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt; sie umfassen auch Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Kranken- und Rentenversicherung.

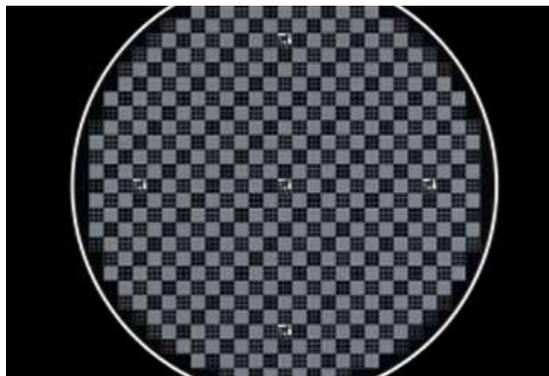
Den Mitgliedern des Vorstands sind Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherung) gemacht worden.

Für Herrn Dr. Schneidewind übernimmt SÜSS MicroTec die im Zuge der doppelten Haushaltsführung anfallenden Kosten.

Neben der festen Vergütung erhalten die Mitglieder des Vorstands einen variablen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen, die nicht nachträglich geändert werden können, orientiert.

Die dritte am langfristigen Erfolg des Unternehmens orientierte aktienbasierte Vergütung besteht aus Aktienoptionen gemäß dem Aktienoptionsplan 2005.

Die Angaben zur Höhe der Vergütung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2005 sind auf Seite 109 des Geschäftsberichts dargestellt.



← 300 mm – Fotomaske

AKTIONSOPTIONSPROGRAMME

Die SÜSS MicroTec AG hat unter drei Aktienoptionsprogrammen (Aktienoptionsprogramm 1999, 2002 und 2005) Bezugsrechte auf Aktien an die Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsleitung von Konzerngesellschaften und Mitarbeiter der SÜSS MicroTec AG und ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben. Die Aktienoptionsprogramme 1999 und 2002 sind zwischenzeitlich geschlossen worden, so dass unter diesen Programmen keine weiteren Optionen mehr ausgegeben werden können.

Zum 31. Dezember 2005 standen unter dem Aktienoptionsprogramm 1999 noch insgesamt 210.669 ausübbarer Bezugsrechte (davon 6.526 an Mitglieder des Vorstands) aus.

Zum gleichen Stichtag standen unter dem Optionsprogramm 2002 noch insgesamt 269.358 ausübbarer Bezugsrechte (davon 60.208 an Mitglieder des Vorstands) aus.

Aus dem Aktienoptionsprogramm 2005 wurden bis zum 31. Dezember 2005 insgesamt 193.000 Bezugsrechte (davon 80.000 an Mitglieder des Vorstands) ausgegeben, wovon am Stichtag 193.000 noch ausübbar waren. Weitere 557.000 Bezugsrechte können noch unter dem Aktienoptionsprogramm 2005 ausgegeben werden.

Bezugsrechte, die unter den Optionsprogrammen begeben wurden, sind frühestens nach Ablauf einer Wartefrist ausübbar. Die Wartefrist beträgt zwei Jahre und eine Woche. Die Ausübungshürden sind in den einzelnen Programmen unterschiedlich definiert:

Aktienoptionsprogramm 1999:

Anstieg des Börsenkurses um mindestens 50 % nach 3 Jahren, 75 % nach 5 Jahren, 100 % nach 5 Jahren.

Aktienoptionsprogramm 2002:

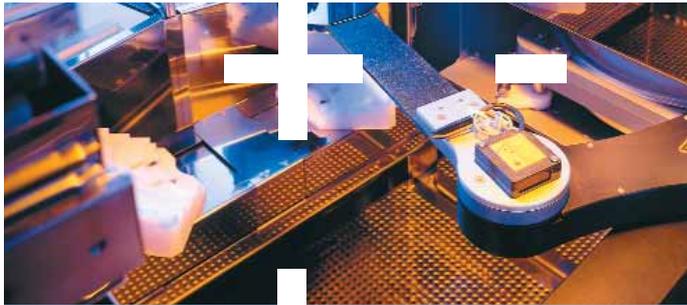
Anstieg des Börsenkurses um mind. 0,625 %/Monat (= 7 % p.a.) und prozentual gleiche oder bessere Entwicklung des Börsenkurses als der TecDAX
oder
Anstieg des Börsenkurses um mind. 0,8333 %/Monat (= 10 % p.a.)

Aktienoptionsprogramm 2005:

Anstieg des Börsenkurses um mind.: 0,625 %/Monat (= 7,5 % p.a.) und prozentual gleiche oder bessere Entwicklung des Börsenkurses als der TecDAX
oder
Anstieg des Börsenkurses um mind. 0,8333 %/Monat (= 10 % p.a.)

Weitere Informationen zur aktienorientierten Vergütung enthält Ziffer V. 1. des Konzernanhangs auf Seite 111.





UNTERNEHMENSKALENDER

SEMICON Europa	03. – 06. April	München, Deutschland
Micromachine Summit	27. – 29. April	Beijing, China
Quartalsbericht	03. Mai	
Analystenkonferenz	04. Mai	Frankfurt, Deutschland
SEMICON Singapore	09. – 11. Mai	Singapur
MTT-S Symposium	14. – 6. Juni	San Fransisco, CA
OPTO Taiwan	14. – 17. Juni	Taipei, Taiwan
Hauptversammlung	20. Juni	München, Deutschland
SEMICON West	11. – 13. Juli	San Fransisco, CA
Halbjahresbericht	02. August	
COMS 2005	27. – 31. August	St. Petersburg, FL
SEMICON Taiwan	11. – 13. September	Taipei, Taiwan
Neunmonatsbericht	07. November	
Micromachine 2006	07. – 09. November	Tokio, Japan
SEMICON Japan	06. – 08. Dezember	Chiba, Japan

Beschichten, Belichten und Entwickeln von 200mm-Wafern erledigt der LithoFab vollautomatisch und mit bewährter Hochpräzision. Diese Prozesse kommen auch bei der Bearbeitung von Verbindungshalbleitern zum Einsatz, die zur Produktion von LEDs benötigt werden. Auch hier werden große Stückzahlen verarbeitet, so dass ein Cluster-Gerät von SÜSS MicroTec Kosten- und Qualitätsvorteile bietet.

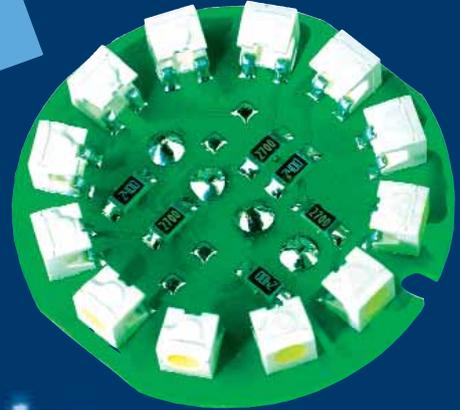
+ +



Vom

LithoFab200

...über den Chip...



...zu LEDs

+ + Sehr hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer. Diese Eigenschaften der LEDs machen sie für Straßenampeln, Autorückleuchten und Außenbeleuchtungen attraktiv.

+ +



HIGHLIGHTS 2005

1. QUARTAL

Neues Produkt für die Nanotechnologie

Die Strukturen in Halbleiterschaltkreisen werden immer kleiner – so klein, dass sie in Zukunft nicht mehr durch Belichtungsverfahren erzeugt werden können, weil die Wellenlänge des Lichts sogar im UV-Bereich zu „grob“ dafür ist. Die alternative, innovative Lösung besteht darin, mit dem Elektronenstrahl einen feinstrukturierten „Stempel“ zu erzeugen, dessen Muster in eine hauchdünne Kunststoffschicht auf dem Wafer zu pressen und die erzeugten Eindrücke durch UV-Licht zu verfestigen. Bei diesem Lithografieverfahren wird auch bei feinsten Strukturen eine hohe Produktionsgeschwindigkeit erreicht. SÜSS MicroTec hat mit Unterstützung der EU den hochpräzisen Nanostepper „NPS300“ entwickelt und ist mit diesem Gerät bestens für diesen Zukunftsmarkt gerüstet.

Mask Aligner „MA200 Compact“ und Coating Cluster „ACS200“ erfolgreich

Die 2004 entwickelte Produktfamilie „MA200 Compact“ stößt im Markt auf große Resonanz. Da die so genannte Aufstellfläche in Reinräumen ein sehr teures Gut ist, haben wir unser bewährtes Lithografie-Equipment verkleinert. Wobei die Qualitätskriterien – höchste Genauigkeit kombiniert mit hoher Durchsatzleistung bei gleichzeitig extrem niedrigen Betriebskosten – natürlich bestehen bleiben. Der „MA200 Compact“ ist teilweise auch mit der Supra-Yield-Technologie ausgerüstet und erreicht dann – dank intelligenter Temperaturkompensation und neuer Imagingtechniken – eine Auflösung von weniger als einem Mikrometer. In Kombination mit den voll automatisierten SÜSS MicroTec Spin Coatern werden beste Lithografieergebnisse auf den Wafern erzielt.

2. QUARTAL

SÜSS MicroTec-Prober machen mobil

Unser Verlangen, überall auf der Welt erreichbar zu sein, verändert die Anforderungen, die an mobile Geräte wie beispielsweise Handys, Notebooks und PDAs gestellt werden. Die stetig wachsenden Datenmengen, die über den Äther geschickt werden, müssen schnell und fehlerlos am anderen Ende ankommen. Gleichzeitig soll der Stromverbrauch möglichst gering sein, um auf Reisen die Akkus zu schonen. UMTS, wireless LAN und dessen Nachfolger UWB sind Technologien, die diesen Anforderung gerecht werden.

Die Märkte für diese High-Tech-Anwendungen wachsen rapide und SÜSS MicroTec hat den Trend früh erkannt. Im Juni wurden zwei Produkte zum Testen von Chips, die in diese Anwendungen gehen, anlässlich der MTT-S (International Microwave Symposium, die größte Versammlung von Fachexperten der Testindustrie) auf den Markt gebracht. Der „Suss Multi IZI Probe“, eine Prüfspitze, und „SussCal 6“ – eine Kalibrierungssoftware – ermöglichen neue, präzisere und kostengünstige Funktionstests.

3. QUARTAL

Erster Auftrag für C4NP-Equipment

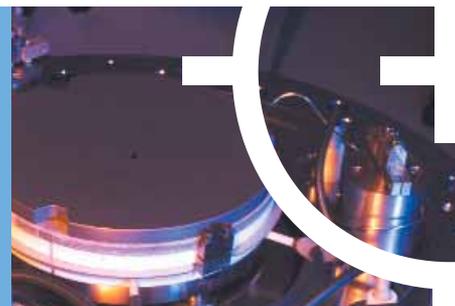
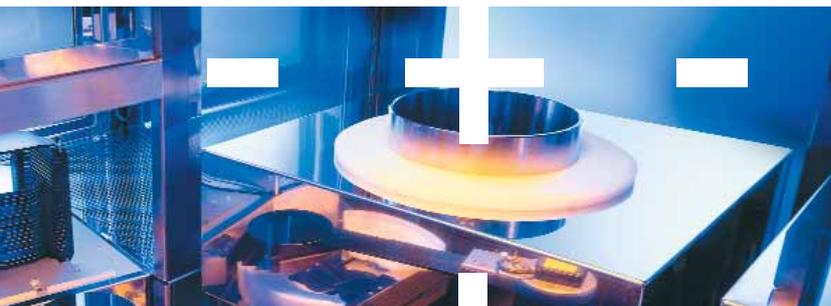
Die Testreihen auf dem C4NP-Demo-Tool in der SÜSS MicroTec-Tochterfirma in Waterbury, USA, verliefen erfolgreich und so erhielt SÜSS, wesentlich früher als erwartet, den ersten kommerziellen Auftrag für ein C4NP-Produktionsgerät. Der Kunde ist IBM.

C4NP ist ein neuer, von IBM entwickelter Prozess, die Lotkügelchen für das Wafer Bumping, mittels einer vergleichsweise einfachen Alternative zu den komplizierten galvanischen Verfahren,

► HIGHLIGHTS

UNSERE STRATEGIE

NACHHALTIGKEIT



herzustellen. Außerdem ermöglicht C4NP die Herstellung von bleifreien Lotverbindungen wie sie insbesondere von europäischen und von asiatischen Elektronik-Herstellern gefordert werden. IBM hat die C4NP-Technologie erfunden und SÜSS MicroTec im September 2004 damit beauftragt, das Demo-Equipment für dieses neue Verfahren zu entwickeln.

Neue Produkte für den wachsenden LED-Markt

LEDs (Leuchtdioden) ersetzen mehr und mehr die traditionellen Beleuchtungsmethoden. Sie sind kleiner, verbrauchen weniger Energie, haben eine längere Lebensdauer sowie eine geringe Heizwärmeabgabe. Beispiele für derzeitige Einsatzgebiete: Straßenampeln, Rückleuchten von Oberklasse-Fahrzeugen, Außenbeleuchtung.

Die LED-Produzenten erwarten von den Equipment-Herstellern Lösungen, die eine Senkung der Produktionskosten und gleichzeitig eine schnellere Produkteinführungszeit („time to market“) erlauben. Im dritten Quartal hat SÜSS MicroTec jeweils ein Produkt für die Produktion und für das Testen von LEDs vorgestellt: Ein sehr schnelles Testsystem, das acht Devices pro Sekunde kontaktieren kann. Jede Verkürzung der Testzeit des einzelnen LEDs kann zu einer insgesamt um Tage verkürzten Testzeit einer Charge von Wafern führen. Kein anderer Prober auf dem Markt kann so schnell und gleichzeitig so genau und zuverlässig die Funktionsfähigkeit der LEDs auf einem Wafer testen. Des Weiteren wurde der neue SÜSS MicroTec LED-Bonder auf den Markt gebracht. Dieser kann bis zu acht Wafer-Paare gleichzeitig miteinander verbinden – und ist damit achtmal so schnell wie Wettbewerbsprodukte.

4. QUARTAL

Höchster Auftragseingang seit Q2/2001

Im September und Oktober hat SÜSS MicroTec drei Aufträge im Gesamtwert von über vier Millionen US-Dollar von drei verschiedenen, führenden Halbleiterherstellern für den Substrat Bonder „ABC200“ erhalten. Diese Cluster-Systeme werden in der Produktion von MEMS-Bauteilen eingesetzt. Jeder dieser drei Aufträge ist ein Folgeauftrag aufgrund von Kapazitätserweiterungen bei den Kunden aus Europa, Nord-Amerika und Taiwan.

MEMS bedeutet Mikrosystemtechnik. Hierbei werden kleinste mechanische Bauteile mit elektronischen Schaltkreisen verbunden, um beispielsweise Sensoren (Airbag, ABS usw.) herzustellen. Substrate Bonding ist eine Technologie, die die Herstellung von MEMS-Bauteilen überhaupt erst ermöglicht. Vereinfacht ausgedrückt, werden hierbei zwei prozessierte Wafer hochpräzise miteinander verbunden. So werden Reifendrucksensoren und Mikro-Kippspiegel, wie sie für Projektions-Fernsehergeräte oder Beamer benötigt werden, produziert.

Auch in China ist das SÜSS MicroTec-Equipment für Mikrosystemtechnik stark nachgefragt: Ein dort ansässiger Kunde platzierte einen Auftrag im Gesamtwert von drei Millionen US-Dollar. Er wird die SÜSS MicroTec-Anlagen in der Entwicklung von neuen MEMS-Anwendungen einsetzen. SÜSS MicroTec ist seit mehr als 20 Jahren in China aktiv und hat dadurch direkten Zugang zu diesem bedeutenden Wachstumsmarkt.

Das vierte Quartal verlief insgesamt äußerst erfreulich. Hervorzuheben ist der Auftragseingang, der mit brutto 51 Millionen Euro den höchsten Wert seit dem zweiten Quartal 2001 erreichte.





♦ Kassettenstation Coater ACS300 Plus

UNSERE STRATEGIE

SÜSS ALS „KEY PLAYER“ IM MARKT FÜR HALBLEITER

Schon heute ist SÜSS MicroTec einer der führenden Spezialausrüster für die Chip- und Mikrosystemindustrie. Unser Anteil in den adressierten Märkten liegt bei rund 30 Prozent, im Bereich der Mikrosystemtechnik (MEMS) sind wir führend. Von dieser Basis aus wollen wir uns zu einem „Key Player“ im Markt für Halbleiter weiterentwickeln und vom weltweiten Wachstum in diesen Wirtschaftszweigen profitieren.

Um langfristig profitables Wachstum zu erreichen, setzt SÜSS MicroTec auf

- Wachstumsmärkte
- innovative Technologien mit hoher Effizienz für den Kunden
- Kooperationen und ein starkes Partnernetz
- eine nachhaltige, leistungsorientierte Unternehmenskultur (s. Kapitel „Nachhaltigkeit“)

WACHSENDER BEDARF

Alle Märkte, für die SÜSS MicroTec Equipment liefert, wachsen (s. Kapitel „Consumer Markets“). Unser MEMS-Equipment kommt beispielsweise in der Automobilzuliefer-Industrie, der Medizintechnik und der Fertigung von Computerzubehör zum Einsatz. Auch der Markt für moderne Chipverbindung (Advanced Packaging) weist dank wachsender weltweiter Beliebtheit von Notebook, PDA, Digitalkamera und angesichts neuer Trends in der Unterhaltungselektronik hohe Steigerungsraten auf. Unser Know-how im Bereich Verbindungshalbleiter lässt uns vom Boom bei LED-Beleuchtung profitieren.

Unsere Strategie ist nach wie vor darauf ausgerichtet, schnell und flexibel auf die Herausforderungen der wachsenden Märkte zu reagieren und uns mit unserem Equipment als kompetenter Partner der Hersteller zu positionieren.

HOHE F&E-INVESTITIONEN

Für alle relevanten Märkte bietet SÜSS MicroTec technologisch hochwertige Produkte. Forschung & Entwicklung ist und bleibt für SÜSS von zentraler Bedeutung, um unsere Kunden in diesen

wachsenden Märkten zu begleiten, Wettbewerbsvorteile weiter auszubauen und Entwicklungen voranzutreiben.

Jährlich investieren wir in etwa ein Zehntel des Umsatzes in die Entwicklung neuer Anlagen und Technologien. Denn wir wollen uns bei neuen Trends, wie zum Beispiel dem System in Package (SiP), Engineered Wafers und bleifreien Chipverbindungen frühzeitig positionieren und unsere technologische Spitzenstellung unter Beweis stellen. Daher pflegen wir auch künftig unseren traditionell hohen Verkaufsanteil an Forschungseinrichtungen und Universitäten, wo heute die Lösungen von morgen entstehen – unter Einsatz von SÜSS MicroTec-Produkten. Im Zentrum steht dabei immer der messbare Nutzen für unsere Kunden. Wir verbessern kontinuierlich Produkte und Service, damit unsere Kunden noch wettbewerbsfähiger werden und ihrerseits Kosten senken können. Die günstige „Cost of Ownership“ unserer Produkte ist eine der wesentlichen Stärken beim Ausschöpfen unserer Potenziale bei Neu- und Bestandskunden.

WACHSTUM MIT STARKEN PARTNERN

Von großer Bedeutung sind für SÜSS MicroTec von jeher strategische Kooperationen. Starke Partnernetzwerke wie beispielsweise MEMUNITY treiben die Markteinführung neuer Technologien voran und eröffnen zusätzliche Vertriebskanäle. Wichtigstes Einzelprojekt in Sachen Kooperationen ist derzeit C4NP. Mit der neuartigen, richtungsweisenden C4NP-Technologie kann das Advanced Packaging bleifrei und effektiver werden. SÜSS entwickelt derzeit – in Kooperation mit IBM – die Produktionsgeräte, die diese Prozesse dann abbilden. SÜSS MicroTec ermöglicht damit seinen Kunden, Chips effizienter und umweltfreundlich herzustellen.

INTERNE STÄRKE ALS BASIS

Die neue divisionale Unternehmensstruktur, in der Verantwortung und Kompetenzen klar den einzelnen Divisionen zugeordnet sind, kombiniert mit den im Rahmen der Restrukturierung optimierten Unternehmensprozessen, bilden die notwendige Grundlage zur Erreichung der Unternehmensziele. Der SÜSS-Konzern ist so ausgerichtet, dass effektiv an der Verwirklichung der Unternehmensstrategie gearbeitet werden kann.

HIGHLIGHTS

► UNSERE STRATEGIE

► NACHHALTIGKEIT

NACHHALTIGKEIT

VERANTWORTUNG FÜR DAS UNTERNEHMEN

Für die Mitarbeiter von SÜSS MicroTec war das vergangene Jahr keine einfache Zeit. Der Restrukturierungsprozess brachte notwendige Veränderungen und stellte die Weichen für eine profitable Zukunft des Unternehmens. Die ergriffenen Maßnahmen haben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber auch einiges abverlangt. Im Fokus stand stets die Verantwortung für das Gesamtunternehmen und seine Zukunftsfähigkeit, die Voraussetzung für sichere Arbeitsplätze und lohnende Kundenbeziehungen ist.

Das Ziel war klar definiert: Möglichst zeitnah die Gewinnschwelle auf EBIT-Niveau bei einem Umsatz von 106 Millionen Euro zu erreichen. Dabei vertrauen wir in erster Linie auf unsere technologisch führenden Produkte und den Ausbau unserer Position in Wachstumsmärkten. Aber auch im Inneren muss die SÜSS-Gruppe zu den Besten gehören. Das heißt: Prozesse wurden verschlankt und vereinheitlicht, um Kosten zu senken und bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Schließung des Werkes Aßlar war hierfür ein notwendiger Schritt. Wir konzentrieren unsere Kräfte auf das, was Mehrwert für den Kunden bringt. Die Lieferzeiten und Herstellungskosten unserer Produkte werden durch Modularisierung und Standardisierung weiter gesenkt.

Unter den nunmehr geschaffenen Voraussetzungen kann SÜSS MicroTec künftig im Sinne des Shareholder Value wieder profitabel wirtschaften und somit auch langfristig Arbeitsplätze sichern.

FÖRDERN UND FORDERN

Zu den Besten gehören heißt aber auch: SÜSS MicroTec investiert in die Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter. Wir überprüfen regelmäßig den Aus- und Weiterbildungsbedarf in allen Abteilungen. Auf Basis dieser Ergebnisse entstehen dann konkrete Förderaktivitäten. Schwerpunkt in den vergangenen Monaten war die Führungskräfte-Entwicklung. Im Aufbau befindet sich eine Weiterbildung für effizientes Projektmanagement, an der 110 unserer Mitarbeiter teilnehmen werden. Über ein Incentive-System motivieren wir die Mitarbeiter, bestellte Maschinen schnellstmöglich und exakt nach Kundenwunsch auszuliefern. Zur Sicherung des Nachwuchspersonals arbeitet

SÜSS MicroTec erfolgreich mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen. Außerdem bildet SÜSS MicroTec jedes Jahr Jugendliche in den Berufen Industriekaufmann und Mechatroniker aus.

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT

Mit unseren Produktinnovationen leisten wir einen messbaren Beitrag zum Umweltschutz. Während in der SÜSS-eigenen Produktion kaum umweltbelastende Stoffe anfallen, setzen unsere Kunden in der Produktion von Halbleitern und Mikrosystemen zahlreiche chemische Stoffe ein. SÜSS MicroTec hat bereits in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass diese Produktionsprozesse immer schneller, effizienter und damit auch ressourcenschonender vonstatten gehen und so einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Zunehmendes Umweltbewusstsein führt auch dazu, dass bleihaltige Elektronikprodukte durch bleifreie ersetzt werden. Daher entsteht bei den Produzenten ein großes Interesse, auch bleifreie Komponenten herstellen zu können. Im September 2004 hat SÜSS MicroTec mit IBM ein Abkommen geschlossen, dass SÜSS das Equipment für den neuen C4NP-Prozess entwickelt, produziert und vertreibt. Der von IBM entwickelte C4NP-Prozess erlaubt die bleifreie Verarbeitung von Chips. Diese Technologie kann in den nächsten Jahren zu einem Wachstumsmotor von SÜSS Micro Tec werden.

SÜSS MicroTec Produkte werden beispielsweise in der Automobilzuliefer-Industrie bei der Produktion von Sensoren eingesetzt, die nachhaltig die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen: Airbags und Antiblockiersysteme sorgen dafür, dass die individuelle Mobilität immer sicherer wird. Aber auch intern spielt die Arbeitssicherheit eine wichtige Rolle: In Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft werden die Mitarbeiter der SÜSS MicroTec regelmäßig zum Thema „Sicherheit am Arbeitsplatz“ geschult. Die Reinräume entsprechen den anspruchsvollen Sicherheitsstandards, so dass das Arbeiten mit gefährlichen Chemikalien so risikoarm wie möglich geschehen kann. Für den Notfall sind Mitarbeiter auch in spezifischen Erste-Hilfe-Maßnahmen ausgebildet.

SÜSS MicroTEC-PRODUKTE

+ COATER



BESCHICHTUNGSGERÄT

Coater verteilen einen fotoempfindlichen Lack auf dem Wafer. Die SÜSS MicroTec-Spin Coater sind auf dicke Fotolacke, die auf Wafer aufgebracht werden, spezialisiert. Die Spray Coater besprühen ein Substrat und können dadurch sogar dreidimensionale Strukturen gleichmäßig belackten.

+ MASK ALIGNER



BELICHTUNGSGERÄT

Mask Aligner richten eine Glasmaske submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmaske wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

+ DEVELOPER



ENTWICKLUNGSGERÄT

Developer lösen mit Hilfe von Chemikalien das zuvor vom Mask Aligner erzeugte Abbild aus der fotoempfindlichen Schicht auf dem Wafer heraus. Der gesamte Prozess ist mit dem des Fotografierens mit einer konventionellen Kamera gut zu vergleichen: Auf dem Film ist ein fotoempfindliches Material, das beim „Knipsen“ belichtet und anschließend entwickelt wird.

+ SUBSTRAT BONDER



VERBINDUNGSGERÄT

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann unsere Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker etc. funktionieren.

+ DEVICE BONDER



VERBINDUNGSGERÄT

Im Gegensatz zum Substrat Bonder verarbeitet der Device Bonder bereits vereinzelte elektronische Bauteile. Das heißt, er integriert mit höchster Genauigkeit die aus einem Wafer heraus gesägten Devices in eine Baugruppe, die dann zum Endprodukt weiter verarbeitet wird.

+ PROBER



TEST- UND PRÜFSYSTEME

Prober führen individuelle analytische Tests von Mikrochips durch. Mit Hilfe von Mess-Spitzen werden elektrische Signale von mikroskopisch kleinen Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. Oder Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte zeigen, ob die Chips den Anforderungen gerecht werden und weisen frühzeitig auf Fehler hin. Der modulare Aufbau unserer Prober macht diese äußerst flexibel, was insbesondere in Entwicklungsprojekten sehr geschätzt wird.

SÜSS MicroTEC MACHT DAS LEBEN LEICHTER

Technische Neuerungen erhöhen Jahr für Jahr unseren Lebensstandard, machen unser Leben kommunikativer, mobiler, sicherer und komfortabler. Die SÜSS Micro-Tec-Produkte werden in der Produktion von Chips und Mikrosystemen eingesetzt, die dann in die nachfolgend aufgeführten Endgeräte eingebaut werden. Insofern ist die Entwicklung der Märkte dieser Endprodukte ein wichtiger Indikator für den künftigen Bedarf an SÜSS MicroTec-Anlagen. SÜSS-Equipment wird hauptsächlich in den drei Wachstumsmärkten „moderne Chipverbindung/ Advanced Packaging“, „Mikrosystemtechnik“ und „Verbindungshalbleiter“ benötigt.

Das Advanced Packaging wird von der Chip-Industrie eingesetzt. Und diese wird, Marktexperten zufolge, bis 2008 ein jährliches Durchschnittswachstum von 9,5 Prozent aufweisen. Wachstumsmotor bei den Endgeräten werden den Erwartungen gemäß PCs und Notebooks, gefolgt von Digitalkameras, PDAs und MP3-Playern sein. Die Märkte für PCs, Notebooks und Server sollen jährlich rund 10 Prozent wachsen. Der Handy-Markt rund vier Prozent jährlich.

Die Unterhaltungsindustrie gibt der Elektronikindustrie zusätzlichen Schub: Die Nachfrage nach Digitalcameras und DVD-Player soll rund 8 Prozent, nach Spielkonsolen rund 5 Prozent wachsen. Ein noch größeres Wachstum wird DVD-Recordern und Beamern vorhergesagt.

Die Mikrosystemtechnik ist vor allem die Welt der Sensoren. Allein die Wachstumsraten für Antiblockier- und Navigationssysteme via GPS werden von Branchenexperten (Yole Develop-

ment) mit rund 10 Prozent bis 2010 geschätzt. Tintenstrahl-druckern wird ein weiteres Wachstum ca. 20 Prozent vorhergesagt.

Auf dem Markt der Verbindungshalbleiter ist für SÜSS insbesondere folgendes Segment interessant: Der LED-Markt (Leuchtdioden) soll bis 2007 um durchschnittlich 28 Prozent jährlich wachsen.

Das große deutsche Wirtschaftsmagazin „Wirtschaftswoche“ kürte Ende 2005 zehn Technologien, deren Siegeszug quer durch alle Bereiche unseres Alltags verläuft – darunter Leuchtdioden (LEDs), hochauflösendes HDTV-Fernsehen, Navigationssysteme in Handys und Fahrerassistenzsysteme in Mittelklasseautos. An der Entwicklung und Herstellung all dieser Innovationen sind Produkte und damit Know-how von SÜSS MicroTec beteiligt.

In modernen, entwickelten Ländern kommt jeder Mensch täglich mindestens einmal mit einem Produkt in Berührung, das mit Hilfe von SÜSS-Equipment gefertigt wurde. Elektronische Geräte, die dutzendfach in jeden Haushalt Einzug gehalten haben, werden nach immer kürzeren Lebenszeiten ausgetauscht und sollen immer mehr leisten. Entsprechend größer werden die Einsatzmöglichkeiten für Halbleiter (Chips) und Mikrosysteme (MEMS) und entsprechend wächst die Nachfrage. „SÜSS inside“ gilt zum Beispiel für viele Handys, Flachbildschirme, MP3-Player, Reifendrucksensoren, Motorsteuerung, Airbag, Blutzuckermessgeräte, Navigationsgeräte, Leuchtdioden (LEDs) und Wireless Networks (WLAN, Hotspots, Bluetooth). Als führender Spezial-ausrüster beliefern wir die Hersteller von Chips, Mikrosystemen (MEMS) und Verbindungshalbleiter mit Maschinen und Anlagen zur Produktion. Die Produkte unserer Kunden kommen im





← Operator am MA300

Wesentlichen in vier dynamisch wachsenden Märkten zum Einsatz:

Markt:	Produkt:
Mobilität und Sicherheit	Airbagsensoren, Abstands- oder Entfernungsmelder, Elektronische Stabilitäts-Kontrolle (ESP), Temperatursensoren, Positionssensoren (GPS), Drucksensoren (Reifendruck), Niveauregulierung, Bewegungssensoren (für Diebstahlsicherung), Blutzuckermeßgeräte (Lab on a Chip)
Büro- und Kommunikationsausstattung	Desktop-Computer, Notebooks, PDA, Handy, Tintenstrahldrucker
Unterhaltung	DVD-Player, DVD-Recorder, Video- und Spielekonsolen, Digitalkameras, Digitalcamcorder
Beleuchtung	LED

SICHER UND MOBIL

Mikrosystemtechnik (MEMS) kommt in vielen technischen Alltagsanwendung zum Einsatz. Dem bloßen Auge bleibt diese Welt verschlossen, denn ein Mikrometer entspricht gerade einmal einem tausendstel Millimeter und ein Mikrosystem ist oft nur 30 Mikrometer groß – das entspricht dem Durchmesser eines menschlichen Haares. Unser Leben sähe ohne MEMS anders aus. Im Auto beispielsweise sorgen Mikrosysteme in Sensoren für einen im Notfall funktionierenden Airbag. Oder sie wirken in einem Einparksystem für unfallfreies Einparken. Antiblockiersystem und Navigationssysteme via GPS sind weitere Anwendungen.

Leben retten kann Mikrosystemtechnik in Blutzuckermessgeräten von Diabetikern und der Einsatz in DNA-Analysen oder biometrischen Erkennungsmethoden sorgt für mehr Sicherheit und eine wirkungsvollere Kriminalitätsbekämpfung. Aber auch in der Büroausstattung bestehen Einsatzmöglichkeiten, die das Leben leichter machen, z. B. durch MEMS gesteuerte Tintenstrahldrucker. Auch moderne Beamer, mit deren Hilfe sich immer mehr Menschen zu Hause ihr Heimkino aufbauen, funktionieren nur dank Mikrosystemen.

In 2005 haben wir rund 35 bis 40 Prozent unseres Umsatzvolumens aus dem MEMS-Markt generiert. Die Mikrosystemtechnik ist, neben dem Advanced Packaging, der wichtigste Markt für SÜSS MicroTec. Wir bieten das mit Abstand umfassendste Equipment für den MEMS-Markt: Mask Aligner, Spin Coater, Wafer-Bonder und Prober. Und an der Zukunft wird schon geforscht: Heute rollen Autos fast auf den gleichen Pneu wie vor 50 Jahren. Dabei könnten gerade im Reifen zahlreiche interessante Parameter erfasst werden. Neben Temperatur und Druck wäre die Erfassung von Drehzahl, Geschwindigkeit, Giermoment, Traktion oder beginnenden strukturellen Veränderungen der Karkasse denkbar – intelligente Reifen sozusagen. In den USA ist die elektronische Reifendruckkontrolle bereits Pflicht. Für Automobilzulieferer und Reifenhersteller heißt dies, ihre Entwicklungen mit Hochdruck voranzutreiben. Ein innovatives und bereits serienreifes Reifenüberwachungssystem ermöglicht, dass im Reifen angebrachte Sensoren beispielsweise mit Empfangsgeräten einer Tankstelle kommunizieren. Dann könnten Autofahrer auf einem Display an der Zapfsäule ablesen, ob und exakt welche Luftdruckkorrekturen sie rechtzeitig vornehmen sollten – mit schönem Gruß vom „Intelligenten Reifen“.

SCHNELLER UND KLEINER

Bei der modernen Chip-Verbindung (Advanced Packaging) geht es darum, Halbleiter platzsparend und direkt, mit hoher Anschlussdichte und geringen Leitungswiderständen mit der Außenwelt (beispielsweise der Platine) zu verbinden. Es gilt, eine möglichst hohe Chip-Dichte zu erzeugen, um Endprodukte wie Handys, Notebooks, Digitalkameras oder PDAs immer leistungsfähiger und hochwertiger zu machen. „Schneller und kleiner“ lautet das Motto. Obwohl die Geräte immer stärker Miniaturformat annehmen, leisten ihre Prozessoren immer mehr. Das geht nur, weil dank ausgefeilter Produktionsprozesse ein Chip immer mehr Schaltkreise enthält. Waren 1971 erst 2.300 Transistoren auf einem Halbleiter, zählte man in den 90-er Jahren bereits zwischen drei und zehn Millionen. Heute ist diese Zahl auf 95 Millionen angestiegen. Auch die Verbindung zwischen Chip und Außenwelt, das Advanced Packaging, muss direkt und platzsparend sein, da mit kürzeren Verbindungen der Prozessor schneller und vor allem auch störungsfrei arbeiten kann.

SÜSS MicroTec beliefert viele Schwergewichte der Halbleiterbranche mit Mask Alignern, Spin Coatern und Probern. Künftig soll auch das C4NP-Equipment in dieses Marktsegment geliefert werden. Einzigartig ist C4NP (Controlled Collapse Chip Connection – New Process) weil die Effizienz für das Wafer-Bumping, dem wesentlichen Fertigungsschritt beim Advanced Packaging, weiter gesteigert werden kann. Außerdem kann das Verfahren zu 100 Prozent bleifrei durchgeführt werden (s. auch Kapitel Nachhaltigkeit). SÜSS entwickelt derzeit das Equipment für eine komplette C4NP-Produktionslinie.

VOLLER DURCHBLICK

Ein weiterer Markt für SÜSS MicroTec sind Verbindungshalbleiter. Wie der Name schon sagt, setzen sie sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Das für SÜSS derzeit interessanteste Endprodukt dieses Markts sind die LEDs (Light Emitting Diodes / Leuchtdioden). Sie sind besonders hell, verbrauchen wenig Energie und halten sehr viel länger als konventionelle Glühbirnen. LEDs wandeln elektrischen Strom mit sehr hoher Effizienz in Licht um. In zehn bis 15 Jahren, so prognostiziert die Fördergemeinschaft Gutes Licht, ist die LED „alleiniger Spitzenreiter unter den effizienten Lichtquellen“. Entsprechend häufig kommen sie schon zum Einsatz – als Bremslichter und Innenraumlampen im Auto, in Verkehrsampeln, in vielen Handy-Displays und -Tastaturen aber auch im Kamerablitzlicht.

Großbildschirme, etwa für Open-Air-Sportübertragungen, und Flachbildschirme strahlen dank LEDs heller und prägnanter. Auch hier gibt es eine umweltfreundliche Komponente: Der geringe Energieverbrauch schlägt sich in einer wesentlich geringeren Wärmeabgabe der LEDs nieder. Die Folge: Der vermehrte Einsatz bei Außenbeleuchtung beispielsweise in Großstädten, führt zu einer geringeren Erwärmung der Atmosphäre.

SÜSS MicroTec ist bei der Herstellung von LEDs mit allen Produktlinien vertreten. Wichtigster Prozessschritt ist hierbei die Fotolithografie, entsprechend nachgefragt sind Mask Aligner. Mit der Integration von Spin Coater, Mask Aligner und Developer zu einem Paket deckt der Kunde drei wichtige Herstellungsschritte ab und kann so seine Kosten deutlich senken. Aber auch die Qualitätskontrolle gewinnt an Bedeutung, was den Bedarf an speziellen Probern erhöht.

Eine gute Qualitätskontrolle ist unabdingbar. Prober analysieren detailliert, ob ein Chip allen Anforderungen gerecht wird. Nur wenn dieses Testgerät grünes Licht gibt, darf der Chip tatsächlich weiter verarbeitet werden. Je zuverlässiger diese Auswahl ist, umso besser funktionieren die Geräte, in die die Chips eingebaut werden.



Vom HF-Prober...

...über den Chip...



...zum Handy



+++ Mobil erreichbar zu sein, wann immer man es wünscht. Eine spontane Änderung des ausgemachten Treffpunkts, ein Hilferuf im Notfall, SMSen oder sogar fotografieren - mittlerweile ganz normaler Alltag.

++

+



KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2005

1. KONZERNSTRUKTUR UND GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

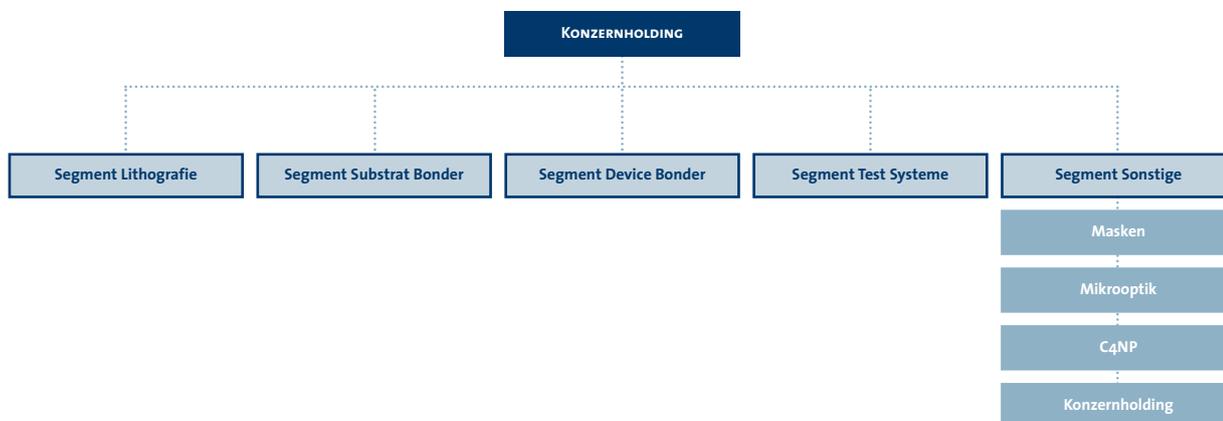
Der SÜSS MicroTec Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und Prüfsysteme für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikro-systemtechnik.

Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Marktnischen bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von

Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

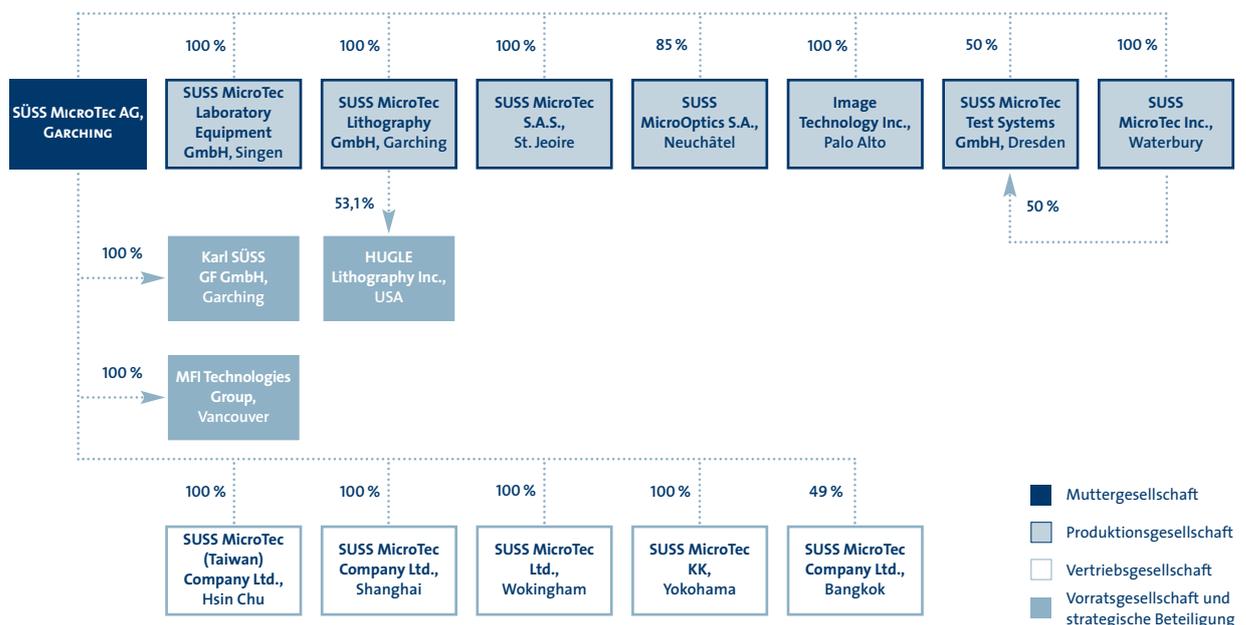
Der Konzern ist in 5 Segmente eingeteilt, wobei das Segment Sonstige aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden.



Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG, als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte unter anderem in Deutschland, den USA, Frankreich, China und Taiwan.

► KONZERNSTRUKTUR
► UNTERNEHMENSSTEUERUNG
FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
GESCHÄFTSVERLAUF
ERTRAGS-; FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE
MITARBEITER
UMWELT
NACHTRAGSBERICHT
RISIKOBERICHT
PROGNOSEBERICHT

Rechtliche Struktur des Konzerns:



Geringfügige Beteiligungen: ZTS Glaubitz (10 %)

Electron Mec. S.r.L., Milano (10 %)

Holtronic Techn. S.A. Marin, Helvetia (10 %)

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt insbesondere bei Leitungsfunktionen durch die Aufteilung in fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die variablen Gehaltsbestandteile orientieren sich in der Regel an der Erreichung persönlicher und finanzieller Ziele, die jeweils jährlich neu festgelegt werden. Ein bestimmter Kreis von Mitarbeitern nimmt zudem am Aktienoptionsplan des Konzerns teil.

Die Bezüge des Vorstandes enthalten ebenfalls fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die Bezüge bestehen zudem aus einer variablen Vergütungskomponente mit langfristiger, renditeorientierter Anreizwirkung in Form eines Aktienoptionsplans.

2. UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND STRATEGIE

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere am Auftragseingang, Umsatz und dem Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Performance der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellkosten) sowie des Net Operating Profit gemessen. Der Net Operating Profit eines Segmentes stellt innerhalb des Konzerns den Rohertrag abzüglich der zugeordneten Kosten für Verwaltung, Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie sonstige zuzuordnende Kosten und Erträge dar.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Net Cash-Position (Flüssige Mittel abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.



Die Steuerungskennzahlen haben sich teilweise deutlich verändert, da die Konzernrechnungslegung mit Abschluss des Geschäftsjahres 2005 von US-GAAP auf IFRS umgestellt wurde. Aus diesem Grund ergeben sich bei wesentlichen Bilanz- und Ergebniskennzahlen Veränderungen im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen. Die Umstellung beinhaltet auch das Vorjahr 2004, so dass die Vergleichszahlen unter Zugrundelegung gleicher Prämissen erstellt wurden. In der Konsequenz werden somit die nachstehend genannten Vorjahreszahlen ebenfalls nicht mit den Werten des Geschäftsberichtes 2004 oder den Werten für 2004 in den Berichten zu den ersten drei Quartalen 2005 identisch sein. Nähere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte dem Anhang zum Konzernabschluss.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Nischen in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Wir wollen durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in den relevanten Märkten agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; nur im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

3. FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind von essenzieller Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit sowohl der bestehenden als auch zukünftiger Produkte. Sie stellen für unser Unternehmen Investitionen in die Zukunft dar.

Unsere Branche ist, obwohl vieles auf die Entwicklung zu einer reiferen Industrie deutet, nach wie vor sehr F&E-intensiv. Auf der einen Seite erzwingen neue Endprodukte mit sehr hohen Wachstumsraten – wie zum Beispiel Leuchtdioden (LED) – neue Maschinentypen. Auf der anderen Seite nimmt der Wettbewerb um die

Kostenführerschaft unter unseren Kunden zu. Dieser Wettbewerb führt dann auch zu einem Preisdruck bei den von uns zu liefernden Maschinen. Wer als Maschinenlieferant in diesem Umfeld bestehen will, muss seinen Kunden die „produktivere“ Maschine anbieten können, nicht zwangsläufig die „billigere“: Hohe Qualität, Zuverlässigkeit – in der Branche durch den Begriff „machine uptime“ beschrieben – und hoher Durchsatz sind wichtig für unsere produzierenden Kunden.

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt unserer F&E-Tätigkeit klar bei der Entwicklung der Tools für die C4NP-Produktionslinie. Hierzu wurde die Entwicklung der einzelnen Tools auf diejenigen Standorte verteilt, die in ihrer jeweiligen Kernkompetenz den einzelnen Entwicklungszielen am nächsten waren. Durch diese Parallelisierung konnte die Entwicklungszeit bis zu einem marktreifen Produkt („time-to-market“) für die C4NP-Pilotlinie entscheidend verkürzt werden. Im zweiten Schritt erfolgt nun die Integration der einzelnen Tools zu einer C4NP-Produktionslinie in unserem Standort in Waterbury, Vermont in den USA. Dort wurde für dieses bedeutende Vorhaben eine eigene Entwicklungsabteilung mit hoher eigener Entscheidungskompetenz geschaffen.

Daneben haben wir vorrangig Entwicklungen betrieben, die der mittel- und langfristigen Sicherung der Margen dienen. Dazu wurden besondere Anstrengungen bei der Standardisierung und Modularisierung unserer Produkte unternommen: Nach einem grundlegenden internen Assessment der in unseren Maschinen verwendeten Steuerungskonzepte wurde ein neues System entwickelt, das als Basis für die kommenden Maschinengenerationen dienen soll. Neben einer klassischen PLC-Steuerung auf Maschinenebene wurde ein „intelligenter“ Überbau auf PC-Ebene programmiert, der die komplexen Funktionen wie Rezeptierung von Prozessen, Robot Vision und Kommunikation im Netzwerk kontrolliert. Somit wurden die Eigenschaften „höchste Zuverlässigkeit“ und „uneingeschränkte Flexibilität“ in eine gute Synthese gebracht.

Im Zusammenhang mit diesem Projekt wurde durch die Einführung des Produktions-Mask Aligners MA200 compact das gesamte, in Jahrzehnten erlernte Know-how unseres Segmentes Lithografie in eine moderne Produktfamilie verdichtet. Diese zeichnet sich nun durch einen modularen Aufbau, die Verwirklichung des neuen, standardisierten Steuerungskonzepts und die daraus resultierende hohe Produktivität aus. Diese modulare Produktfamilie ersetzt die bisherige Variantenvielfalt, ohne Lücken im Angebot entstehen zu lassen.

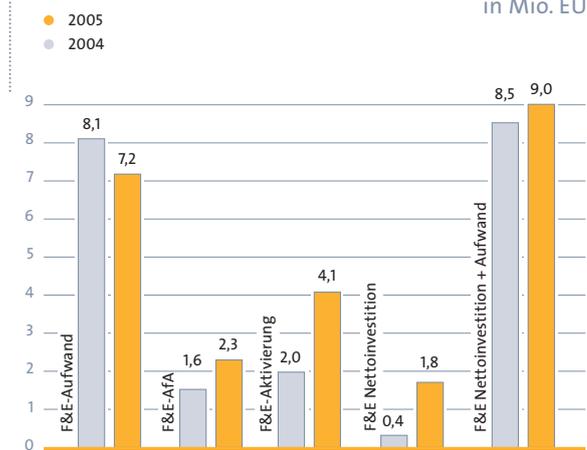
Ähnliche Arbeiten wurden für die Bond Cluster durchgeführt, mit denen wir bei den Herstellern immer erfolgreicher werden. Für den stark wachsenden Markt Leuchtdioden (LED) wurde zusätzlich eine neue Variante des Substrat Bonders bereitgestellt. Die für die Herstellung von LEDs benötigten Wafer basieren nicht auf Material aus nur einem chemischen Element – dem hochreinem Silizium – sondern auf sogenannten Verbindungshalbleitern von Typ III-V oder II-VI. Beispiele dafür reichen von Gallium-Arsenid (GaAs) oder Indiumphosphid (InP) bis hin zu vier chemischen Elementen wie zum Beispiel InGaAsP als einem sogenannten quaternären Halbleiter. Diese Wafer sind sehr teuer und können nur in kleinen Durchmessern gefertigt werden, typischerweise bis 2 Zoll (51 mm). Werden diese kleinen Wafer in Substrat Bondern verarbeitet, so ist es wünschenswert, bei jeder Beladung des Bonders gleich mehrere dieser kleinen Wafer zu prozessieren. Der von uns entwickelte neue LED-Multibonder erlaubt es, acht Wafer mit 2 Zoll Durchmesser in einem Arbeitsgang zu prozessieren. Dies ist für die LED-Hersteller, die aufgrund ihrer hohen Stückzahlen an einem hohen Durchsatz interessiert sind, ein großer Vorteil bei der Produktivität.

Schließlich arbeiten wir weiterhin auch an mehreren Projekten im Bereich Nanotechnologie. Für die Zukunftstechnologie „Nanoimprinting“ konnten wir bereits den aus der Device Bonder Technology abgeleiteten Nanostepper NPS300 weitgehend fertig stellen. Dieses Projekt wurde und wird immer noch über EU-Fördermittel nachhaltig unterstützt: So konnten wir bei über-

schaubarer eigener Investition bereits zwei international renommierten Forschungseinrichtungen Maschinen für die Entwicklung künftiger Fertigungsprozesse zur Verfügung stellen. Das wird uns ermöglichen, an einem Innovationsmarkt zu partizipieren, wenn die neuen Technologien in nicht allzu ferner Zukunft Eingang in die Produktion von Halbleiter- und Nanosystemprodukten finden.

F&E-Ausgaben im Jahresvergleich

in Mio. EUR



Die gesamten Ausgaben für Forschung und Entwicklung blieben im Jahresvergleich nahezu unverändert. Der deutliche Anstieg der Aktivierung von Entwicklungsleistungen ist größtenteils auf das Projekt C4NP zurückzuführen. Aufgrund des höheren Umsatzes in 2005 blieb die Quote (in Prozent vom Umsatz) unverändert bei 7,6 %.

Die Mitarbeiterzahl im Bereich F&E und Prototyping belief sich zum Jahresende 2005 auf 112 Personen (+8,7 % gegenüber 2004). Unsere Absicht ist, nicht nur diese für unsere Zukunft so entscheidende Mitarbeitergruppe zu stärken, sondern zusätzlich auch in die Applikations- und Prozessentwicklung zu investieren.

4. ÜBERBLICK ÜBER DEN GESCHÄFTSVERLAUF

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 befand sich die Weltwirtschaft weiterhin auf einem stabilen Wachstumspfad. Sie wuchs um rund 4 %, getrieben vor allem durch die weiterhin positive Entwicklung in Asien. Aufgrund dieser Daten gehen wir davon aus, dass sich das Konsumklima im Vergleich zu 2004 nicht wesentlich geändert hat.

Die für uns relevanten Märkte entwickelten sich unterschiedlich. So stieg der weltweite Umsatz mit Halbleitern im Vergleich zum Vorjahr um rund 8 %. Die Industrie der Halbleiter-Ausrüster jedoch musste einen Umsatzrückgang von 11 % (Quelle: SEMI) verzeichnen. Die Umsatzentwicklung unseres Unternehmens zeigte in 2005 erneut, dass SÜSS nicht direkt von den Zyklen der Halbleiter-Ausrüster-Industrie abhängt.

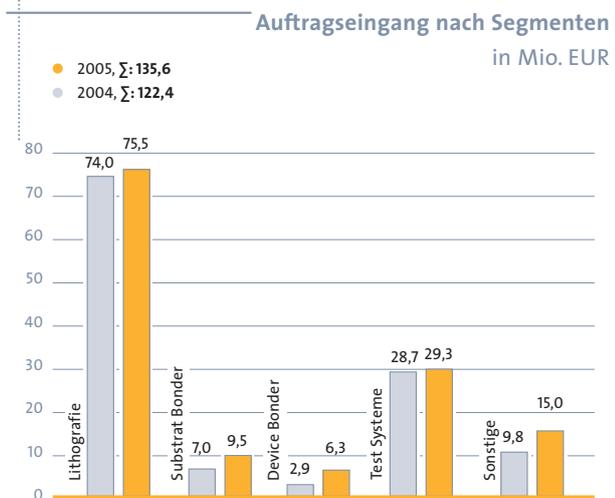
So waren nach den ersten neun Monaten des Jahres 2005 sowohl der kumulierte Umsatz als auch der Auftragseingang jeweils unterhalb der Vorjahreswerte. Erst ein außerordentlich starkes viertes Quartal, in dem sowohl die Auslieferungen als auch die Auftragseingänge deutliche Steigerungsraten aufwiesen, führte letztlich zu jeweils höheren Werten im Gesamtjahresvergleich.

Hinsichtlich der Währungsentwicklung sind die Effekte auf Umsatz und Auftragseingang vernachlässigbar. Der verwendete Durchschnittskurs veränderte sich nur geringfügig. Jedoch ergaben sich aufgrund des deutlich stärkeren US-Dollars zum Bilanzstichtag (1,18 USD / 1,00 EUR zum 31.12.2005 gegenüber 1,36 zum 31.12.2004) spürbare Buchgewinne.

Umsätze und Auftragslage der Segmente

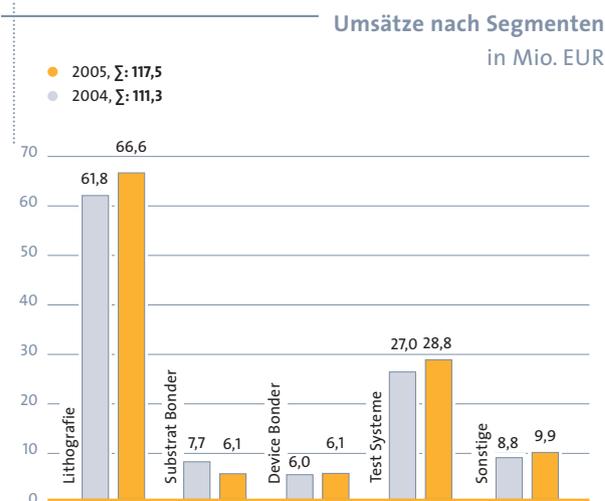
Der bereits in 2004 begonnene positive Trend bei Auftragseingang und Umsatz wurde somit auf Gesamtjahressicht fortgesetzt. Für den hohen Auftragseingang im vierten Quartal 2005 waren unter anderem folgende Einzelaufträge bzw. Marktbesonderheiten, die erwartungsgemäß nicht permanent und nachhaltig wiederkehren, verantwortlich:

- Großauftrag für Advanced Packaging 5,7 Mio. EUR
- Ersatzinvestition Großkunde 3,2 Mio. EUR
- Device Bonder 3,2 Mio. EUR
- Großaufträge für Substrat Bonder 3,3 Mio. EUR



Zusammenfassend waren für das Wachstum beim Auftragseingang von 122,4 Mio. EUR auf 135,6 Mio. EUR (+10,8 %) auf Gesamtjahressicht vor allem C4NP (enthalten im Segment „Sonstige“) sowie die Erholung bei den Segmenten Substrat Bonder und Device Bonder verantwortlich. Die Entwicklung innerhalb der Segmente wird an anderer Stelle näher erläutert.

- KONZERNSTRUKTUR*
- UNTERNEHMENSSTEUERUNG*
- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
- **GESCHÄFTSVERLAUF***
- ERTRAGS-; FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE
- MITARBEITER
- UMWELT
- NACHTRAGSBERICHT*
- RISIKOBERICHT
- PROGNOSEBERICHT



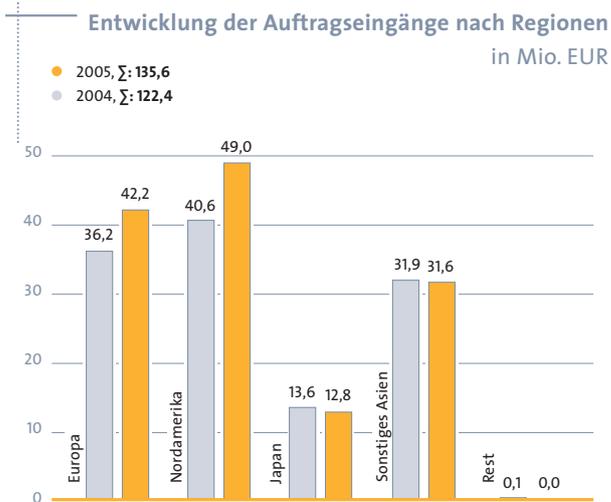
Die Steigerung der Umsätze im Segment Lithografie beruht im Wesentlichen auf den Zuwächsen bei den Coatern, wobei sich hier insbesondere die Produktlinie der halbautomatischen Spin Coater (Produktlinie „Gamma“) seit nunmehr zwei Jahren als sehr wettbewerbsfähig darstellt. Bei den anderen Segmenten entwickelten sich die Umsätze annähernd wie im Vorjahr, was auf eine relativ unveränderte Investitionsbereitschaft innerhalb unserer Märkte im abgelaufenen Geschäftsjahr hindeutet.

Umsätze und Auftragslage in den Regionen

Bei der Betrachtung der Regionen gab es Verschiebungen. Europa und Nordamerika entwickelten sich im Jahresverlauf positiv, während Asien und Japan insbesondere beim Umsatz hinter dem Vorjahr zurück blieben. Typischerweise sind die Märkte schwerpunktmäßig in folgenden Regionen vertreten:

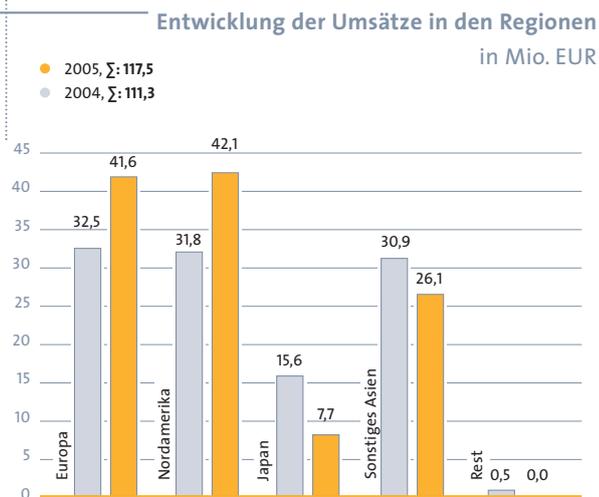
- Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter: Europa, Nordamerika und Japan
- Test Systeme: Europa und Nordamerika
- Advanced Packaging: Sonstiges Asien

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass mit regionalen Verschiebungen bei der Entwicklung von Auftragseingang und Umsatz nicht zwingend eine Verschiebung innerhalb unserer Zielmärkte verbunden ist. Das hängt damit zusammen, dass global agierende Kunden in allen Regionen Fabriken installiert haben. Daher zeigen Änderungen in der regionalen Verteilung nur auf, wo die Investitionen stattfanden. Wir gehen davon aus, dass sich innerhalb der adressierten Märkte insgesamt keine wesentliche Änderung im Vergleich zum Vorjahr eingestellt hat.



Bei der Umsatzentwicklung gab es dagegen signifikante Verschiebungen innerhalb der Regionen. In Europa und Nordamerika konnten die Umsätze im Jahresvergleich deutlich gesteigert werden. In Asien (ohne Japan) blieb der Umsatz im Jahresvergleich zurück. Dies führen wir auf die Fokussierung auf Produktionsmaschinen in dieser Region zurück, die höhere Volatilitäten erzeugt. Denn während in den anderen Regionen die kleineren und manuellen Systeme einen permanenten und laufenden Umsatzbeitrag liefern, ist dies in dieser Region nur zu kleineren Teilen der Fall. Im Jahr 2005 wurden auch in dieser Region mehrere Aufträge erst zum Ende des Jahres akquiriert bzw. Maschinen erst spät im Jahr geliefert, und wurden somit aufgrund fehlender Abnahme durch den Kunden nicht mehr umsatzwirksam.

In Japan ging der Umsatz um mehr als die Hälfte zurück. Dies hing einerseits damit zusammen, dass zum Jahresende 2004 das Auftragsbuch relativ stark ausgekehrt wurde. Andererseits wurde mehr als ein Drittel des Auftragseingangs 2005 in Japan erst im vierten Quartal realisiert. Wir gehen nicht von einer Änderung bzw. Verschlechterung des Markt- und Konkurrenzumfeldes für unser Unternehmen in Japan aus, da der Auftragseingang nur unwesentlich unterhalb des Vorjahreswertes blieb.

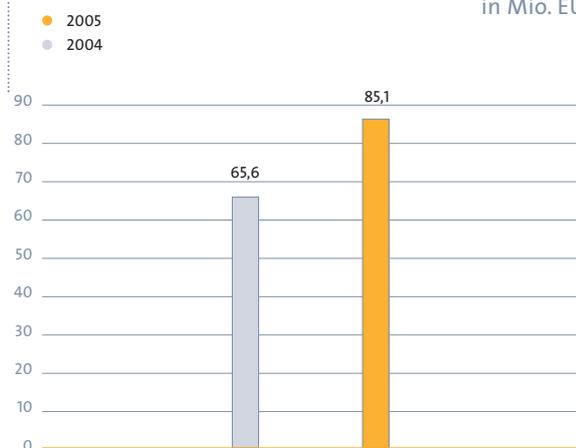


Auftragsbestand in der Gruppe

Das Verhältnis zwischen neu eingegangenen Aufträgen und realisierten Umsätzen, die sogenannte Book-to-bill Ratio, lag 2005 bei 1,15 (2004: 1,10). Wesentlicher Sondereffekt in 2004 war eine Wertberichtigung in Höhe von 4,3 Mio. EUR für eine Position, bei der wir nicht von einer Lieferung in 2005 oder 2006 ausgehen.

Der Auftragsbestand enthält üblicherweise Aufträge, die in den kommenden 5 bis 9 Monaten umsatzwirksam werden. Diese Zeitspanne beinhaltet neben der reinen Produktionszeit (in der Regel bis zu 6 Monate) auch den Abnahmeprozess (in der Regel bis zu 3 Monate nach Lieferung).

Auftragsbestand in der Gruppe in Mio. EUR



Der Auftragsbestand zum Jahresende 2005 lag um 30 % über dem Vorjahreswert. Die Zuwächse betrafen vor allem die Regionen Nordamerika und Japan.

Im Auftragsbestand per Ende 2005 sind Aufträge in Höhe von 8,1 Mio. EUR enthalten, bei denen wir nicht von einer Umsatzrealisierung im Geschäftsjahr 2006 ausgehen. Da jedoch eine Lieferung in diesem Jahr geplant ist, verbleiben diese Positionen im Auftragsbestand.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN:

Lithografie

Das Segment Lithografie beinhaltet Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner und Coater, und ist in Deutschland, vor allem an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bei Stuttgart, angesiedelt. Darüber hinaus sind wichtige Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging stark vertreten.

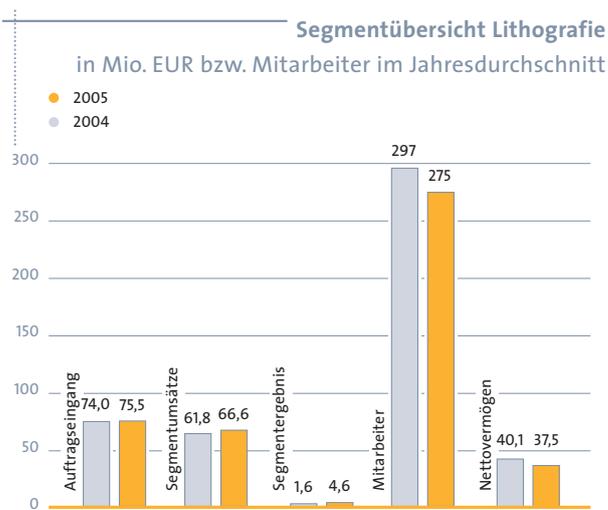
Im abgelaufenen Jahr konnten sich erfreulicherweise die wichtigsten Indikatoren dieses Segments im Jahresvergleich verbessern. Verantwortlich für diese positive Entwicklung war insbesondere die weiterhin gute Geschäftslage bei den Coatern. Denn bei den Mask Alignern befand sich die Entwicklung auch in 2005 noch unter dem Einfluss der Restrukturierung, im Rahmen derer Mitte des Jahres das Werk Aßlar geschlossen wurde. Die dort ansässige Produktion, vor allem manueller Mask Aligner, wurde in das Werk Garching bei München integriert. Dabei wurden 39 Mitarbeiter abgebaut. Im Gegenzug wurden in den einzelnen Regionen die technische Kompetenz und die Servicekapazität ausgebaut.

Die Auftragseingänge für Mask Aligner entwickelten sich in den ersten 9 Monaten sehr schleppend: Aufträge für neue Maschinen lagen kumuliert um bis zu 40 % unter den Vorjahreswerten. Im vierten Quartal stellte sich jedoch eine positive Entwicklung ein, so dass Aufträge für neue Maschinen letztlich nur noch rund 12 % (30,1 Mio. EUR in 2005 gegenüber 34,3 Mio. EUR in 2004) unterhalb des Vorjahreswertes lagen. Etwas besser stellte sich die Umsatzentwicklung dar (27,2 Mio. EUR in 2005 gegenüber 28,8 Mio. EUR in 2004; -5 %).

Bei den Coatern setzte sich der positive Trend aus 2004 auch in 2005 fort. Die halbautomatische „Gamma“-Produktlinie erfreute sich weiterhin großer Beliebtheit. Das Produkt findet nicht nur Anklang bei den asiatischen Auftragsfertigern, sondern auch bei den Chipherstellern in der Mikrosystemtechnik und bei den Verbindungshalbleitern. Insgesamt zeigte sich die Nachfrage nach automatischen Geräten relativ stabil. Sie werden vor allem für 8-Zoll-Wafer in der Produktion von Mikrosystemen und im Advanced Packaging (hier 8- und 12-Zoll-Wafer) eingesetzt. Die manuellen Geräte finden insbesondere in universitären und betrieblichen Forschungseinrichtungen Anwendung; sie werden aber auch bei kleineren Produktionsanwendungen bei Verbindungshalbleitern und in der Mikrosystemtechnik eingesetzt.

Der Auftragseingang für Coater konnte nochmals deutlich um über 20 %, von 27,6 Mio. EUR (2004) auf 33,2 Mio. EUR, gesteigert werden. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Umsatz. Er stieg auf 27,9 Mio. EUR in 2005 gegenüber 23,0 Mio. EUR in 2004 (+21 %).

Unter Berücksichtigung von Service und Ersatzteilen ergab sich für das Segment Lithografie ein Auftragseingang in Höhe von insgesamt 75,5 Mio. EUR (Vorjahr: 74,0 Mio. EUR; +2 %). Der Segmentumsatz betrug insgesamt 66,6 Mio. EUR (Vorjahr: 61,8 Mio. EUR; +8 %).



Das Segmentergebnis verbesserte sich von 1,6 Mio. EUR auf 4,6 Mio. EUR (+3,0 Mio. EUR), wobei dies hauptsächlich auf einen von 26,6 Mio. EUR auf 29,4 Mio. EUR (+2,8 Mio. EUR) gesteigerten Rohertrag zurückzuführen ist. Die Rohertragsmarge stieg von 43,0 % auf 44,2 %. Besondere Ergebnisbelastungen in 2005 stellten die Beratungskosten für die Restrukturierung (rund 2,0 Mio. EUR) sowie negative Ergebniseffekte in Verbindung mit dem Verkauf der Immobilie in Aßlar (0,5 Mio. EUR außerplanmäßige Abschreibung) dar.

Der Rückgang des Segmentvermögens (netto) von 40,1 Mio. EUR in 2004 auf 37,5 Mio. EUR in 2005 (-7 %) ist bezüglich des Umlaufvermögens vor allem auf die erfolgreiche Verringerung des Lagerbestandes um 2,2 Mio. EUR (-7 %) zurückzuführen. Darüber hinaus war neben den Abschreibungen auf aktivierte F&E-Leistungen insbesondere der Abgang der Immobilie Aßlar für den Rückgang des Anlagevermögens um 14 % verantwortlich. Hinsichtlich rückläufiger Verbindlichkeiten sind die verringerten Kundenanzahlungen (17,6 Mio. EUR gegenüber 22,3 Mio. EUR im Vorjahr; -21 %) erwähnenswert.

Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder ist hinsichtlich Entwicklung und Produktion am Standort Waterbury, Vermont, in den USA angesiedelt. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus in kleinen Einheiten an wesentlichen Standorten in Europa und in Asien ansässig.

In den letzten zwei Jahren wurde das komplette Portfolio durch neu entwickelte Maschinen ersetzt. Die Durchdringung des Marktes mit diesen Systemen hat unverändert oberste Priorität, wobei wir überzeugt sind, in 2005 einen weiteren Schritt in diese Richtung getan zu haben.

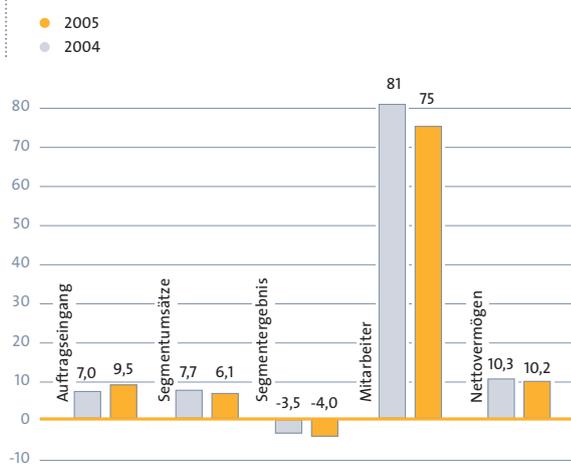
Insbesondere der sogenannte Bond Cluster, der vakuumfreies Bonden ermöglicht, stellt ein wichtiges Standbein für dieses Segment dar. Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten. Aufgrund der hohen Stückpreise der Bond Cluster prägt deren Entwicklung wesentlich den Geschäftsverlauf dieses Segments.

In 2005 konnte die Position der manuellen Geräte am Markt verbessert werden. Insbesondere in Nordamerika und in Asien stieg der Auftragseingang spürbar an. Die Nachfrage nach den Bond Clustern verbesserte sich leicht im Jahresvergleich. Die Anwendungen insbesondere des Wafer Bondings werden in der Zukunft weiter zunehmen – nicht zuletzt aufgrund der stei-

genden Bedeutung des „Chip-Stackings“ und des sogenannten „SOI-Bondings“ (Silicon-on-Insulator).

Jedoch lag der Umsatz aufgrund des hecklastigen Auftragseingangs, d.h. hohe Auftragseingänge erst zum Ende des Jahres, unterhalb des Vorjahreswertes. Es ergab sich ein Auftragseingang für das Segment in Höhe von 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 7,0 Mio. EUR; +36 %). Der Segmentumsatz betrug 6,1 Mio. EUR (Vorjahr: 7,7 Mio. EUR; -21 %).

Segmentübersicht Substrat Bonder in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt



Das negative Segmentergebnis erhöhte sich von -3,5 Mio. EUR im Vorjahr auf -4,0 Mio. EUR, wobei der Rohertrag mit 0,6 Mio. EUR um 36 % unter dem Vorjahr lag. Die Rohertragsmarge bei dieser Produktlinie ist derzeit mit 10,1 % (Vorjahr: 12,5 %) noch sehr niedrig. Dies ist sowohl bedingt durch eine noch nicht ausreichende Auslastung des Werkes in Waterbury, als auch noch nicht sichtbare positive Lernkurveneffekte. Die F&E-Aufwendungen wurden im Jahresvergleich nochmals deutlich von 1,0 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR erhöht, um so schnell wie möglich eine ausreichende Produktreife zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass sich ab 2006 eine spürbare Verbesserung der Marge einstellt.

Das Segmentvermögen (netto) änderte sich nur unwesentlich. Den um 1,7 Mio. EUR erhöhten Lagerbeständen standen um 1,5 Mio. EUR erhöhte Kundenanzahlungen gegenüber.

Device Bonder

Das Segment Device Bonder ist in St. Jeoire, Frankreich, ansässig. An diesem Standort befinden sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Aufgrund der technischen Komplexität und der geringen Größe des Marktes sind keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

Das Geschäftsumfeld für Device Bonder bleibt unverändert schwierig und schwer einschätzbar. Nach dem sehr schwachen Jahr 2004 entwickelte sich die Produktlinie auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2005 negativ, und blieb beim Auftragseingang sogar noch unter den Werten des Jahres 2004. Einen Großteil des Auftragsvolumens 2005 realisierten wir erst im vierten Quartal.

Prinzipiell ist das Produkt mit den Eigenschaften „hochgenau und geringer Durchsatz“ in einem sehr engen Markt platziert. In den Jahren 2000 und 2001 erlebte die Produktlinie einen Boom im Bereich optische Netzwerke, der jedoch 2002 abrupt endete. Seit dieser Zeit konnte sich kein ausreichend großer, neuer adressierbarer Markt entwickeln.

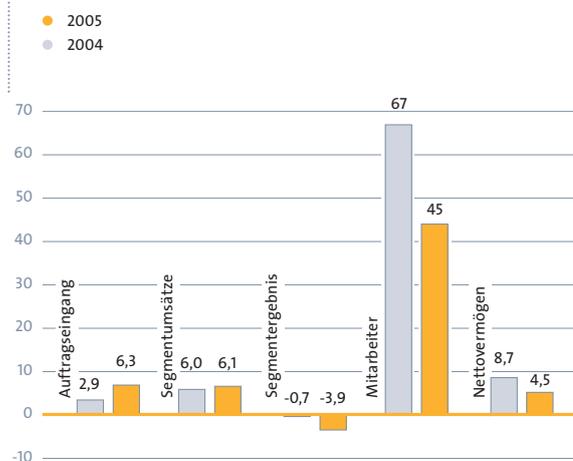
Als Konsequenz musste die Anzahl der Mitarbeiter im abgelaufenen Jahr nochmals drastisch von 66 auf 37 reduziert werden. Dadurch konnte die Kostenbasis soweit abgesenkt werden, dass das Segment in 2006 zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften sollte.

Im Laufe des Jahres 2005 wurden mehrere Überlegungen angestrengt, wie zukünftig mit der Produktlinie verfahren werden sollte. Dies wurde auch bereits im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2004 angekündigt. Erfreulicherweise stellte sich im vierten Quartal 2005 beim Auftragseingang eine spürbare Belebung ein, die vor allem auf Anwendungen in der Infrarot-Sensorik basierte. Mehrere Aufträge konnten in Asien akquiriert werden.

Die derzeit unzureichende langfristige Perspektive führte zu entsprechenden Wertberichtigungen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Ob der verbesserte Auftragseingang im vierten Quartal 2005 nachhaltiger Natur ist, wird sich aber erst im laufenden Jahr herausstellen.

Es ergab sich ein Auftragseingang für das Segment in Höhe von 6,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR; +114 %). Der Segmentumsatz betrug 6,1 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR; +2 %).

Segmentübersicht Device Bonder
in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt



Das Segmentergebnis belief sich auf -3,9 Mio. EUR (Vorjahr: -0,7 Mio. EUR). Dabei prägten vor allem folgende außerordentliche Wertberichtigungen diese Verluste:

- Vollabwertung des zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwertes -1,8 Mio. EUR
- Teilabwertung der Immobilie St. Jeoire -1,1 Mio. EUR
- Teilabwertung des Lagerbestandes -0,8 Mio. EUR

Die Rohertragsmarge verringerte sich von 64,0 % im Vorjahr auf 32,5 %. Die hohe Marge in 2004 war vor allem durch teilweisen Abverkauf von bereits wertberichtigten Beständen erheblich positiv begünstigt.

Der deutliche Rückgang des Segmentvermögens (netto) um 48 % ist auf Wertberichtigungen bei den kurz- und langfristigen Vermögenswerten zurückzuführen.

Darüber hinaus wurden rückläufige Forderungsbestände (-1,4 Mio. EUR) durch rückläufige Kundenanzahlungen (-1,3 Mio. EUR) im Wesentlichen kompensiert.

Test Systeme

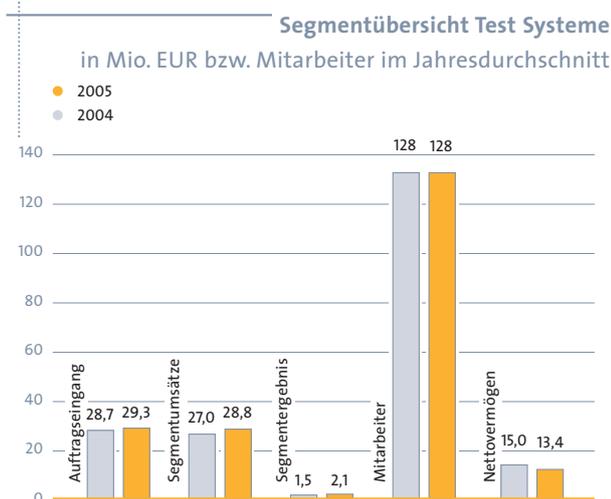
Dieses Segment stellt rund ein Viertel des Geschäftsvolumens der Gruppe dar und ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind hauptsächlich dort angesiedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment.

Die Test Systeme zeichnen sich vor allem durch eine weniger zyklische Geschäftsentwicklung aus. Auch die Entwicklung im Jahr 2005 war typisch für dieses Segment: Moderates, aber nachhaltiges Wachstum bei positivem Segmentergebnis.

Mit unseren Probern adressieren wir hauptsächlich Laboranwendungen, insbesondere z.B. die Fehleranalyse, aber auch teilweise Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme). Allerdings adressieren wir nicht Volumenmärkte im Bereich Halbleiterproduktion. Durch die Konzentration auf besondere Anwendungen konnten wir uns eine sehr gute Position am Markt erarbeiten, die zu oben erwähnter, positiver Entwicklung führte. Dennoch war 2005 deutlich spürbar, dass der Hauptwettbewerber und Marktführer, Cascade Microtech in den USA, den Druck am Markt verstärkte.

Innerhalb der Regionen stellt Europa als stärkste Region über 40 % des Gesamtgeschäftes dar. In Asien sind wir mit unseren Probern weniger stark vertreten, da hier vor allem Produkte für die Massenfertigung Anwendung finden. Diesen Bereich adressieren wir mit unseren Produkten nur in Randbereichen.

Der Auftragseingang steigerte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht von 28,7 Mio. EUR auf 29,3 Mio. EUR (+2 %). Bei den Umsätzen fiel der Zuwachs etwas größer aus, wo mit 28,8 Mio. EUR (Vorjahr: 27,0 Mio. EUR) ein Wachstum von 7 % erreicht wurde.



Das Segmentergebnis konnte im Jahr 2005 von 1,5 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR gesteigert werden. Dabei verringerte sich jedoch aufgrund der gestiegenen Wettbewerbsintensität die Rohertragsmarge im Jahresvergleich von 42,3 % auf 39,6 %. Der Zuwachs beim Segmentergebnis ist vor allem auf um 0,4 Mio. EUR verringerte F&E-Aufwendungen und Verbesserungen bei den sonstigen betrieblichen Erträgen um 0,4 Mio. EUR zurückzuführen.

Die Verringerung des Segmentvermögens (netto) beruht unter anderem auf um 1,0 Mio. EUR verringerten Lagerbeständen sowie auf um 2,1 Mio. EUR erhöhten Kundenanzahlungen.

Segment Sonstige

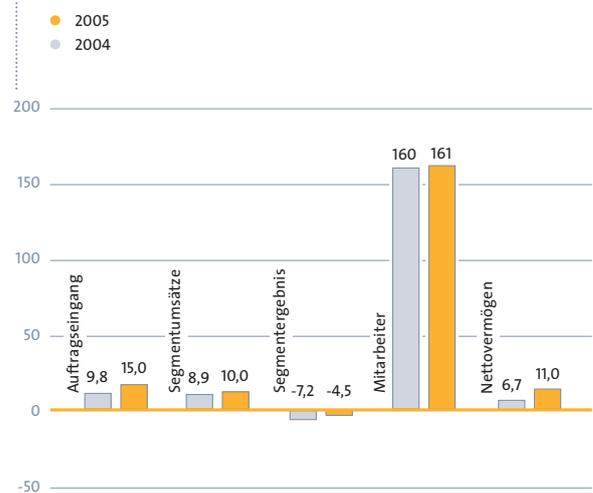
Das Segment Sonstige beinhaltet vor allem unser Geschäft mit den Masken für die Halbleiterindustrie (Palo Alto, Kalifornien/USA). Daneben sind unsere Aktivitäten in der Mikrooptik (Neuchatel, Schweiz) und sonstige Bereiche zugeordnet. Auch das Geschäftsfeld C4NP ist derzeit in diesem Segment berücksichtigt. Sobald C4NP für den Konzern eine entsprechende Bedeutung im operativen Geschäft erreicht, werden wir hierfür ein eigenes Segment bilden. Zum aktuellen Zeitpunkt trägt C4NP jedoch noch keine Umsätze bei, so dass bis auf weiteres keine gesonderte Darstellung erfolgt. Ebenfalls enthalten sind die nicht auf die Segmente zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen.

Die beiden Bereiche Masken und Mikrooptik entwickelten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv. In beiden Fällen konnte ein Umsatzwachstum verzeichnet werden. Während bei den Masken das Segmentergebnis erheblich gesteigert werden konnte, ging dieses bei der Mikrooptik aufgrund der deutlich gesunkenen Rohertragsmarge zurück. Beide Segmente steuerten ein positives Segmentergebnis in den Jahren 2004 und 2005 bei.

Der Ergebnisbeitrag von C4NP war in 2004 und 2005 unwesentlich, da derzeit vor allem zu aktivierende Entwicklungstätigkeiten anfallen.

Einen Großteil der Verwaltungsaufwendungen und damit auch des negativen Segmentergebnisses stellen die Aufwendungen der Konzernholding dar, soweit diese nicht den Segmenten zugeordnet werden.

Segmentübersicht Sonstige in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt



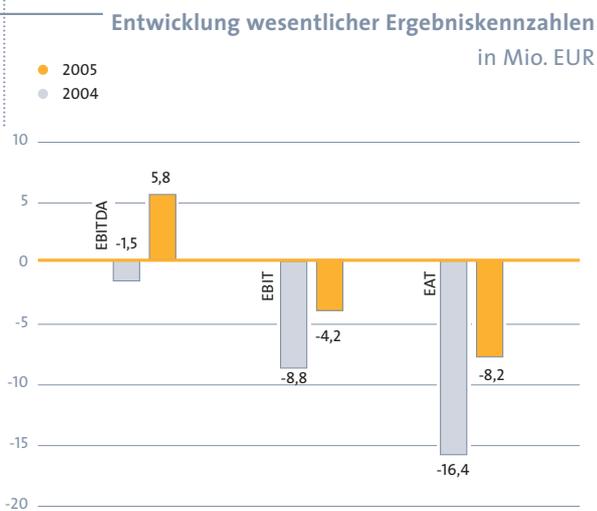
Der Segmentverlust verringerte sich von -7,2 Mio. EUR auf -4,5 Mio. EUR. Die Verwaltungskosten verringerten sich im Jahresvergleich um 2,2 Mio. EUR, wobei im Vorjahr Sondereffekte für die höhere Kostenbasis verantwortlich waren. Die Kosten für das Marketing reduzierten sich 2005 im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. EUR.

Die Aktivierung der Entwicklungsleistungen für die neue Produktlinie C4NP war weitgehend für die Erhöhung des Nettosegmentvermögens verantwortlich.

5. ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Ertragslage

Die Ertragssituation bei der SÜSS MicroTec-Gruppe ist stärker als bei anderen Unternehmen von der Entwicklung der Umsätze abhängig. So kann ein Umsatzwachstum von z. B. 20 % zu einer Ergebnisverbesserung von 40 % führen. In unserem Fall führt ein steigender Umsatz bei relativ konstanten Kosten für Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung zu deutlich steigenden Roherträgen. Diese wirken sich direkt auf das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) aus.

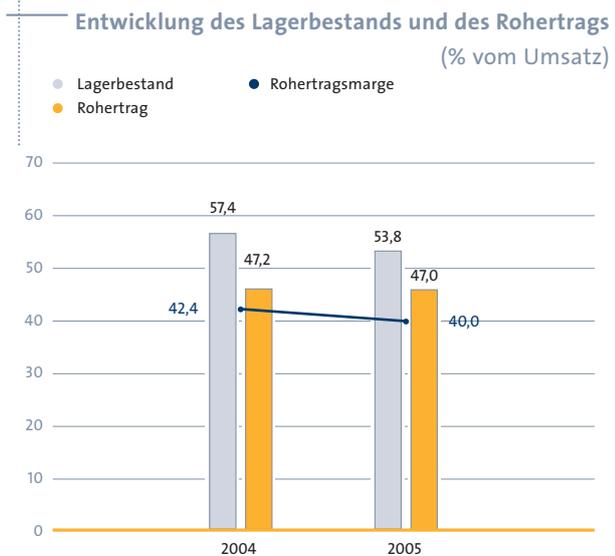


Auch das Jahr 2005 konnte noch nicht die Wende bei der Ergebnisentwicklung bringen. Wie schon in den Jahren davor, haben auch 2005 signifikante Sondereffekte das Ergebnis beeinflusst. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Erläuterungen zu den Segmenten Lithografie und Device Bonder.

Die operative Performance verbesserte sich jedoch deutlich. So konnten wir erstmals seit 2001 ein positives EBITDA von 5,8 Mio. EUR (Vorjahr: -1,5 Mio. EUR) erwirtschaften.

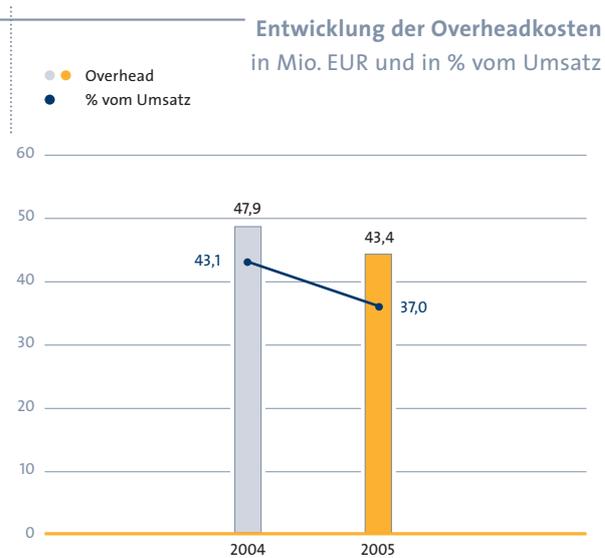
Rohertrag und Rohertragsmarge entwickelten sich im Jahresvergleich rückläufig. Zudem wirkten sich Teile der oben genannten Sondereffekte negativ auf die operativ erreichten Roherträge aus.

- Der Rohertrag sank von 47,2 Mio. EUR im Vorjahr auf 47,0 Mio. EUR.
- Die Rohertragsmarge sank von 42,4 % auf 40,0 %.



Innerhalb der Produktlinien weisen vor allem die Segmente Substrat Bonder und Device Bonder schwache Margen auf, bedingt unter anderem durch geringe Produktreife, Auslastungsprobleme und Wertberichtigungen. In den Segmenten Lithografie und Test Systeme wird die Margenentwicklung dagegen eher durch den Preisdruck beeinflusst.

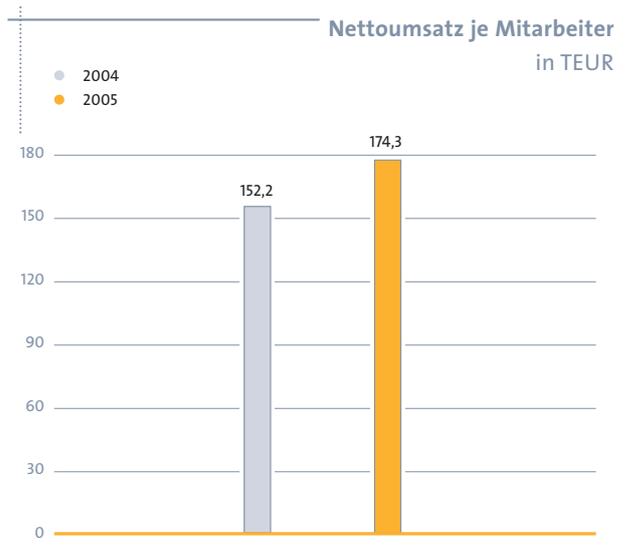
Erfreulicherweise konnte im Jahresverlauf der Lagerbestand erkennbar zurückgeführt werden. Dieser sank von 57,4 Mio. EUR auf 53,8 Mio. EUR (-6 %).



Durch weitere Einsparungen im Jahr 2005 wurden die Kosten für Verwaltung und Vertrieb deutlich von 47,9 Mio. EUR auf 43,4 Mio. EUR (-9 %) gesenkt. Somit ergab sich auch eine signifikant niedrigere Kostenquote (37 % in 2005 gegenüber 43 % in 2004) im Verhältnis zum Umsatz. Die Einsparungen wurden hauptsächlich durch eine Straffung der Managementstrukturen sowie eine erhebliche Konsolidierung der Marketingaktivitäten erzielt.

Enthalten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträgen, wurde aufgrund des wieder erstarkten US-Dollars im Jahr 2005 ein Ertrag realisiert (+1,0 Mio. EUR), während im Vorjahr noch ein Verlust entstanden war (-1,2 Mio. EUR).

Beim Steueraufwand wirkten wie im Vorjahr Wertberichtigungen auf aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge und temporäre Differenzen.



Der Nettoumsatz pro Mitarbeiter (auf Jahresendwert gerechnet) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14% von 152 TEUR auf 174 TEUR.

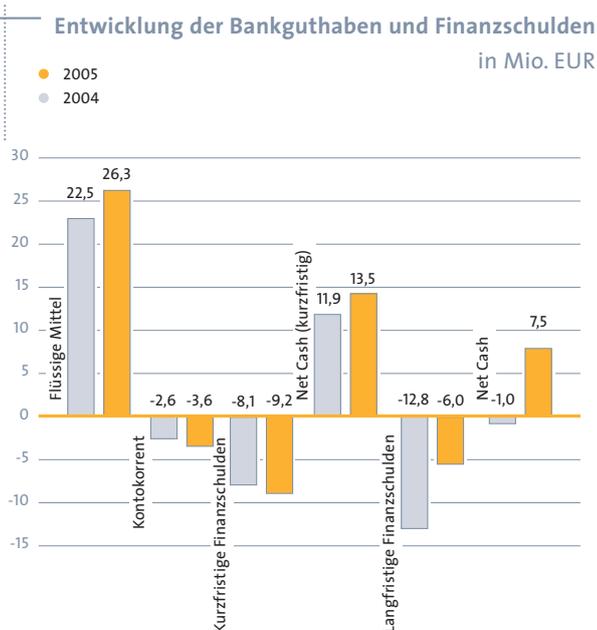
Finanz- und Vermögenslage

Unser Ziel ist, stets eine ausreichende kurzfristige Liquiditätsreserve für das operative Geschäft zu halten, um einen sprunghaften Auftragsanstieg und damit verbundene hohe Investitionen in das Working Capital finanzieren können. Diese Reserve soll grundsätzlich als Barmittel zur Verfügung stehen; Kreditlinien sollen als flankierende Maßnahme dienen. Die zum 31.12.2005 ausgelaufenen Kreditlinien in Deutschland (8,5 Mio. EUR) sollen 2006 in ähnlicher Höhe wieder hergestellt werden.

Der derzeitige Überschuss beim Net Cash wird beibehalten, solange keine wesentlichen Aktivitäten im Bereich Mergers& Acquisitions oder größere Investitionsvorhaben geplant sind. Sofern solche Aktivitäten zum Tragen kämen, würden wir bei zusätzlichem Finanzierungsbedarf auf eine ausreichende Fristigkeit Wert legen. Wir sind überzeugt, dass unsere Finanzierungs politik wesentlich dazu beigetragen hat, die schwierige Unternehmensentwicklung seit 2002 hinsichtlich der Liquidität und Verschuldung gut zu beherrschen.

Die Liquiditätsentwicklung in 2005 war neben dem Zufluss aus dem operativen Geschäft vor allem durch Aktivitäten innerhalb der Passivseite geprägt. Zum einen wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot durchgeführt, zum anderen wurde der größere Teil der in 2003 begebenen Wandelanleihe getilgt.

Die Liquiditätskennzahlen entwickelten sich im Jahresvergleich positiv. Der Forderungsbestand verringerte sich trotz des gestiegenen Umsatzes, wobei jedoch die Kundenanzahlungen leicht zurück gingen. Insgesamt gehen wir zum Ende des Jahres 2005 deutlich gestärkt in das aktuelle Geschäftsjahr. Die Gesamtsituation bei den Finanzschulden hat sich im Jahresverlauf erheblich verbessert. So hat sich der kurzfristige Liquiditätsüberschuss (Fristigkeit 1 Jahr) von 11,9 auf 13,5 Mio. EUR verbessert. Insgesamt betrug die Net Cash Position zum Jahresende 2005 +7,5 Mio. EUR (Vorjahr: -1,0 Mio. EUR).



Die im ersten Halbjahr 2006 fälligen wesentlichen Tilgungsleistungen, vor allem die zweite Tranche der Wandelanleihe (3,6 Mio. EUR) sowie die Projektfinanzierung der IBM Kreditbank GmbH (2,5 Mio. EUR per 31.12.2005), können aus der bestehenden Liquidität heraus bedient werden.

Beim Working Capital ist insbesondere die Verringerung des Lagerbestandes um 3,6 Mio. EUR hervorzuheben. Dem gegenüber steht eine Reduzierung der sonstigen kurzfristigen Rückstellungen um 2,7 Mio. EUR. Mit der Entwicklung des Lagerbestand in 2005 sind wir zufrieden, wobei sich die Kundenanzahlungsquote – wie erwartet – nicht erhöhte.

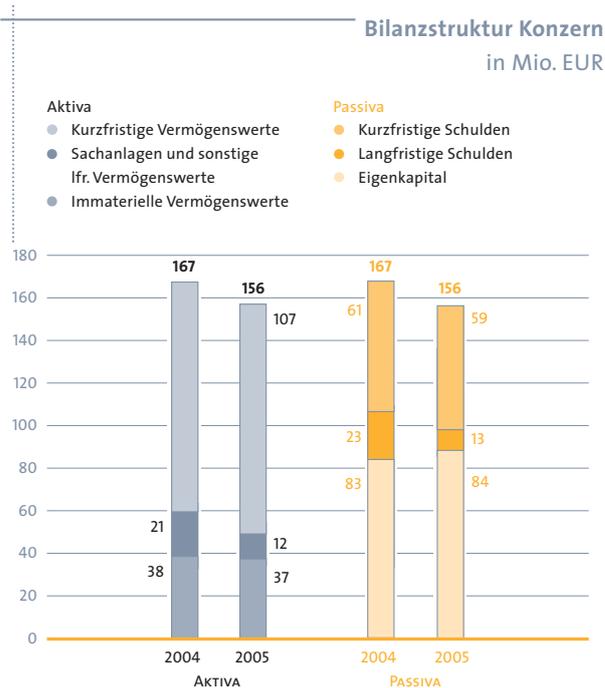
Die wesentlichen Änderungen bei den kurzfristigen Vermögenswerten sind somit auf den erhöhten Barbestand und die verringerten Lagerbestände zurückzuführen. Die Verringerung bei den langfristigen Vermögenswerten ist vor allem auf folgende Ereignisse zurückzuführen:

- Wertberichtigung und Abgang der Immobilie Aßlar 1,7 Mio. EUR
- Wertberichtigung der Immobilie St. Jeoire, Frankreich 1,1 Mio. EUR
- Änderung der latenten Steueransprüche 6,5 Mio. EUR

Durch den wieder erstarkten US-Dollar wurde die Wertberichtigung auf den Geschäfts- oder Firmenwert bei den Device Bondern (1,8 Mio. EUR) teilweise wieder kompensiert.

Die Bilanzstruktur des Konzerns bleibt somit unverändert stabil. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 50 % auf 54 %.

- KONZERNSTRUKTUR*
- UNTERNEHMENSSTEUERUNG*
- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
- GESCHÄFTSVERLAUF*
- ▶ ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE
- MITARBEITER
- UMWELT
- NACHTRAGSBERICHT
- RISIKOBERICHT
- PROGNOSEBERICHT



Investitionen

Aufgrund der Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich. Ausnahmen stellen nur die in dem Segment Sonstige enthaltenen Produktlinien „Fotomaschinen“ und „Mikrooptik“ dar. In beiden Fällen wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesen Bereichen führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen weiterhin in einem Bereich von ca. 2–3 % des Umsatzes bewegen werden.

Während bei Anwendung von US-GAAP Entwicklungsleistungen im Konzern sofort aufwandswirksam verbucht wurden, sind gemäß IFRS bei Erfüllung bestimmter Kriterien Entwicklungsleistungen zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben. Da die Entwicklung neuer Produkte eine der wichtigsten Aktivitäten zur Sicherung der nachhaltigen Unternehmensentwicklung repräsentiert, wird unter IFRS ein bestimmter Anteil der Entwicklungsleistungen nun als Investition in immaterielle Vermögenswerte ausgewiesen.

Den größten Anteil an den Investitionen stellte in 2005 die Entwicklung der Maschinen für die C4NP-Technologie dar. Zukünftig erwarten wir, dass von den ca. 8 bis 10 Mio. EUR Ausgaben für Forschung und Entwicklung rund 25 bis 35 % aktiviert werden und der verbleibende Betrag aufwandswirksam erfasst wird.

Die Holding – SÜSS MicroTec AG

(Hinweis: Den Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Investor Relations-Abteilung.)

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und der Finanzierung der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für die Corporate Identity auf den Gebieten Investor Relations und Marketing verantwortlich.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleiniger Anteilseigner an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften.



Wesentliche Veränderungen bei den Vermögenswerten und Schulden der Holding

Die Ausleihungen und Forderungen der Muttergesellschaft an verbundene Unternehmen verringerten sich im Jahresvergleich von 46,7 Mio. EUR auf 41,1 Mio. EUR. Diese Verringerung beinhaltet auch die Aufrechnung von Entwicklungsleistungen für C4NP mit bestehenden Verbindlichkeiten.

Aus dem im Vorjahr mit der IBM Deutschland Kreditbank GmbH geschlossenen Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme in Höhe von 3,4 Mio. EUR wurde im Geschäftsjahr ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 1,3 Mio. EUR ausbezahlt. Der Darlehensbetrag dient zur Finanzierung der Entwicklung einer Produktionsmaschine gemäß Joint Development Agreement mit der IBM Corporation, USA. Es wurde ein variabler Zinssatz in Höhe des Ein-Monats-Euribors zuzüglich 5,15 % p.a. vereinbart. Die Auszahlung des Darlehens richtet sich nach dem Projektfortschritt. Zum Bilanzstichtag waren insgesamt 2,5 Mio. EUR ausgezahlt. Das Darlehen ist spätestens am 30. Juni 2006 vollständig zurückzuführen.

Vertragsgemäß hat die Gesellschaft zum 31. Oktober 2005 einen Teilbetrag aus der im November 2003 begebenen Wandelanleihe in Höhe von 5,6 Mio. EUR zurückbezahlt. Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Gesamtbetrag der Wandel- und Optionsanleihe noch auf insgesamt 4,0 Mio. EUR.

Die Gesellschaft hat bei Ausgabe der Wandelanleihe im Jahr 2003 den für das Wandlungsrecht zugeflossenen Betrag als Aufgeld in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB eingestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem passivierten Rückzahlungsbetrag der Anleihe und dem Ausgabebetrag einer reinen Anleihe ohne Wandlungsrecht wurde unter den Rechnungsabgrenzungsposten als Disagio nach § 250 Abs. 3 S. 1 HGB aktiviert. Das Disagio wird über die Laufzeit der Anleihe aufgelöst und beträgt zum 31. Dezember 2005 noch 0,1 Mio. EUR (i. Vj. 0,7 Mio. EUR).

Das Gezeichnete Kapital wurde am 26. August 2005 aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um 1,5 Mio. EUR auf 16,6 Mio. EUR erhöht. Der Bezugspreis für die

neuen Aktien betrug 4,70 EUR pro Aktie. Insgesamt ergab sich aus der Kapitalerhöhung ein Brutto-Mittelzufluss von 6,8 EUR Mio. Der Aufsichtsrat hat dieser Kapitalerhöhung zugestimmt. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2005 vollumfänglich gewinnberichtigt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 6. September 2005.

Infolge der Ausübung von insgesamt 180.000 Bezugsrechten in den im Aktienoptionsplan 2002 vorgesehenen Ausübungszeiträumen wurde das Gezeichnete Kapital aus bedingtem Kapital 2002/II durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um 0,2 Mio. EUR auf 16,8 Mio. EUR erhöht. Die Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister erfolgte im Januar 2006.

Der kurzfristige Finanzbedarf ist durch die bestehende Barliquidität gedeckt. Diese hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Mio. EUR erhöht.

Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2005 ein Jahresfehlbetrag von 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: -3,4 Mio. EUR).

Im Jahr 2005 wurde der Ergebnisabführungsvertrag mit der Suss MicroTec Test Systems GmbH, Dresden, wirksam. Durch diesen wurden bei der SÜSS Holding 0,2 Mio. EUR ergebniswirksam.

Sonstige betriebliche Erträge stellten vor allem Fremdwährungsgewinne in Höhe von 3,2 Mio. EUR sowie periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR dar.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Weiterbelastung von Entwicklungsleistungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR im Rahmen des C4NP-Projekts und durch Fremdwährungsverluste in Höhe von 2,3 Mio. EUR geprägt.

In der SÜSS MicroTec AG waren zum Ende des Geschäftsjahres 2005 16 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter und 2 Vorstände aktiv tätig.

- KONZERNSTRUKTUR*
- UNTERNEHMENSSTEUERUNG*
- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG*
- GESCHÄFTSVERLAUF*
- ▶ ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE
- ▶ MITARBEITER
- UMWELT*
- NACHTRAGSBERICHT*
- RISIKOBERICHT*
- PROGNOSEBERICHT*

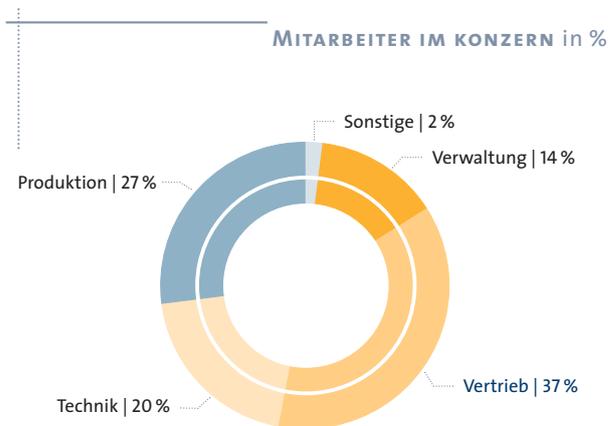
Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding (TEUR):

Gesellschaft	SMT AG (HGB)			
	2005	2004	Änderung	in %
Jahresfehlbetrag	-545	-3.417	2.872	-84 %
Eigenkapital	99.171	92.215	6.956	8 %
Bilanzsumme	115.837	116.575	-738	-1%
EK-Quote in %	86 %	79 %		
Anlagevermögen	77.877	84.562	-6.685	-8 %
in % der Bilanzsumme	67 %	73 %		
Umlaufvermögen	37.961	32.013	5.948	19 %
in % der Bilanzsumme	33 %	27 %		

6. MITARBEITER IM KONZERN

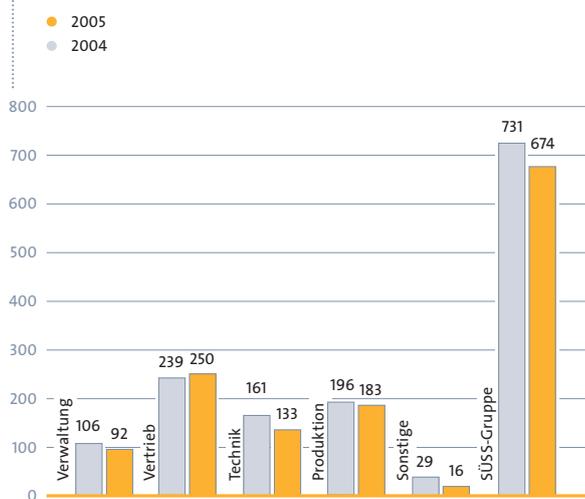
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswertes dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

SÜSS MicroTec hat bereits heute einen hohen Anteil der Wertschöpfung in der Herstellung der Produkte nach Außen verlagert. Die Materialquote liegt in der Regel bei 60 – 70 %. Daher ist ein wesentlicher Anteil von 57 % der Mitarbeiter nicht in der Produktion, sondern im (technischen) Vertrieb, dem Service und in der Vertriebsunterstützung sowie im internen Entwicklungsbereich tätig. Die Mitarbeiter in der Produktion stellen nur 27 % der Gesamtbelegschaft dar.





Entwicklung der Mitarbeiterzahlen nach Bereichen



Zum Ende des Jahres 2005 waren 674 (Vorjahr: 731; -7,8 %) Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschäftigt. Im Berichtsjahr beeinflussten folgende Maßnahmen die Änderung der Mitarbeiterzahlen:

- Die in 2004 beschlossene Schließung des Werkes Aßlar führte zum Abgang von 39 Mitarbeitern.
- In Teilbereichen wurden in Garching Mitarbeiter aufgebaut, um für die von Aßlar nach Garching verlagerten Aktivitäten ausreichend Kapazitäten bereitstellen zu können.
- Im Rahmen eines Overhead-Kostensenkungsprogramms wurden in mehreren Gesellschaften in den Bereichen Verwaltung und Vertrieb Mitarbeiter abgebaut.
- Im Werk St. Jeoire, Frankreich, wurden im Rahmen einer weiteren Reduktion der Kostenbasis 18 Stellen abgebaut.

Wie bereits im Vorjahr formuliert, ist unser langfristiges Ziel der Aufbau, Erhalt und die Entwicklung einer Stammebelegschaft, der eine weitreichende Perspektive innerhalb der SÜSS MicroTec-Gruppe offeriert werden kann.

7. GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Nach dem Jahr 2001 konnte der Konzern bis 2005 kein positives Nachsteuerergebnis mehr erzielen. In dieser Zeit wurde das Personal um etwa 30 % abgebaut und darüber hinaus auch Standorte geschlossen. Trotzdem war in dieser Zeit die Finanzlage durchgehend soweit gesichert, dass Liquiditätsengpässe nicht auftraten. Zum Jahresende stellte sich die Finanzlage erneut verbessert dar; wir verfügten zum 31.12.2005 über eine deutlich positive Net Cash-Position.

Die Ertragslage war im abgelaufenen Geschäftsjahr unverändert nicht zufriedenstellend. Jedoch konnten wir bereits ein positives EBITDA erwirtschaften, welches die deutlich verbesserte Ergebnisperformance ausdrückt. Unser Ziel eines ausgeglicheneren Ergebnisses haben wir nicht erreicht, unter anderem bedingt durch die erwähnten Sondereffekte.

8. UMWELT

Während in unserem Produktionsprozess kaum umweltbelastende Stoffe Verwendung finden oder entstehen, setzen unsere Kunden in der Produktion von Halbleitern und Mikrosystemen zahlreiche chemische Stoffe ein. Daher ist unser Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unserer Umwelt im Wesentlichen von den verwendeten Prozessen und Materialien im Produktionsprozess unserer Kunden abhängig.

Jedoch können wir einen indirekten Beitrag leisten indem wir Maschinen produzieren, die eine Verwendung von umweltfreundlicheren Materialien ermöglichen. Der von IBM entwickelte C4NP-Prozess beispielsweise erlaubt die bleifreie Verarbeitung von Chips.

Darüber hinaus werden unsere Produkte beispielsweise in der Automobilzulieferer-Industrie bei der Produktion von Sensoren eingesetzt, die nachhaltig die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen: Airbags und Antiblockiersysteme sorgen dafür, dass die individuelle Mobilität immer sicherer wird. Aber auch intern spielt die Arbeitssicherheit eine wichtige Rolle: In Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft werden die Mitarbeiter der SÜSS MicroTec regelmäßig zum Thema „Sicherheit am Arbeitsplatz“ geschult. Die Reinräume entsprechen den anspruchsvollen Sicherheitsstandards, so dass das Arbeiten mit gefährlichen Chemikalien so risikoarm wie möglich geschehen kann. Für den Notfall sind Mitarbeiter auch in spezifischen Erste-Hilfe-Maßnahmen ausgebildet.

Wir sind überzeugt, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen angemessenen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unserer Umwelt leisten.

9. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Es haben sich nach dem Bilanzstichtag bis zur Erstellung des Konzernabschlusses keine angabepflichtigen Ereignisse ergeben.

10. RISIKOBERICHT

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken

Politische Rahmenbedingungen

Vor allem das bestehende Konfliktpotential im Nahen Osten könnte erheblichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf 2006 nehmen. Hinzu kommen Risiken bei der Embargopolitik in mehreren asiatischen Ländern bzw. bei speziellen Kunden der Gruppe, wobei diese Risiken von deutlich geringerem Ausmaß sind.

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die anhaltende Krise des Halbleitermarktes und die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehören unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Diesen Risiken begegnen wir durch die angepassten Strukturen, die bei wieder zunehmender Geschäftstätigkeit vor allem extern – durch Outsourcing – ausgeweitet werden sollen.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

Abhängigkeit von einzelnen „Know How-Trägern“

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

Betriebliche Risiken

Vermögens- und Ertragslage

Sowohl bei Aktivwerten der Holding als auch bei der Konzernbilanz könnten bei anhaltend ausbleibender Ertragskraft signifikante Wertberichtigungen notwendig werden. Diese hätten wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage der Muttergesellschaft und des Konzerns, würden aber nicht liquiditätswirksam werden. Durch konzernweit gültige Bewertungsregelungen sollen latente Überbewertungen vermieden werden.



Preisdruck und Währungsentwicklung

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten. Weniger kontrollierbar ist die aktuell hohe Volatilität vor allem des US-Dollars, da Geschäfte in diesem Währungsraum in der Regel mit unverändertem US-Dollarpreis getätigt werden. Hier haben wir bereits aktiv reagiert und werden die anteilige Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten kontinuierlich erhöhen. Jedoch kann dies nicht in der Geschwindigkeit erfolgen, wie es derzeit bei der Währungsentwicklung der Fall ist. Ein grundsätzliches Risiko könnte ein weiteres langfristiges Erstarken des Euros gegenüber dem US-Dollar und dem Japanischen Yen bedeuten, da ab einer gewissen Grenze die derzeitige Aufteilung der Wertschöpfung nicht mehr ergebnisoptimal wäre. Kurzfristige Schwankungen gleichen wir in der Regel durch Sicherungsgeschäfte aus. Die Währungssicherung erfolgt bis zu 12 Monate im voraus, wobei grundsätzlich aufgrund der branchenbedingten Unvorhersehbarkeit des Geschäftsverlaufes nur ein Teilbetrag abgesichert wird.

Zugang zu Fremdkapital und Zinsänderungsrisiko

Wir erwarten zukünftig geänderte Rahmenbedingungen in der Fremdkapitalbereitstellung vor allem durch die Einführung von „Basel II“. Die Minimierung der Abhängigkeit insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cash Flows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Das Zinsänderungsrisiko ist begrenzt, da die wesentlichen Fremdkapitalpositionen auf Darlehensbeträgen mit festen Zinssätzen basieren.

Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität, kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potentielle Risiko soweit möglich limitiert.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2005 keine bestandgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet. Die aktuelle Eigenkapitalausstattung lag weit über dem Risk Adjusted Capital, das den Eigenkapitalanteil darstellt, der zur Deckung potentieller Verluste mindestens vorgehalten werden muss.

Risikomanagement-System

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (KonTraG) ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potentiellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr sind wir stets darauf aus, ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz zu erreichen. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikomanagement-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Risiken werden für das Unternehmen als „wesentlich“ eingestuft, wenn sie entweder als Einzelrisiko oder aber kumulativ eine maximale Schadenshöhe von 1 Mio. EUR erreichen oder übertreffen.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

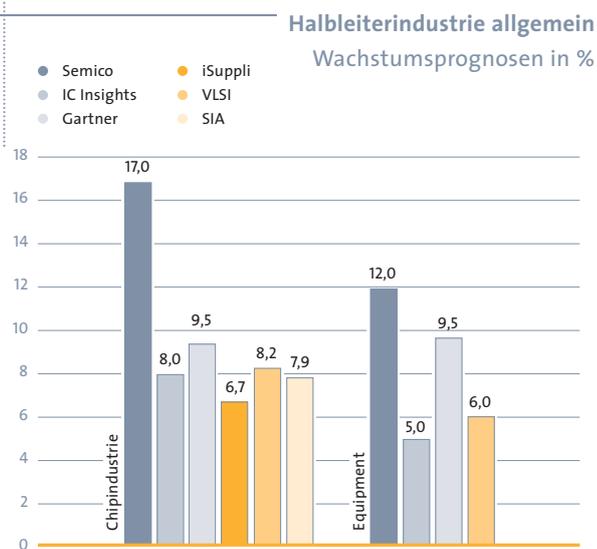
Zur weiteren Minderung unserer Risikoposition wurde bereits Anfang 2004 das bestehende konzernweite Versicherungsprogramm optimiert. Es konnten mit Hilfe eines weltweit agierenden Maklers sowohl hinsichtlich der Versicherungssummen als auch bezüglich des inhaltlichen Versicherungsschutzes deutliche Verbesserungen erzielt werden.

11. PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr 2006 zeigen die relevanten Indikatoren derzeit keine grundsätzliche Änderung des Geschäftsumfeldes auf. Dies gilt vor allem für exogene Indikatoren.

Halbleiterindustrie allgemein

So wird bei der Chipindustrie ein weiteres Wachstum auch in 2006 erwartet. Dabei gibt es von den unterschiedlichen Research-Instituten teilweise deutlich abweichende Prognosen:



In der Mehrzahl wird von Wachstumsraten von rund 7 – 8 % in der Chipindustrie, und einem für die Branche moderaten Anstieg bei den Equipment-Herstellern ausgegangen. Jedoch ist die Varianz bei den Vorhersagen für Equipment deutlich größer; diese reichen von 5 % bis zu 12 % Wachstum. SÜSS wird, wie in der Vergangenheit, nicht direkt von der Entwicklung des Gesamtmarktes abhängen. Jedoch wirkt sich die Stimmung des Gesamtmarktes spürbar auf das Geschäftsklima unserer wesentlichen Kunden aus.

Neben diesen exogenen Indikatoren wollen wir bei den endogenen Indikatoren vor allem auf den Auftragsbestand zum 01.01.2006 hinweisen. Dieser beträgt 85 Mio. EUR nach 66 Mio. EUR zum 01.01.2005 (+30 %), und bildet eine solide Basis für die Umsatzerwartung der ersten rund 7 – 9 Monate des laufenden Jahres.

Die Entwicklung in 2005 und auch die Projektionen für 2006 für die Halbleiterindustrie sind möglicherweise auch der Beginn einer Entwicklung zu einer neuen Reifephase. Einige Institute und auch wir gehen davon aus, dass sich die Industrie in dieser Phase auf einem langfristigen Wachstum in der Größenordnung von 10 % einpendeln wird. Wesentliche Aussagen aus unserem letzten Lagebericht wollen wir an dieser Stelle nochmals wiederholen:

- Die großen Wachstumsraten bei den Investitionen basierten auf so genannten Killer-Applikationen. Die großen Märkte werden zukünftig mit Wachstumsraten unter 20 % erwartet (Quelle: SIA).
- Der Privatkonsument gewinnt immer mehr Bedeutung für die Halbleiterindustrie, und die Schwankungen dieser Konsumentengruppe sind in der Regel deutlich geringer als die der Industriekunden.
- Es wird weiterhin Ausschläge und Volatilitäten geben, jedoch unserer Meinung nach mit deutlich geringeren Amplituden als in der Vergangenheit. So sind durchaus Abweichungen von +/-10 % bis +/-20 % in Einzeljahren nicht auszuschließen, aber Umsatzsprünge wie in 2000 (+86 %) erwarten wir nicht mehr (Angaben gemäß früherer Rechnungslegung US-GAAP).

- KONZERNSTRUKTUR*
- UNTERNEHMENSSTEUERUNG*
- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
- GESCHÄFTSVERLAUF*
- ERTRAGS- UND FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE
- MITARBEITER
- UMWELT
- NACHTRAGSBERICHT
- RISIKOBERICHT
- PROGNOSEBERICHT

Darüber hinaus stellten wir im Bereich Mergers&Acquisitions im abgelaufenen Jahr 2005 intensive Aktivitäten fest. Dabei handelte es sich nicht nur um Firmenübernahmen, sondern oftmals um Kooperationen oder potenzielle Ausgründungen von Teilbetrieben. Auch diese Aktivitäten weisen darauf hin, dass die Industrie in die bereits angesprochene neue Reifephase eintritt. Hinsichtlich der Rolle der SÜSS MicroTec hat sich die Situation insoweit verbessert, als dass wir über eine bessere Marktka-
pitalisierung verfügen, und C4NP eine sinnvolle Diversifikation mit sehr gutem Umsatzpotenzial in unserem Produktportfolio darstellt.

Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

Advanced Packaging

Grundsätzlich erwarten wir in diesem Markt die stärkste Wachstumsdynamik innerhalb der SÜSS-Gruppe und somit auch im Segment Lithografie: Fast ausschließlich die Lithografieprodukte adressieren als umsatzstarke Produktionsmaschinen derzeit diesen Markt. Zukünftig soll auch C4NP wesentliche Umsatzbeiträge aus diesem Markt generieren, denn diese Produktlinie findet nur im Advanced Packaging Anwendung.

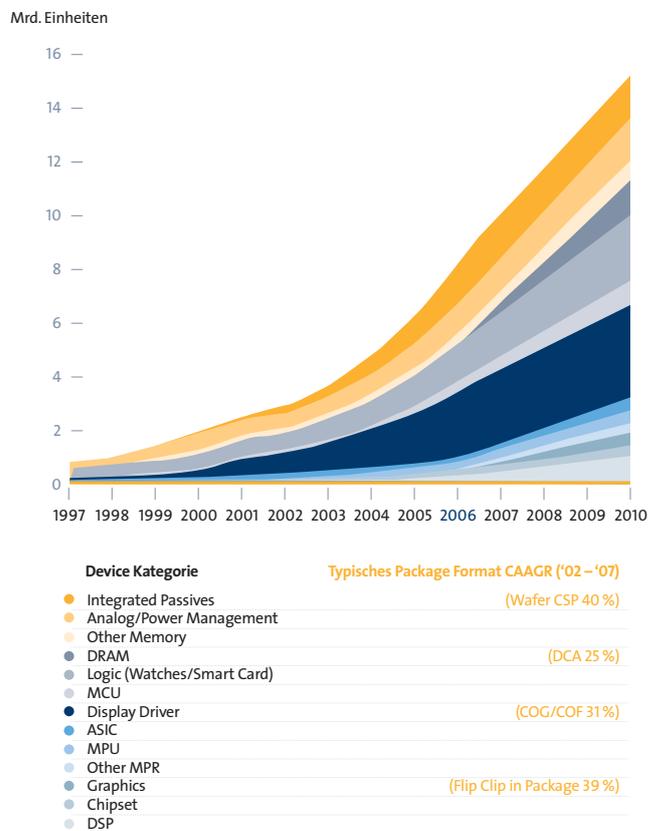
Grund für die erwartete Dynamik ist vor allem, dass dieses Wachstum nicht allein vom Wachstum der Branche abhängt. Vielmehr erwarten wir, dass Advanced Packaging stetig das klassische Wire Bonding bei bestimmten Chiptypen im Zeitverlauf verdrängt. Aufgrund dieser Technologieverdrängung ergeben sich auch Wachstumspotenziale in Zeiten stagnierender oder gar rückläufiger allgemeiner Marktentwicklungen in der Halbleiterindustrie.

Mehrere Research-Institute bestätigen hier unsere Annahme. Während derzeit nur rund 5 – 10 % aller Chips mit der modernen Kontaktierungsmethode gefertigt werden, wird bis zum Jahr 2010 eine Verdoppelung dieses Anteils erwartet. Dies bedeutet, dass in den nächsten 3 – 4 Jahren die vorhandene Kapazität für Advanced Packaging – welche vor allem in den letzten 10 Jahren

installiert wurde – ebenfalls verdoppelt werden muss. Wir erwarten, dass ein hoher Anteil dieser Kapazitätserweiterung auf 300 mm-Fertigungslinien entfällt. Auch gehen wir davon aus, dass unsere gute Wettbewerbsposition bei den asiatischen Auftragsfertigern unverändert bestehen bleibt.

Die nachstehende Grafik zeigt eine Prognose, wie sich die Anwendung der Advanced Packaging Technologie bei verschiedenen Chiparten bis 2010 entwickeln soll.

Weltweiter Konsum von Flip Chip Devices
(Inkl. Flip Chip in Package, DCA, COF/COG und Wafer CSP)



Quelle: PRISMARK



Jährliche Wachstumsraten von 10 % oder auch deutlich mehr sind in diesem Markt unserer Ansicht nach durchaus möglich. Hinzu kommen weitere Geschäftschancen von erheblicher Bedeutung, die dieses Wachstum nochmals nachhaltig steigern könnten:

Der Speicherchip DRAM wird derzeit fast vollständig mittels Wire Bonding gefertigt; nur ein kleiner Anteil hochwertiger Speicherchips entfällt auf das Advanced Packaging. Die aufkommende Generation der sogenannten DDR3-DRAM stößt bei den Taktfrequenzen in Regionen von 800 Mhz und mehr vor. Im Bereich der CPUs (Hauptprozessoren), die bereits mit Advanced Packaging gefertigt werden, wurde seinerzeit bei diesen Taktfrequenzen der Technologiewechsel vollzogen. Sollte die Massenproduktion von Speicherchips ebenfalls auf das Advanced Packaging wechseln, hätte dies einen erheblichen zusätzlichen Kapazitätsbedarf für Fertigungslinien zur Folge. Der DRAM stellt ein erhebliches Produktionsvolumen dar und würde somit auch für uns eine erhebliche Vergrößerung des adressierbaren Marktes darstellen.

Im obigen Schaubild hingegen ist nur ein geringer Anteil für DRAMs enthalten. Ob der DRAM in der Generation DDR3 den Technologiewechsel zum Advanced Packaging vollzieht, werden wir Ende des Jahres 2006 bzw. Anfang des Jahres 2007 besser beurteilen können. Im Falle einer geplanten Umstellung gehen wir davon aus, dass die DRAM-Hersteller in diesem Zeitfenster auf die Hersteller von Equipment für Advanced Packaging-Fertigungslinien zukommen würden. Grund: Das bereitzustellende Volumen an Equipment für die DRAMs müsste frühzeitig definiert werden, um einer Unterversorgung mit entsprechenden Maschinen vorzubeugen.

Eine weitere Geschäftschance stellt C4NP dar, bei der wir in 2005 bereits den ersten Auftrag für eine Produktionslinie von der IBM Corp. erhalten haben. Mit dieser Produktlinie wird ausschließlich der Markt Advanced Packaging bedient und eine Alternative vor allem zum derzeitigen Verfahren des Electroplatings ange-

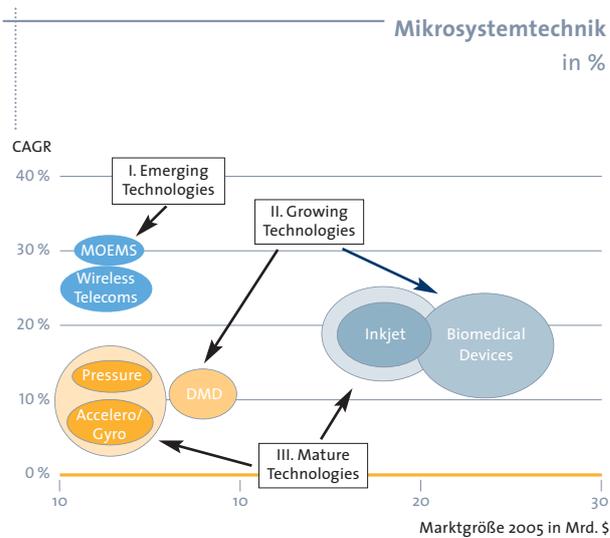
boten. Electroplating findet insbesondere bei feinen Strukturen Verwendung und trifft auf weniger konkurrenzfähige Wettbewerbsttechnologien. Mit C4NP wird eine völlig andere Verfahrensweise angeboten, die ebenfalls für feine Strukturen geeignet ist. Hinzu kommen Vorteile hinsichtlich der Prozesseigenschaften, unter anderem:

- Kostengünstiges und einfaches Herstellen bleifreier Kontakte
- Flexibilität hinsichtlich Verwendung unterschiedlicher Materialien

Für 2006 erwarten wir ein weiterhin gutes Umfeld im Advanced Packaging, wie es bereits 2004 und 2005 der Fall war. So waren die ersten drei Quartale im abgelaufenen Jahr zwar zurückhaltend, jedoch verlief das vierte Quartal im Auftragseingang positiv. Bezüglich C4NP ist das wesentliche Ziel, in 2006 sogenannte „early adopters“ nach der Bestellung durch IBM selbst für dieses Produkt zu gewinnen. Die Technologie ist zukunftsweisend und neu; auch das Interesse der potenziellen Kunden ist unverändert hoch. Der langfristige Markterfolg hängt letztlich vor allem von der Akzeptanz durch Schlüsselunternehmen in der Industrie ab. Daher wird 2006 auch dahingehend bedeutsam, welche Kunden für C4NP gewonnen werden können.

Mikrosystemtechnik

Die Mikrosystemtechnik weist eine hohe Diversifizierung auf, sowohl bei den Produkten selbst, als auch bei den Herstellern der Produkte. Im Gegensatz zum Mikrochip, der in der Regel in großen Stückzahlen extrem kostengünstig gefertigt wird, sind bei den Mikrosystemen die Stückzahlen oftmals geringer und die Variantenvielfalt deutlich höher. Die Mikrosystemtechnik hängt nicht von einzelnen Endmärkten ab, sondern wird vielmehr durch die allgemeine Konjunktur und das Investitionsklima generell beeinflusst.



Die derzeit größten Anteile für die Mikrosystemtechnik stellen Anwendungen in der Automobilindustrie und der Computer-Peripheriegeräte, z.B. Tintenstrahldrucker, dar. So repräsentieren Druck- und Beschleunigungssensoren (zum Beispiel Airbagsensoren) sowie Druckerköpfe für Tintenstrahldrucker derzeit jeweils rund 30 % aller Mikrosysteme. Darüber hinaus entfallen weitere knapp 20 % auf die Mikrospiegel für Rückprojektions-TV. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Mikrosystemen ergeben sich stets neue adressierbare Märkte, so dass wir langfristig von einem Wachstum für unser Unternehmen von 5–10 % in diesem adressierten Markt ausgehen. Insbesondere Anwendungen in der Biomedizin wird ein großes Potenzial innerhalb der Mikrosystemtechnik zugeschrieben (siehe Bild).

Ein Wachstum in diesem Markt wird SÜSS vor allem in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder zugute kommen.

Besondere Geschäftschancen in der Mikrosystemtechnik existieren in zwei Fällen: Zum einen sind wir mit unseren Produkten in der Rückprojektionstechnik vertreten (im Bild als „DMD“ bezeichnet). Diese konkurriert mit den anderen modernen TV-Technologien, LCD und Plasma. Sollte diese Technologie im Vergleich zu den beiden anderen Verfahren einen höheren Marktanteil bei den handelsüblichen Fernsehgeräten erzielen, könnte sich ein merklich gesteigertes Umsatzpotenzial für die Substrat Bonder ergeben.

Darüber hinaus ergeben sich möglicherweise Umsatzpotenziale in der Nanotechnologie. Diese wird derzeit oft in Medien und Fachpresse erwähnt; der von SÜSS adressierbare Markt ist derzeit aber noch relativ klein. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir zukünftig an einer Vergrößerung des Marktes partizipieren werden. Eine qualifizierte Potenzialabschätzung ist heute noch nicht möglich.

Für 2006 erwarten wir keine wesentliche Änderung der Entwicklung des Marktes Mikrosystemtechnik, so dass wir von einem nachhaltigen und stetigen Wachstum unserer Umsätze in diesen Märkten ausgehen. Insbesondere die Substrat Bonder sollten in 2006 höhere Umsätze erzielen als in 2005, was unter anderem auf den höheren Auftragsbestand zu Beginn des laufenden Jahres zurückzuführen ist.



Der Markt Verbindungshalbleiter sowie Markt für Test Systeme:

Bei den Verbindungshalbleitern ist die zukünftige Marktentwicklung für unsere Produkte unverändert schwierig einzuschätzen. Seit 2002 fehlen Impulse im Bereich der Telekommunikation. Aktuell bietet sich vor allem Geschäftspotenzial bei der Optoelektronik, insbesondere im Bereich LED.

Die Produktlinie der Testsysteme bietet Geräte für Anwendungen im analytischen Bereich der Entwicklung, der Fehleranalyse, sowie MEMS und LED-Probing an. Dieses Segment entwickelt sich relativ stabil und auch relativ unabhängig von den Zyklen der Halbleiterindustrie.

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns

Weiterhin soll die Rohertragsmarge langfristig auf 45 – 47 % erhöht werden, wobei auch die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wieder bis zu 10 % des Umsatzes darstellen sollen. Mit gegebenem Umsatzwachstum und relativ geringem Kostenwachstum bei Vertrieb und Verwaltung soll die Gruppe in die Lage versetzt werden, wieder EBIT-Margen (bezogen auf den Umsatz) von 10 % zu erreichen. Gestützt durch eine solche Ergebnisperformance soll das operative Geschäft ausreichend freien Cash Flow generieren, so dass für das organische Wachstum im Grundgeschäft kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf entstehen sollte.

Mit Bezug auf die regionale Aufteilung stellten wir in 2005 eine annähernd gleiche Aufteilung auf Europa, Nordamerika und Asien fest. Dennoch erwarten wir unverändert, dass langfristig

Segment	Markt			
	Advanced Packaging	Mikrosystem-technik	Verbindungs-halbleiter	Test Systeme
Umsatzverteilung am Gruppenumsatz	25 %	40 %	15 %	20 %
Lithografie	zusammen > 10		5 – 10 %	
C4NP				
Substrat Bonder		> 10 %		
Device Bonder		Re-Evaluierung		
Test Systeme				5 %

Für die Gruppe insgesamt zielen wir auf eine durchschnittliche Wachstumsrate von rund 10 % beim Umsatz ab. Wir erwarten neben üblichen Kapazitätserweiterungen durch Installation neuer Fertigungslinien zukünftig ebenfalls vermehrt nachhaltige Umsatzbeiträge aufgrund von Ersatzinvestitionen. So konnten wir bereits im Verlauf des Jahres 2005 Ersatzinvestitionen bei einzelnen Großkunden feststellen, wo vor allem höhere Anforderungen an die Spezifikation sowie erhöhte Durchsatzleistung der neueren Maschinen für den Austausch bestehenden Equipments ausschlaggebend waren.

Asien, bedingt durch den Schwerpunkt Advanced Packaging, überproportional wachsen wird.

Auf Basis des aktuellen Auftragsbestandes sowie der Geschäftsentwicklung und des Investitionsklimas zu Beginn des Jahres 2006, erachten wir ein Umsatzwachstum im Rahmen der Branchenerwartung von bis zu 10 % derzeit als erreichbar. Dennoch kann erst mit Beginn des dritten Quartals 2006 eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr abgegeben werden, so dass wir an dieser Stelle auf die Unverbindlichkeit dieser Aussage explizit hinweisen. Sofern der Umsatz 2006 10 % über dem Umsatz von 2005 liegt, erwarten wir eine EBIT-Marge von ca. 5 %. Der Break Even-Umsatz auf EBIT-Basis liegt derzeit bei etwa 108 bis 110 Mio. EUR und beinhaltet auch die Kostenblöcke, die im Rahmen des Geschäftsaufbaus für C4NP anfallen.

Weitere Maßnahmen zur signifikanten Senkung des Break Even-Punktes sind derzeit nicht geplant. Jedoch bleibt das Segment Device Bonder weiterhin unter sorgfältiger Beobachtung. Derzeit ist nicht gesichert, ob ein ausreichend großer adressierbarer Markt für das entsprechende Produkt Device Bonder existiert. Solange ein solcher Markt nicht definiert ist, kann es unverändert zu strategischen Entscheidungen bezüglich dieses Segmentes kommen.

12. VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Dieser Lagebericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf die zukünftige Entwicklung des SÜSS Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 15. März 2006

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind

Stephan Schulak



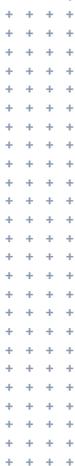
IFRS – KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR	Anhang Nr.	01.01. – 31.12.2005	01.01. – 31.12.2004
Umsatzerlöse	III.1	117.540	111.305
Herstellungskosten	III.2	-70.567	-64.079
Bruttoergebnis vom Umsatz		46.973	47.226
Vertriebskosten		-22.126	-24.578
Forschungs- und Entwicklungskosten		-7.204	-8.099
Verwaltungskosten		-21.312	-23.351
Abschreibungen des Geschäfts- oder Firmenwerts	III.3	-1.839	0
Sonstige betriebliche Erträge	III.4	4.257	2.568
Sonstige betriebliche Aufwendungen	III.5	-2.953	-2.531
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		-22	0
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		5.793	-1.518
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, den Geschäfts- oder Firmenwert und Finanzanlagen		-10.019	-7.247
Operatives Ergebnis (EBIT)		-4.226	-8.765
Zinsaufwendungen	III.6	-2.001	-1.976
Zinserträge	III.6	592	383
Ergebnis vor Steuern		-5.635	-10.358
Ertragsteuern	III.7	-2.593	-6.028
Jahresergebnis		-8.228	-16.386
Davon Minderheitsanteile		5	11
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		-8.233	-16.397
Ergebnis je Aktie	III. 8		
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in EUR		-0,52	-1,08
Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR		-0,52	-1,08

► KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
► KONZERNBILANZ
► KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
► KONZERNEIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG
► ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS
► SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
► ANHANG

IFRS – KONZERNBILANZ

TEUR			31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA	Anhang Nr.			
Langfristige Vermögenswerte			50.401	60.766
Immaterielle Vermögenswerte	IV.1		13.668	13.247
Geschäfts- oder Firmenwert	IV.2		23.560	24.320
Sachanlagen	IV.3		5.384	8.628
At-equity bewertete Beteiligungen	IV.4		0	22
Sonstige Finanzanlagen	IV.5		33	33
Sonstige Vermögenswerte	IV.6		364	671
Latente Steueransprüche	III.7		7.392	13.845
Kurzfristige Vermögenswerte			106.920	107.661
Vorratsvermögen	IV.7		53.837	57.442
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	IV.8		23.681	23.899
Wertpapiere	IV.9		58	74
Steuerforderungen	IV.10		1.120	1.808
Flüssige Mittel	VI.4		26.325	22.534
Sonstige Vermögenswerte	IV.11		1.899	1.904
Bilanzsumme			157.321	168.427
PASSIVA				
Eigenkapital			84.165	83.416
Gezeichnetes Kapital	V.1		16.793	15.157
Rücklagen	V.1		66.640	69.117
Kumuliertes übriges Eigenkapital	V.1		683	-902
Minderheitsanteile			49	44
Langfristige Schulden			13.800	25.359
Pensionsrückstellungen	V.2		2.581	2.565
Sonstige Rückstellungen	V.3		455	445
Finanzverbindlichkeiten	V.4		5.957	12.905
Sonstige Verbindlichkeiten	V.5		245	429
Latente Steuerverbindlichkeiten	III.7		4.562	9.015
Kurzfristige Schulden			59.356	59.652
Sonstige Rückstellungen	V.6		3.968	6.631
Steuerverbindlichkeiten			394	492
Finanzverbindlichkeiten	V.4		12.832	10.669
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			6.061	5.676
Sonstige Verbindlichkeiten	V.7		36.101	36.184
Bilanzsumme			157.321	168.427



IFRS – KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01. – 31.12.2005	01.01. – 31.12.2004
Jahresergebnis	-8.228	-16.386
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	4.227	4.359
Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	1.839	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.931	2.888
Veränderung von At-equity bewerteten Beteiligungen	22	89
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	266	65
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	297	771
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-312	-417
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	458	750
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.178	-514
Zahlungsunwirksame Aufzinsung der Wandel- und Optionsanleihe	546	454
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-1.835	1.361
Veränderung des Vorratsvermögens	6.016	-5.488
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.934	-5.346
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	1.016	3.810
Veränderung der Pensionsrückstellungen	16	-102
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191	-208
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-4.255	10.125
Veränderung der latenten Steuern	2.001	5.485
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.952	1.696

IFRS – KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01. – 31.12.2005	01.01. – 31.12.2004
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-1.704	-1.023
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-4.273	-2.230
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	972	32
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-5.005	-3.221
Aufnahme von Bankdarlehen	1.250	1.250
Tilgung von Bankdarlehen	-2.376	-2.942
Tilgung der Wandelanleihe	-5.634	0
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	1.061	-604
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	170	-106
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung	6.844	0
Einzahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten	199	0
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	-109	0
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.405	-2.402
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	439	-324
Veränderung der flüssigen Mittel	3.791	-4.251
Flüssige Mittel zum Jahresanfang	22.534	26.785
Flüssige Mittel zum Ende der Periode	26.325	22.534
Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	1.257	1.405
Zinseinnahmen während der Periode	592	383
Steuerzahlungen während der Periode	455	842
Steuererstattungen während der Periode	392	2.672



IFRS – KONZERNEIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital
Stand 01.01.2004	14.957	14.957
Wandlung von Wandelschuldverschreibungen in Gezeichnetes Kapital	200	200
Zuführung aus der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen		
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresergebnis		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt		
Fremdwährungsanpassung		
Stand 31.12.2004	15.157	15.157
Stand 01.01.2005	15.157	15.157
Einzahlung aufgrund Kapitalerhöhung	1.456	1.456
Kosten der Kapitalerhöhung nach Steuereffekt		
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Ausgabe von Stückaktien:		
Ausübung von Aktienoptionen	180	180
Jahresergebnis		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt		
Fremdwährungsanpassung		
Stand 31.12.2005	16.793	16.793

KONZERNGEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
KONZERNBILANZ
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG
ENTWICKLUNG DES
KONZERNANLAGEVERMÖGENS
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
ANHANG

Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Bilanzgewinn/ -verlust	Kumuliertes übriges Eigenkapital	Minderheitsanteile	Total
82.446	433	164	0	33	98.033
					200
1.721					1.721
750					750
		-16.397		11	-16.386
			-22		-22
			-880		-880
84.917	433	-16.233	-902	44	83.416
84.917	433	-16.233	-902	44	83.416
5.388					6.844
-109					-109
458					458
19					199
		-8.233		5	-8.228
			-10		-10
			1.595		1.595
90.673	433	-24.466	683	49	84.165

ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS (ANLAGESPIEGEL 2005)

TEUR	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					31.12.2005
	01.01.2005	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	
I. Immaterielle Vermögenswerte						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.777	-274	175	0	0	16.678
2. Entwicklungskosten	10.904	548	4.098	0	0	15.550
3. Aktivierte Leasinggegenstände Software	184	2	0	0	13	173
	27.865	276	4.273	0	13	32.401
II. Geschäfts- oder Firmenwert	36.892	1.079	0	0	0	37.971
III. Sachanlagen						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.400	183	136	440	2.057	6.102
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.139	1.073	250	0	26	10.436
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.572	350	547	-440	380	10.649
4. Fahrzeuge	541	30	47	0	52	566
5. Anlagen im Bau	0	0	71	0	0	71
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	632	5	90	0	600	127
Technische Anlagen und Maschinen	874	-1	528	0	26	1.375
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.226	-97	35	0	3	1.161
	30.384	1.543	1.704	0	3.144	30.487
IV. Finanzanlagen						
1. At-equity bewertete Beteiligungen	2.095	0	0	0	0	2.095
2. Sonstige Finanzanlagen	201	0	0	0	0	201
	2.296	0	0	0	0	2.296

KONZERNGEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
KONZERNBILANZ
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG
► ENTWICKLUNG DES
KONZERNANLAGEVERMÖGENS
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
ANHANG

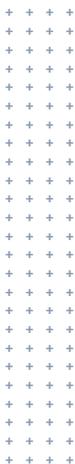
	Kumulierte Abschreibungen					Restbuchwert		
	01.01.2005	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2005
	11.120	-354	1.851	0	0	12.617	5.657	4.061
	3.376	254	2.347	0	0	5.977	7.528	9.573
	122	1	29	0	13	139	62	34
	14.618	-99	4.227	0	13	18.733	13.247	13.668
	12.572	0	1.839	0	0	14.411	24.320	23.560
	3.795	163	1.622	125	834	4.871	3.605	1.231
	6.823	930	1.105	0	26	8.832	2.316	1.604
	8.485	232	710	-125	367	8.935	2.087	1.714
	499	21	24	0	50	494	42	72
	0	0	0	0	0	0	0	71
	316	1	304	0	600	21	316	106
	713	-1	136	0	26	822	161	553
	1.125	-24	30	0	3	1.128	101	33
	21.756	1.322	3.931	0	1.906	25.103	8.628	5.384
	2.073	0	22	0	0	2.095	22	0
	168	0	0	0	0	168	33	33
	2.241	0	22	0	0	2.263	55	33

ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS (ANLAGESPIEGEL 2004)

TEUR	01.01.2004	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				31.12.2004
		Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	
I. Immaterielle Vermögenswerte						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.806	-209	189	0	9	16.777
2. Entwicklungskosten	9.087	-191	2.008	0	0	10.904
3. Aktivierte Leasinggegenstände Software	157	-6	33	0	0	184
	26.050	-406	2.230	0	9	27.865
II. Geschäfts- oder Firmenwert	37.467	-575	0	0	0	36.892
III. Sachanlagen						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.544	-126	52	0	70	7.400
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.537	-549	216	0	65	9.139
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.443	-102	652	0	421	10.572
4. Fahrzeuge	577	-6	43	0	73	541
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	600	0	32	0	0	632
Technische Anlagen und Maschinen	880	-6	0	0	0	874
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.307	-59	28	0	50	1.226
	30.888	-848	1.023	0	679	30.384
IV. Finanzanlagen						
1. At-equity bewertete Beteiligungen	2.183	1	0	0	89	2.095
2. Sonstige Finanzanlagen	202	-1	0	0	0	201
	2.385	0	0	0	89	2.296

KONZERNGEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
KONZERNBILANZ
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
KONZERNEIGENKAPITAL-
VERÄNDERUNGSRECHNUNG
► ENTWICKLUNG DES
KONZERNANLAGEVERMÖGENS
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
ANHANG

	Kumulierte Abschreibungen					Restbuchwert		
	01.01.2004	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004
	8.657	-224	2.696	0	9	11.120	8.149	5.657
	1.765	-29	1.640	0	0	3.376	7.322	7.528
	103	-4	23	0	0	122	54	62
	10.525	-257	4.359	0	9	14.618	15.525	13.247
	12.572	0	0	0	0	12.572	24.895	24.320
	3.391	-84	515	0	27	3.795	4.153	3.605
	5.963	-334	1.252	0	58	6.823	3.574	2.316
	8.128	-83	814	0	374	8.485	2.315	2.087
	538	-6	40	0	73	499	39	42
	0	0	0	0	0	0	0	0
	246	0	70	0	0	316	354	316
	648	-3	68	0	0	713	232	161
	1.086	-40	129	0	50	1.125	221	101
	20.000	-550	2.888	0	582	21.756	10.888	8.628
	2.073	0	0	0	0	2.073	110	22
	168	0	0	0	0	168	34	33
	2.241	0	0	0	0	2.241	144	55



SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

SEGMENTINFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSFELDERN

TEUR	Lithografie		Substrat Bonder	
	2005	2004	2005	2004
Umsatzerlöse	66.554	61.756	6.074	7.665
Segmentergebnis	4.626	1.596	-4.016	-3.543
Ergebnis aus der At-equity Bewertung	-22	0	0	0
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	290	23	67	-131
Segmentvermögen	66.281	72.803	14.638	13.092
- davon Geschäfts- oder Firmenwert	13.599	13.599	0	0
Segmentsschulden	-28.737	-32.664	-4.393	-2.796
Abschreibungen	3.771	3.483	1.010	363
- davon planmäßig	3.290	3.483	1.010	363
- davon außerplanmäßig	481	0	0	0
Investitionen	1.227	1.252	446	863
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	275	297	75	81

SEGMENTINFORMATIONEN NACH REGIONEN

TEUR	Umsatzerlöse		Investitionen	
	2005	2004	2005	2004
Europa	41.588	32.500	4.550	2.075
Nordamerika	42.170	31.800	703	889
Japan	7.669	15.600	18	36
Sonstiges Asien	26.112	30.900	30	223
Rest	0	505	676	31
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0
Gesamt	117.540	111.305	5.977	3.254

KONZERNGEWINN- UND

VERLUSTRECHNUNG

KONZERNBILANZ

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

KONZERNEIGENKAPITAL-

VERÄNDERUNGSRECHNUNG

ENTWICKLUNG DES

KONZERNANLAGEVERMÖGENS

► SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

ANHANG

Device Bonder

Test Systeme

Sonstige

Summe

2005		2004		2005		2004		2005		2004	
6.129	6.032	28.752	26.968	10.030	8.883	117.540	111.305				
-3.932	-723	2.074	1.518	-4.457	-7.244	-5.706	-8.397				
0	0	0	0	0	0	-22	0				
134	387	-44	-300	289	-569	736	-590				
5.515	11.868	20.265	20.061	13.431	9.713	120.130	127.537				
0	1.839	4.597	4.234	5.364	4.648	23.560	24.320				
-1.048	-3.163	-6.836	-5.023	-2.476	-2.981	-43.490	-46.627				
3.081	265	440	501	1.717	2.635	10.019	7.247				
186	265	440	501	1.717	2.224	6.643	6.836				
2.895	0	0	0	0	411	3.376	411				
29	28	184	408	4.091	703	5.977	3.254				
45	67	128	128	161	160	684	733				

Vermögen

2005	2004
73.719	84.629
43.485	37.671
4.185	8.710
718	402
3.759	2.703
-5.736	-6.578
120.130	127.537



ANHANG ZUM IFRS – KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2005

I. BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleissheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka und Vaihingen in Deutschland, Waterbury und Palo Alto in den USA, und Saint Jeoire in Frankreich. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbständige Vertriebsgesellschaften in Großbritannien, Japan, Thailand, Taiwan und China. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

II. ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

II.1 Grundlage der Darstellung

Der vorliegende Konzernabschluss wurde erstmals nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden, unter Anwendung von IFRS 1, vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuch muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS Micro Tec AG um ein börsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 Abs. 1 ff. HGB erstellt.

II.2 Nicht vorzeitige angewandte Standards / Interpretationen

Das IASB hat nachfolgende Standards, Interpretationen und Änderungen zu bestehenden Standards herausgegeben, deren Anwendung noch nicht verpflichtend ist und die vom SÜSS-Konzern auch nicht vorzeitig angewandt wurden:

IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“

Das IASB hat im August 2005 IFRS 7 veröffentlicht. In diesem Standard wurden die Angaben zu Finanzinstrumenten zusammengefasst, die bislang in IAS 30 „Angaben im Abschluss von Banken und ähnlichen Finanzinstitutionen“ und IAS 32 „Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung“ geregelt waren. Dabei wurden einzelne Angabepflichten geändert bzw. ergänzt.

IFRS 7 ist verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Der Standard, der von allen Unternehmen anzuwenden ist, wird bei der erstmaligen Anwendung durch den SÜSS-Konzern im Geschäftsjahr 2007 voraussichtlich zu erweiterten Angaben zu Finanzinstrumenten führen.

IFRIC 4 „Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält“

Im Dezember 2004 hat das IASB die Interpretation IFRIC 4 veröffentlicht. Gegenstand dieser Interpretation sind die Fragstellungen, wie festgestellt werden kann, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis ist oder beinhaltet bzw. wann eine Neueinschätzung darüber erforderlich ist. Zudem wird dargelegt, wie Leasingzahlungen von Zahlungen für andere Leistungen getrennt werden können, die in derselben Vereinbarung geregelt sind.

Die Interpretation ist verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen. Die Übergangsvorschrift eröffnet das Wahlrecht, die Interpretation rückwirkend anzuwenden oder sie auf diejenigen Vereinbarungen anzuwenden, die zu Beginn der frühesten Periode bestehen, für die Vergleichsinformationen im Abschluss dargestellt werden.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2006 keine Auswirkungen.

IFRIC 6 „Verbindlichkeiten, die sich aus einer Teilnahme an einem spezifischen Markt ergeben – Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Die Interpretation IFRIC 6 wurde vom IASB im September 2005 veröffentlicht. IFRIC 6 befasst sich mit dem Erfassungszeitpunkt von Schulden für die Entsorgung von bestimmten privat genutzten Elektrogeräten, die unter die Bestimmungen der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bzw. deren Umsetzung in nationales Recht, in Deutschland etwa dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz, fallen.

IFRIC 6 ist verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Dezember 2005 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Interpretation im Geschäftsjahr 2006 hat voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG.

IFRIC 7 „Anwendung des Restatement-Ansatzes nach IAS 29 Rechnungslegung in Hochinflationenländern“

Das IASB hat im November 2005 die Interpretation IFRIC 7 herausgegeben. Diese Interpretation enthält Richtlinien zur Anwendung von IAS 29 „Rechnungslegung in Hochinflationenländern“, wenn die funktionale Währung eines Unternehmens erstmalig als hyperinflationär eingestuft wird.

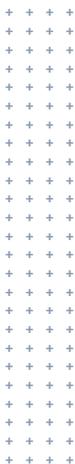
IFRIC 7 ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. März 2006 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Die Interpretation hat keine Auswirkungen auf die künftigen Konzernabschlüsse der SÜSS MicroTec AG, da bei keinem der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen die funktionale Währung die Währung eines Hochinflationenlandes ist und das auch nicht zu erwarten ist.

IFRIC 8 „Anwendungsbereich von IFRS 2“

Das IASB hat im Januar 2006 die Interpretation IFRIC 8 veröffentlicht, die zum Anwendungsbereich von IFRS 2 Stellung nimmt. IFRS 2 „Aktienbasierte Vergütung“ ist anzuwenden auf Geschäftsvorfälle, in deren Rahmen eine Gesellschaft Güter oder Dienstleistungen als Gegenleistung für eine aktienbasierte Vergütung erhält. Nach IFRIC 8 ist IFRS 2 auch dann anzuwenden, wenn die Gesellschaft die erhaltenen Güter oder Dienstleistungen nicht klar identifizieren kann.

IFRIC 8 ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Mai 2006 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.



Die Interpretation hat keine Auswirkungen auf die künftigen Konzernabschlüsse der SÜSS MicroTec AG, da kein in den Konzernabschluss einbezogenes Unternehmen derartige, in der Interpretation genannte Geschäftsvorfälle getätigt hat und in der vorhersehbaren Zukunft auch nicht tätigen wird.

Änderung des IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – Angaben zum Kapital

Das IASB hat im August 2005 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ eine Änderung des IAS 1 bekannt gemacht. Danach sind im Abschluss Informationen zu veröffentlichen, die den Abschlussadressaten eine Bewertung der Ziele, Methoden und Prozesse beim Kapitalmanagement ermöglichen.

Die Änderung des IAS 1 ist anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Änderung des IAS 1 durch den SÜSS-Konzern im Geschäftsjahr 2007 wird zu erweiterten Anhangangaben führen.

Änderung des IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“ – Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste, gemeinschaftliche Pläne und Anhangangaben

Das IASB hat im Dezember 2004 eine Änderung des IAS 19 veröffentlicht. Die Änderung betrifft die folgenden Aspekte:

- Erweiterung der Erfassungsalternativen für versicherungsmathematische Gewinne und Verluste um eine optionale erfolgsneutrale Erfassung der in der Berichtsperiode entstandenen Beträge im Eigenkapital,
- Pflicht zur erfolgswirksamen Erfassung von Forderungen oder Verbindlichkeiten entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen bei gemeinschaftlichen Plänen, die infolge nicht hinreichender Informationen wie beitragsorientierte Pläne bilanziert werden,
- Darstellung von leistungsorientierten Plänen im Risikoverbund mehrerer Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung und
- Änderung von Anhangangaben zu leistungsorientierten Pensionsplänen.

Die Änderungen des IAS 19 sind – soweit nicht optional – verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Änderung des IAS 19 durch die SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2006 wird voraussichtlich nur zu geänderten Anhangangaben zu den leistungsorientierten Pensionsplänen im Konzern führen. Derzeit ist nicht vorgesehen, von der Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste nach der Korridormethode auf die erfolgsneutrale Erfassung im Eigenkapital überzugehen. Gemeinschaftliche Pensionspläne existieren im Konzern nicht.

Änderung des IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ – Bilanzierung von Cashflow-Sicherungsbeziehungen bei künftigen konzerninternen Transaktionen

Das IASB hat im April 2005 eine Änderung des IAS 39 in Bezug auf die Bilanzierung von Cashflow-Sicherungsbeziehungen bei künftigen konzerninternen Transaktionen veröffentlicht. Die Änderung des IAS 39 ermöglicht es Unternehmen, das Währungsrisiko aus einer mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden künftigen konzerninternen Transaktion im Konzernabschluss als gesichertes Grundgeschäft im Rahmen einer Cashflow-Sicherungsbeziehung zu bestimmen, sofern die Transaktion auf eine andere Währung lautet als die funktionale Währung des Unternehmens, das die Transaktion abwickelt und das Währungsrisiko sich auf das Konzernergebnis auswirkt.

Die Änderung des IAS 39 ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Änderung des IAS 39 im Geschäftsjahr 2006 wird im Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG zu keinen Änderungen führen, da Währungsrisiken aus mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden künftigen konzerninternen Transaktionen nicht durch Cash-Flow-Hedges abgesichert werden.

II.3 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach IFRS

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des True and fair views sowie der Fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

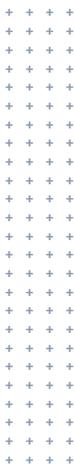
Immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswertes ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellkosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Fremdkapitalkosten werden nicht aktiviert. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS-Gruppe mit Ausnahme des Geschäfts- oder Firmenwerts nicht vor.

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig, sondern nur noch im Rahmen eines Werthaltigkeitstests nach IAS 36 außerplanmäßig abgeschrieben.



Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauer für die wesentlichen Anlagekategorien ist nachstehend wiedergegeben:

Grundstücke, Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Reparatur- und Wartungsaufwendungen werden sofort erfolgswirksam erfasst. Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingsschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingsschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Die Ermittlung der Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung erfolgt auf der Grundlage der Konzernplanung sowie geeigneter Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie, auf deren Basis eine Trendermittlung der Netto-Cashflows für die nachfolgenden Perioden vorgenommen wird. Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 9,0 % durchgeführt.

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der außerplanmäßigen Abschreibung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf außerplanmäßig abgeschriebene Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

At-equity bewertete Beteiligungen

Der Konzern bewertet seine At-equity bewerteten Beteiligungen gemäß IAS 28 („Investments in Associates“). Es werden derzeit keine At-equity bewerteten Beteiligungen mit Veräußerungsabsicht gehalten.

Sonstige Finanzanlagen

Sonstige Finanzanlagen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeübt werden kann bzw. die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen angesetzt.

Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen wird zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum jeweils niedrigeren Betrag von Anschaffungskosten und Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden bei den Nettoveräußerungswerten Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswertes.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögenswerte

Forderungen und sonstige Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Die Kunden des Unternehmens sind konzentriert in der Halbleiterindustrie, sie sind jedoch geographisch gestreut. Keiner der einzelnen Kunden hat einen wesentlichen Anteil an den Gesamterlösen des Unternehmens. Ebenso bestehen keine wesentlichen Forderungen gegenüber einzelnen Kunden.

Wertpapiere

Wertpapiere werden mit Marktpreisen bewertet. Unrealisierte Gewinne und Verluste von Wertpapieren, die als zum „Verkauf bestimmt“ klassifiziert werden („available for sale“), werden unter Berücksichtigung von Steuern im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.



Aktionsoptionspläne

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen werden gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (Planvermögen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie außerhalb einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsumfanges liegen. In diesem Fall werden sie über die künftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der Zinsaufwendungen ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und wenn die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrages zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag unter Einbeziehung von Transaktionskosten sowie Agien und Disagien angesetzt. Langfristige Verbindlichkeiten werden mit dem Barwert angesetzt. Sofern vorgeschrieben, werden Verbindlichkeiten (z. B. derivative Finanzinstrumente) zu Zeitwerten bewertet.

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahrenübergang an den Kunden erfasst, wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann.

Ist in Verträgen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsatzerlöse erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

Herstellungskosten

Die Herstellungskosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklung werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungsrisiken werden in der SÜSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden grundsätzlich erfolgswirksam erfasst. Die Gesellschaft wendet Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschäfte handelt.

Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Assistance“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden aktivisch abgegrenzt.



Transaktionen in Fremdwahrung

Einkaufe und Verkaufe in Fremdwahrungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermogenswerte und Schulden in Fremdwahrung werden mit dem geltenden Wahrungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Wahrung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwahrungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

Verwendung von Schatzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschatzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermogenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Ertragen und Aufwendungen haben. Die tatsachlichen Werte konnen in Einzelfallen von den getroffenen Annahmen und Schatzungen abweichen.

Die Annahmen und Schatzungen beziehen sich im Wesentlichen auf die konzerneinheitliche Festlegung von Nutzungsdauern, die Bilanzierung und Bewertung von Ruckstellungen, die Parameter fur die Bewertung der Pensionsruckstellungen und Aktienoptionen im Zeitpunkt der Gewahrung sowie die Realisierbarkeit zukunftiger Steuerentlastungen. Daruber hinaus sind Schatzungen und Annahmen bei der Uberprufung des Geschaft- oder Firmenwerts („Impairment Test“) notwendig.

II.4 Konsolidierung

Konsolidierungsgrundsatze

In den Konzernabschluss werden die Abschlusse der SUSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhangig von der Beteiligungshohe die Beherrschungsmoglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsatzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Beteiligungsgesellschaften (in der Regel Anteilsbesitz zwischen 20 und 50 %), bei denen das Unternehmen einen wesentlichen Einfluss auf die Geschaft- und Finanzpolitik ausuben kann, werden nach der At-equity Methode bewertet.

Die Kapitalkonsolidierung erfolgte unter Anwendung der Vereinfachungsvorschriften des IFRS 1.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Ertrage und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschlussen in fremder Wahrung

Die funktionale Wahrung des Konzerns ist der EURO. Alle Angaben erfolgen in tausend EURO, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Wahrung die jeweilige lokale Wahrung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2005		2004	
	Bilanz	G&V	Bilanz	G&V
1 EUR vs 1 USD	1,18	1,25	1,36	1,25
1 EUR vs 100 JPY	139,13	137,14	139,83	133,92
1 EUR vs 1 GBP	0,69	0,69	0,71	0,68
1 EUR vs 1 CHF	1,56	1,55	1,54	1,55
1 EUR vs 100 TWD	39,12	40,25	43,63	41,67
1 EUR vs 100 CNY	9,38	10,05	11,12	10,21
1 EUR vs 100 THB	48,62	50,18	53,08	50,17

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (Kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

II.5 Angaben zum Konsolidierungskreis

Im Geschäftsjahr 2005 gab es keinerlei Änderungen des Konsolidierungskreises. Unverändert werden in den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2005 folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung; (*) = untestiert):

Gesellschaft	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTec AG, Garching	16.792.968,00 EUR	Holding	99.171.176,76 EUR	-544.704,44 EUR	
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching	2.000.100,00 EUR	100 %	5.405.508,70 EUR	-8.737.928,11 EUR	voll
SUSS MicroTec Test SysteMS GmbH, Sacka (**)	511.291,88 EUR	100 %	7.917.093,85 EUR	212.981,41 EUR	voll
SUSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH, Singen (*)	26.000,00 EUR	100 %	207.215,87 EUR	-1.243,38 EUR	voll
SUSS MicroTec Ltd., Wokingham Berkshire (*)	£10.000,00	100 %	£1.405.681,00	-£23.265,00	voll
SUSS MicroTec KK, Yokohama	30.000,00 TJPY	100 %	359.259,00 TJPY	-135.543,00 TJPY	voll
SUSS MicroTec S.A.S., St. Jeoire	1.275.000,00 EUR	100 %	1.785.449,00 EUR	-70.076,00 EUR	voll
SUSS MicroOptics S.A., Neuchatel (*)	500.000,00 CHF	85 %	499.299,40 CHF	91.668,21 CHF	voll
SUSS MicroTec Inc., Waterbury	\$105.000,00	100 %	\$8.970.400,57	-\$355.260,37	voll
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (*)	5.000.000,00 TWD	100 %	13.717.656,00 TWD	-13.320.024,00 TWD	voll
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai (*)	1.655.320,00 CNY	100 %	3.832.720,68 CNY	1.100.914,08 CNY	voll
Image Technology Inc., Palo Alto (*)	\$24.287,00	100 %	\$1.541.417,92	\$1.301.241,70	voll
MFI Technologies Group (*)	\$2.737.476,00	100 %	-\$4.091.028,60	-\$242.273,52	voll
HUGLE Lithography Inc., Sunnyvale (*)	\$1.190.442,00	53,1 %	-\$39.579,00	-\$64.392,00	at equity
Suss MicroTec Company Ltd, Bangkok (*)	4.000,00 TTHB	49 %	13.147,85 TTHB	818,80 TTHB	voll
Karl SüSS Geschäftsführungs-GmbH, Garching (*)	25.564,59 EUR	100 %	39.416,75 EUR	-1.496,68 EUR	at cost
Zentrum für Technologiestrukturentwicklung, Glaubitz (*)	51.129,19 EUR	10 %	n/a	n/a	at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand (*)	n/a	10 %	n/a	n/a	keine

(**) Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der SÜSS MicroTec AG

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.



Die Beteiligung an der HUGLE Lithography Inc. wird aus Wesentlichkeitsgründen trotz der Beteiligung von 53,1% am Kapital der Gesellschaft nur nach der At-equity Methode in den Konzernabschluss einbezogen. Die HUGLE Lithography Inc. ist eine Gesellschaft ohne aktiven Geschäftsbetrieb, die über keine Vermögenswerte verfügt.

Die Süss MicroTec Company Ltd., Bangkok, wurde erstmals im Geschäftsjahr 2004 voll in den Konzernabschluss einbezogen. Erstkonsolidierungszeitpunkt war der 31. Dezember 2004. Die SÜSS MicroTec AG hält unmittelbar 49% an dieser Gesellschaft. Die Süss MicroTec Company Ltd., Bangkok, ist als weitere Vertriebsgesellschaft für die SÜSS-Gruppe in Asien tätig und wird von der SÜSS MicroTec AG kontrolliert.

II.6 Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat weder im Geschäftsjahr 2005 noch im Vorjahr Akquisitionen vorgenommen.

II.7 Grundlagen der Erstanwendung

Der Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2005 wurde gemäß IFRS 1 („First Time Adoption of International Accounting Standards“) hinsichtlich der Erstanwendung der IFRS aufgestellt. Die zum 31. Dezember 2005 verpflichtend geltenden IFRS wurden für diesen Konzernabschluss retrospektiv angewendet. Der Zeitpunkt des Übergangs auf die Rechnungslegung nach IFRS ist der 1. Januar 2004. Der letzte Abschluss nach US-GAAP wurde für die Berichtsperiode zum 31. Dezember 2004 erstellt.

Von den gemäß IFRS 1 bestehenden Erleichterungswahlrechten bei der retrospektiven Anwendung der zum 31. Dezember 2005 geltenden IFRS für die Eröffnungsbilanz nach IFRS zum 1. Januar 2004 wurden durch den Konzern die Folgenden in Anspruch genommen:

- Sämtliche Unternehmenserwerbe, die vor dem 1. Januar 2004 durchgeführt worden sind, wurden hinsichtlich ihrer bilanziellen Darstellung mit den im US-GAAP-Konzernabschluss angewendeten Methoden übernommen. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den übernommenen Geschäfts- oder Firmenwert gemäß IAS 36 waren in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2004 nicht notwendig.
- Die Bewertung von Pensionsrückstellungen erfolgt in der IFRS-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2004 mit dem Barwert der entsprechenden Verpflichtungen abzüglich des Zeitwertes des zur Deckung der Pensionszusagen bestehenden Planvermögens.
- Der im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesene Ausgleichsposten aus der Umrechnung von Fremdwährungsabschlüssen wurde in der IFRS-Eröffnungsbilanz auf null gesetzt.

Alle aus der Umstellung resultierenden Differenzen hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung der Vermögenswerte und Schulden gegenüber US-GAAP sind erfolgsneutral im Konzerneigenkapital verrechnet worden.

II.8 Überleitungsrechnung des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses von US-GAAP auf IFRS

Aus der erstmaligen Anwendung der IFRS resultieren die folgenden Auswirkungen auf das Eigenkapital des SÜSS-Konzerns zum 1. Januar 2004 bzw. 31. Dezember 2004:

TEUR	Erläuterung	01.01.2004	31.12.2004
Eigenkapital nach US-GAAP		102.409	88.552
Auswirkung der Umstellung auf IFRS			
Aktivierung von Entwicklungsleistungen	(i)	7.322	7.529
Anpassung der Umsatzrealisierung	(ii)		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-4.622	-3.194
Sonstige kurzfristige Forderungen		294	210
Vorratsvermögen		12.405	16.198
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten		-18.387	-23.873
Anpassung der Wandel- und Optionsanleihe	(iii)	1.134	656
Bewertung der Pensionsrückstellungen nach IAS 19	(iv)	-124	-111
Unterschiedliche Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwerts	(v)	-3.175	-3.745
Ansatz latenter Steuern	(vi)	744	1.126
Sonstige Posten		33	68
Summe der Auswirkungen		-4.376	-5.136
Eigenkapital nach IFRS		98.033	83.416

Die sich aus der Umstellung von US-GAAP auf IFRS ergebenden Effekte auf das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2004 sind wie folgt:

TEUR		2004
Jahresergebnis nach US-GAAP		-16.690
Auswirkung der Umstellung auf IFRS		
Aktivierung von Entwicklungsleistungen	(i)	409
Anpassung der Umsatzrealisierung	(ii)	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.428
Sonstige kurzfristige Forderungen		-84
Vorratsvermögen		3.988
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten		-5.774
Anpassung der Wandel- und Optionsanleihe	(iii)	-453
Bewertung der Pensionsrückstellungen nach IAS 19	(iv)	61
Unterschiedliche Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwerts	(v)	0
Ansatz latenter Steuern	(vi)	694
Sonstige Posten		35
Summe der Auswirkungen		304
Jahresergebnis nach IFRS		-16.386



Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach US-GAAP und IFRS betreffen insbesondere die folgenden Sachverhalte:

- i. Nach IAS 38 werden Entwicklungskosten ab dem Zeitpunkt, zu dem die technologische und wirtschaftliche Realisierbarkeit gegeben ist, aktiviert und nachfolgend planmäßig abgeschrieben. Nach US-GAAP wurden Entwicklungskosten zum Zeitpunkt ihres Entstehens ergebniswirksam erfasst.
- ii. Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahrenübergang an den Kunden erfasst, wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann. Ist in Verträgen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsatzerlöse erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind. Nach US-GAAP wendete der Konzern für Kaufverträge, die neben der Maschinenlieferung weitere Komponenten wie die Installation und Abnahme der Maschine enthielten, EITF 00-21 „Revenue Arrangements with multiple Deliverables“ an. Danach wurden die auf die einzelnen Elemente entfallenden Umsatzanteile entsprechend ihrem relativen Verhältnis der Marktwerte bestimmt und individuell nach den allgemeinen Vorschriften der „Revenue Recognition“ nach US-GAAP realisiert.
- iii. Die begebene Wandel- und Optionsanleihe ist als „Compound Financial Instrument“ gemäß IAS 32 in eine Verbindlichkeit und einen Eigenkapitalanteil aufzuteilen. Nach IAS 32 sind die Komponente, die eine finanzielle Verbindlichkeit darstellt und die andere, die dem Investor eine Option einräumt, die Verbindlichkeit gegen Eigenkapital des Unternehmens zu tauschen, getrennt auszuweisen. Der separate Ausweis und die Folgebewertung von Verbindlichkeit und Eigenkapitalkomponente hat unabhängig von der Optionsausübungswahrscheinlichkeit zu erfolgen. Die finanzielle Verbindlichkeit ist zum Fair Value anzusetzen. Der Fair Value ergibt sich aus der Abzinsung der zukünftigen Cashflows mit dem für vergleichbare Kreditrisiken marktüblichen Zinssatz. Der Wert der Eigenkapitalkomponente ergibt sich als Residualgröße. Nach US-GAAP wurde der bei der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung vereinnahmte Betrag gemäß APB 14.12 in voller Höhe als Verbindlichkeit passiviert. Eine Aufteilung des Betrages in einen Fremdkapitalteil einerseits und einen Eigenkapitalteil andererseits wurde nicht vorgenommen.
- iv. Die bei der erstmaligen Bewertung der Pensionsrückstellungen nach IAS 19 entstandenen kumulierten versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste wurden zum Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS vollständig erfasst. Unter Berücksichtigung der sich zwischen der Bewertung nach FAS 87 und IAS 19 ergebenden weiteren Unterschiede, verringerte sich die Pensionsrückstellung vor Verrechnung mit verrechenbaren Plan Assets um TEUR 107.
- v. IAS 21 sieht vor, dass ein Geschäfts- oder Firmenwert, der aus dem Erwerb eines ausländischen Geschäftsbetriebs und Anpassungen des Buchwerts der Vermögenswerte und Schulden an den beizulegenden Zeitwert entsteht, wie ein Vermögenswert des ausländischen Geschäftsbetriebs zu behandeln und damit zum Stichtagskurs umzurechnen ist. Die sich aus der Stichtagsbewertung resultierenden Fremdwährungsdifferenzen werden im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst.
- vi. Latente Steueransprüche und Steuerverbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint. Auf temporäre Unterschiede bei Geschäfts- oder Firmenwerten werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

III.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Maschinen	90.487	87.348
Ersatzteile	9.834	8.893
Serviceleistungen	6.381	5.756
Sonstige	10.838	9.308
Umsatzerlöse	117.540	111.305

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten vor allem Erlöse aus dem Maskengeschäft sowie aus dem Bereich Mikrooptik.

III.2 Herstellungskosten

In den Herstellungskosten sind insgesamt Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von TEUR 2.347 (2004: TEUR 1.640) enthalten.

Zudem enthält diese Position eine einmalige Wertminderung von TEUR 767 auf Teile des Device Bonder-Lagers sowie Zuschreibungen infolge geminderter Bestandsrisiken durch den niedrigeren Vorratsbestand im Vergleich zum Vorjahr.

III.3 Abschreibungen des Geschäfts- oder Firmenwerts

Die Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts wurde auf Basis des jährlich durchgeführten Werthaltigkeitstests vorgenommen. Aufgrund des unverändert schwierigen Geschäftsumfelds und der anhaltend schwachen Entwicklung bei Umsatz und Auftragseingang wurde der dem Segment Device Bonder zugeordnete Geschäfts- oder Firmenwert in voller Höhe außerplanmäßig abgeschrieben. Die Höhe der vorgenommenen Abschreibung beträgt TEUR 1.839.

Für die Bestimmung des erzielbaren Betrages bei der Bemessung der außerplanmäßigen Abschreibung wurde der zu erwartende Veräußerungserlös für das Segment Device Bonder verwendet. Der zu erwartende Veräußerungserlös wurde unter Berücksichtigung anfallender Veräußerungskosten mit Hilfe diskontierter Netto-Cashflows ermittelt.



III.4 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Fremdwährungsgewinne	1.558	466
Rückstellungsaufösungen	1.178	514
Sonstige Zuschüsse	738	520
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	342	148
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	60	0
Mieterträge	54	39
Versicherungsleistungen	18	329
Mitgliedsbeiträge	0	61
Sonstiges	309	491
Sonstige betriebliche Erträge	4.257	2.568

Bei den Fremdwährungsgewinnen handelt es sich hauptsächlich um unrealisierte Währungsgewinne aus der Bewertung ausgeglichter Fremdwährungsdarlehen.

Die Erträge aus Rückstellungsaufösungen des Geschäftsjahres 2005 resultieren hauptsächlich aus der teilweisen Auflösung der im Vorjahr gebildeten Rückstellung für die Abfindungszahlung an Herrn Dr. Richter, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft.

Die sonstigen Zuschüsse betreffen insbesondere erhaltene Zuschüsse aus einem Förderprojekt der europäischen Union, welche ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.

III.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.515	0
Fremdwährungsverluste	590	1.683
Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	266	89
Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	238	93
Vertragsstrafen, Schadensersatz	31	85
Sonstiges	313	581
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.953	2.531

Als Ergebnis des jährlichen Werthaltigkeitstests wurde für das Segment Device Bonder über die Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts hinaus weiterer Abwertungsbedarf ermittelt. Zur Deckung des Segmentbuchwertes „Device Bonder“ durch den ermittelten Veräußerungswert für dieses Segment war eine außerplanmäßige Abschreibung auf den zugeordneten Grundstücks- und Gebäudeteil in Höhe von TEUR 1.056 notwendig.

Eine weitere außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von TEUR 459 auf den niedrigeren erzielbaren Betrag wurde auf das Gebäude einschließlich Einbauten in Aßlar vorgenommen, welches nach der Schließung des Standortes im Geschäftsjahr veräußert wurde.

III.6 Zinsaufwendungen und -erträge

Die Zinsaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

TEUR	2005	2004
Bankverbindlichkeiten	828	819
Wandel- und Optionsanleihe	1.067	1.045
Pensionsrückstellungen	106	112
Zinsaufwendungen	2.001	1.976

Bei den Zinsaufwendungen aus der Wandel- und Optionsanleihe handelt es sich in Höhe von TEUR 521 (2004: TEUR 591) um Zinszahlungen an die Anleihegläubiger und in Höhe von TEUR 546 (2004: TEUR 454) um den Aufstockungsbetrag zur Erreichung des Rückzahlungsbetrages bei Laufzeitende.

Die Zinserträge resultieren überwiegend aus Geldmarktanlagen.

III.7 Ertragsteuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellt sich wie folgt dar:

TEUR	2005	2004
Deutsche Körperschaftsteuer	1.768	2.327
Deutsche Gewerbeertragsteuer	1.365	1.984
Ausländische Ertragsteuer	39	1.989
Zwischensumme	3.172	6.300
Inanspruchnahme/Bildung latenter Steuern auf Verlustvorträge	-579	-272
Gesamtaufwand	2.593	6.028
... davon laufend	538	725
Inland	320	138
Ausland	218	587
... davon latent	2.055	5.303
Inland	2.496	4.173
Ausland	-441	1.130



Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

TEUR	2005	2004
Angenommener Steuersatz		
Körperschaftsteuer	25,00 %	25,00 %
Solidaritätszuschlag	5,50 %	5,50 %
Gewerbsteuersatz	14,90 %	14,90 %
Kombinierter Steuersatz	37,34 %	37,34 %
Ergebnis vor Steuern	-5.635	-10.358
Erwartete Ertragssteuern	-2.104	-3.868
Abweichende Steuersätze im Ausland	-37	8
Gewerbsteuerliche Anrechnung von Dauerschuldzinsen	69	171
Abwertung von konzerninternen Darlehenspositionen	0	19
Außerplanmäßige Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts	613	0
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	55	96
Steueraufwand Vorjahre	421	575
Wertberichtigung auf latente Steueransprüche	3.915	8.850
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	-253	0
Sonstiges	-86	177
Effektive Ertragssteuern	2.593	6.028

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf latente Steueransprüche in Höhe von TEUR 3.915 vorgenommen. Die Wertberichtigungen betreffen neben latenten Steueransprüchen auf Verlustvorträge in Höhe von TEUR 2.086 auch gebildete Steueransprüche auf temporäre Differenzen in Höhe von TEUR 1.829. Der größte Teil dieser Wertberichtigungen wurde bei den Tochtergesellschaften in den USA, Frankreich und Japan sowie bei der Süss MicroTec Lithography GmbH notwendig. Die Wertberichtigungen reduzieren die latenten Steueransprüche auf einen Betrag, der nach Auffassung der Gesellschaft – basierend auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Gewinne sowie des Zeitpunkts der Umkehrung zeitlicher Buchungsunterschiede – wahrscheinlich realisiert werden kann.

Im Vorjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf latente Steueransprüche in Höhe von TEUR 8.850 vorgenommen. Der größte Teil dieser Wertberichtigung betraf latente Steueransprüche auf Verlustvorträge und wurde bei den deutschen Gesellschaften einschließlich der SÜSS MicroTec AG in Höhe von TEUR 5.957 notwendig. Bei den Gesellschaften in Frankreich und den USA erfolgten insgesamt Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 474 bzw. TUSD 3.108.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

TEUR	Aktiva		Passiva	
	2005	2004	2005	2004
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.247	4.728		
Pensionsrückstellungen	1.273	1.249		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.939	6.674		
Sonstige langfristige Rückstellungen	135	77		
Immaterielle Vermögenswerte			2.773	3.243
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte			40	86
Finanzverbindlichkeiten			201	244
Geschäfts- oder Firmenwert			513	313
Vorratsvermögen			429	4.656
Sachanlagen			606	473
Sonstiges	1.023	456		
Verlustvorträge	18.172	14.898		
./. Wertberichtigung Verlustvorträge	-15.556	-13.190		
./. Wertberichtigung auf weitere latente Steueransprüche	-2.841	-1.047		
Gesamt	7.392	13.845	4.562	9.015

Der Konzern verfügt über Verlustvorträge in Höhe von TEUR 47.175 (2004: 38.783). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2010 insgesamt TEUR 7.360 und nach weiteren zwei Jahren nochmals TEUR 1.452. Im Zeitraum von 2022 bis 2025 verfallen insgesamt TEUR 7.989. Ein Teil der Verlustvorträge in Höhe von TEUR 30.374 ist unbegrenzt nutzbar.

III.8 Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

	2005	2004
Zähler:		
Jahresergebnis	-8.228	-16.386
Nenner:		
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien		
unverwässert	15.722.299	15.134.384
Verwässerung	0	0
verwässert	15.722.299	15.134.384
Ergebnis je Aktie in EUR:		
unverwässert	-0,52	-1,08
verwässert	-0,52	-1,08



Im Geschäftsjahr 2005 wurden 733.175 Aktien aus der im Geschäftsjahr 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwässerungseffekt führen würde.

Die ausgegebenen Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft wurden bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung ebenfalls zu einem negativen Verwässerungseffekt führen würde.

III.9 Sonstige Angaben zur IFRS-Konzerngewinn- und Verlustrechnung

Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

TEUR	2005	2004
Löhne und Gehälter	32.613	37.349
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	5.764	5.140
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.013	2.336
Personalaufwand	40.390	44.825

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betrugen in 2005 TEUR 49.212 (2004: TEUR 41.373).

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Immaterielle Vermögenswerte	4.227	4.359
Geschäfts- oder Firmenwert	1.839	0
Sachanlagen	3.931	2.888
Finanzanlagen	22	0
Abschreibungen	10.019	7.247

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 3.376 (2004: TEUR 411) vorgenommen. Diese Abschreibungen betreffen neben dem Geschäfts- oder Firmenwert (TEUR 1.839) Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung) in Höhe von TEUR 1.515, deren Buchwerte nicht mehr durch die erwarteten Veräußerungserlöse bzw. diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt waren.

Zudem wurden infolge anhaltender Verluste außerplanmäßige Abschreibungen auf At-equity bewertete Beteiligungen (Finanzanlagen) von TEUR 22 vorgenommen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen des Vorjahres betrafen immaterielle Vermögenswerte (Standard-Softwarelizenzen).

IV. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

IV.1 Immaterielle Vermögenswerte

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von TEUR 4.061 (2004: TEUR 5.657) Entwicklungsleistungen von TEUR 9.573 (2004: TEUR 7.528) ausgewiesen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Produktionslinie für die C4NP-Technologie sowie neuer Maschinen in den Segmenten Lithography und Substrate Bonder.

Änderungen in der künftigen IT-Ausrichtung des Konzerns machten im Vorjahr in Deutschland außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 411 auf Standard-Softwarelizenzen notwendig. Diese außerplanmäßigen Abschreibungen sind im Vorjahr in den allgemeinen Verwaltungs- und Vertriebskosten enthalten.

IV.2 Geschäfts- oder Firmenwert

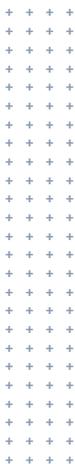
Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert von TEUR 23.560 enthält einen Fremdwährungsanteil von TUSD 9.588 aus dem Erwerb US-amerikanischer Geschäftsbetriebe in Vorjahren. IAS 21 sieht vor, dass ein Geschäfts- oder Firmenwert, der aus dem Erwerb eines ausländischen Geschäftsbetriebs und Anpassungen des Buchwerts der erworbenen Vermögenswerte und Schulden an den beizulegenden Zeitwert entsteht, wie ein Vermögenswert des ausländischen Geschäftsbetriebs zu behandeln und damit zum Stichtagskurs umzurechnen ist. Die aus der Stichtagsbewertung resultierenden Fremdwährungsdifferenzen des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 1.079 (2004: -TEUR 575) werden erfolgsneutral im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst.

Zu den vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert verweisen wir auf die Textziffer III.3.

IV.3 Sachanlagen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagepiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von TEUR 692 (2004: TEUR 579) auch geleaste Technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleaste Grundstücke, Gebäude und Einbauten enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrundeliegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.



IV.4 At-equity bewertete Beteiligungen

Die mittels der At-equity Methode bewertete Beteiligung an der HUGLE Lithography Inc., USA (Anteil 53,1 %) wurde im Geschäftsjahr vollständig abgewertet. Die Gesellschaft ist inaktiv.

IV.5 Sonstige Finanzanlagen

Der Konzern hält weitere Beteiligungen mit Anteilen von weniger als 20 %. Diese werden bei Vorliegen von Marktwerten mit diesen bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen.

IV.6 Sonstige langfristige Vermögenswerte

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen sowie geleistete Kauttionen für angemietete Bürogebäude.

TEUR	2005	2004
Rückdeckungsversicherung	196	273
Kauttionen	167	159
Ausleihungen	0	198
Sonstiges	1	41
Sonstige langfristige Vermögenswerte	364	671

IV.7 Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen lässt sich wie folgt aufteilen:

TEUR	2005	2004
Materialien und Hilfsstoffe	21.037	15.970
Unfertige Erzeugnisse	9.337	13.778
Fertigerzeugnisse	21.489	24.893
Demonstrationsgeräte	10.032	10.556
Handelswaren	135	141
Wertberichtigungen	-8.193	-7.896
Vorratsvermögen	53.837	57.442

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2005 bilanzierten Vorräte in Höhe von TEUR 53.837 (2004: TEUR 57.442) sind TEUR 8.162 zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

IV.8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

TEUR	2005	2004
Forderungen gegen Dritte	24.807	25.337
Wertberichtigungen	-1.126	-1.438
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.681	23.899

IV.9 Wertpapiere

Als „available for sale“ behandelt die Gesellschaft unter dieser Position den Aktienbesitz an der JMAR Technologies, Inc., der aus der Veräußerung von Patenten und der Technologie betreffend Röntgenlithografie im Geschäftsjahr 2001 stammt.

Der Aktienbestand wurde zum Bilanzstichtag mit dem Marktwert angesetzt, der aus dem amtlichen Börsenkurs abgeleitet wurde. Der durch die Marktwertänderung entstandene unrealisierte Verlust in Höhe von TEUR 17 wurde ergebnisneutral innerhalb des Eigenkapitals im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen. Der Wert der Aktien beträgt zum Jahresende TEUR 58 (2004: TEUR 74).

IV.10 Steuerforderungen

Die Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Höhe von TEUR 865 (2004: TEUR 1.590) sowie aus Forderungen im Bereich Umsatzsteuer in Höhe von TEUR 255 (2004: TEUR 218).

IV.11 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

TEUR	2005	2004
Aktive Rechnungsabgrenzung	906	835
Geleistete Anzahlungen	640	160
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschäften	107	279
Sonstiges	246	630
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1.899	1.904

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.



V. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

V.1 Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug zum Vorjahresstichtag TEUR 15.157. Es wurde am 26. August 2005 aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um TEUR 1.456 auf TEUR 16.613 erhöht. Der Bezugspreis für die neuen Aktien betrug EUR 4,70 pro Aktie. Insgesamt ergab sich aus der Kapitalerhöhung ein Brutto-Mittelzufluss von EUR 6,8 Mio. Der Aufsichtsrat hat dieser Kapitalerhöhung zugestimmt. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2005 vollumfänglich gewinnberichtigt.

Infolge der Ausübung von insgesamt 180.000 Bezugsrechten in den im Aktienoptionsplan 2002 vorgesehenen Ausübungszeiträumen wurde das Grundkapital aus bedingtem Kapital 2002/II durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um TEUR 180 auf TEUR 16.793 erhöht. Es ist in 16.792.968 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von EUR 1,00 eingeteilt. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital verringerte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Ausgabe neuer Aktien um TEUR 1.456 und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 6.022.

Am 31. Dezember 2005 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt TEUR 6.088. Es kann bis zu TEUR 4.800 für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden. Weitere TEUR 750 sind für die Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte des Konzerns aus dem Aktienoptionsplan 2005 vorgesehen. Der Restbetrag von TEUR 539 ist in Höhe von TEUR 268 dem alten, geschlossenen Aktienoptionsplan 1999 und in Höhe von TEUR 271 dem Aktienoptionsplan 2002 zuzuordnen.

TEUR	2005	2004
Grundkapital	16.793	15.157
Genehmigtes Kapital	6.022	7.478
Bedingtes Kapital	6.088	5.797

Rücklagen

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Kapitalrücklage	90.673	84.917
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzverlust	-24.466	-16.233
Rücklagen	66.640	69.117

Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Geschäftsjahr durch das Agio aus der Kapitalerhöhung nach Berücksichtigung angefallener Kosten um TEUR 5.279 und durch die Ausübung von Aktienoptionen um TEUR 19. Zudem wurden der Kapitalrücklage aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne TEUR 458 ergebniswirksam zugeführt.

Im Vergleich zum Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG nach HGB unterscheidet sich die Kapitalrücklage im IFRS-Konzernabschluss durch die unterschiedliche Behandlung der Wandel- und Optionsanleihe sowie der Kosten der Kapitalerhöhungen in beiden Rechnungslegungsstandards.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bilanzverlust erhöhte sich durch das negative Jahresergebnis von TEUR -8.233 vor Berücksichtigung von Minderheiten auf TEUR -24.466. Die Unterschiede aus der Umstellung der Rechnungslegung von US-GAAP auf IFRS wurden zum 1. Januar 2004 vollständig mit dem Bilanzverlust verrechnet.

Kumuliertes übriges Eigenkapital

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

TEUR	2005	2004
Fremdwährungsanpassungen	-880	0
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	-22	0
Stand zu Beginn der Periode	-902	0
Veränderungen vor Steuern		
Fremdwährungsanpassungen	1.595	-880
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	-16	-35
Steuereffekte		
Fremdwährungsanpassungen	0	0
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	6	13
Stand am Ende der Periode	683	-902

Aktienoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

Aktienoptionsplan 1999

In der Hauptversammlung vom 6. April 1999 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 800 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 800.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. März 2004 zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von 3 Jahren, zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von 5 Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs der Aktien des Unternehmens den Bezugspreis bei Ausübung des Bezugsrechts nach drei Jahren um mindestens 50 %, nach vier Jahren um mindestens 75 % bzw. nach fünf Jahren um mindestens 100 % übersteigt. Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. sechs Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.



In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde das bedingte Kapital für diesen Optionsplan auf TEUR 350 gesenkt. Die Ausgabe von Bezugsrechten auf Basis des Aktienoptionsplans 1999 wurde für die Zukunft aufgehoben.

Aktienoptionsplan 2002

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 500 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von 2 Jahren zu 100% ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts (entspricht 7,5 % für 12 Monate) übersteigt und zusätzlich sich im selben Zeitraum der Börsenkurs prozentual gleich oder besser entwickelt hat, als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolindex

oder

- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833 % pro vollem Kalendermonat (10 % pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung übersteigt.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

Aktienoptionsplan 2005

In der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 750 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund 2 Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat

oder

- der Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333% pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. am Ende der Laufzeit. Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von fünf Jahren.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 458 (2004: TEUR 750) für diese Pläne vorgenommen.

Aus dem in der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 genehmigten Kapital wurden im Berichtsjahr insgesamt 193.000 Bezugsrechte mit einem Bezugskurs von EUR 4,95 gewährt. Im Vorjahr wurden aus genehmigtem Kapital 248.408 Bezugsrechte mit einem Bezugskurs von EUR 3,44 gewährt.

Am 31. Dezember 2005 bestanden insgesamt 673.027 Bezugsrechte (2004: 761.963 Bezugsrechte).

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Jahr 2005 gewährten Optionen in Höhe von EUR 1,6152 wurde unter Verwendung des Black-Scholes Optionsbewertungsmodells berechnet. Für die Ermittlung des Marktwerts werden folgende Parameter verwendet:

	2005	2004
Erwartete durchschnittl. Laufzeit	5 Jahre	6 Jahre
Risikofreier Zinssatz	2,82 %	3,58 %
Erwartete Volatilität SÜSS-Aktie	31 %	39 %
Erwartete Dividende	0 %	0 %

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienerwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in EUR
01.01.2004	523.796	15,68
gewährt 2004	248.408	3,44
ausgeübt 2004	0	
verfallen 2004	10.241	19,64
31.12.2004	761.963	11,64
gewährt 2005	193.000	4,95
ausgeübt 2005	180.000	1,11
verfallen 2005	101.936	12,37
31.12.2005	673.027	12,42
ausgeübt	204.400	
noch begebbar	557.000	



Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

Bereich des Bezugspreises	Anzahl Bezugsrechte	gewichteter durchschnittl. Bezugspreis EUR	gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit Monate
unter EUR 10,00	462.358	3,96	56
EUR 10,00 – EUR 19,99	0	0	0
EUR 20,00 – EUR 24,99	0	0	0
EUR 25,00 – EUR 29,99	118.669	27,31	11
EUR 30,00 – EUR 35,99	68.000	35,44	17
ab EUR 36,00	24.000	36,00	11
	673.027	12,42	43

V.2 Pensionsrückstellungen

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Inländische Verpflichtungen	2.124	2.217
Ausländische Verpflichtungen	457	348
Gesamt	2.581	2.565

Leistungsorientierte Pläne („Defined benefit plans“)

Der Konzern verfügt in Deutschland und Japan über leistungsorientierte Pensionspläne. Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2005	2004
Abzinsungsfaktor	4,00 %	5,25 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	4,70 %	4,70 %
Gehaltssteigerung	0,0 %	0,0 %
Rentensteigerung	1,0 %	1,0 %
Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005		

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Änderung der Nettoverpflichtung für Pensionen in den Geschäftsjahren 2005 und 2004:

TEUR	2005	2004
Rückstellung zum 1.1.	2.565	2.639
Aufwendungen aus Pensionsverpflichtung	214	98
Geleistete Fondsdotierungen	42	44
Versicherungsmathematischer Verlust	15	57
Pensionszahlungen	-255	-273
Rückstellung zum 31.12.	2.581	2.565



Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

TEUR	2005	2004
Barwert der Pensionsverpflichtungen	4.013	3.607
Zeitwert des Planvermögens	-1.265	-1.248
Errechnete Pensionsverbindlichkeit	2.748	2.359
Nicht realisierte versicherungsmathematische Gewinne und Verluste	-167	206
Rückstellung	2.581	2.565

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von TEUR 1.770 (2004: TEUR 1.528) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

TEUR	2005	2004
Dienstzeitaufwand	108	23
Auswirkungen aus Planänderungen	0	-37
Personalaufwandskomponente	108	-14
Zinsaufwand	164	176
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-58	-64
Zinsaufwandskomponente	106	112

Beitragsorientierte Pläne („Defined contribution plans“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge werden jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von 6 Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2005 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den Gewinnbeteiligungsplan TUSD 0 (2004 TUSD 0) und für den 401 (k) Plan TUSD 148 (2004 TUSD 166).

V.3 Sonstige langfristige Rückstellungen

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

TEUR	Stand 01.01.2005	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2005
Altersteilzeit	445	-162	-42	214	455

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der Suss MicroTec Lithography GmbH, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung/Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

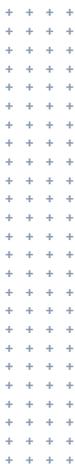
Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter eine Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelt beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

V.4 Finanzverbindlichkeiten

Die Fälligkeitsstruktur der Anleihen, der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2005 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31. Dezember 2005	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
TEUR				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.114	4.581	569	14.264
Verbindlichkeiten aus Anleihen	3.457	373	0	3.830
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	261	434	0	695
Gesamt	12.832	5.388	569	18.789

31. Dezember 2004	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
TEUR				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.898	8.685	737	14.320
Verbindlichkeiten aus Anleihen	5.634	3.095	0	8.729
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	137	388	0	525
Gesamt	10.669	12.168	737	23.574



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich in Höhe von TEUR 3.611 (2004: TEUR 2.550) aus der Inanspruchnahme eingeräumter Kreditlinien sowie in Höhe von TEUR 10.653 (2004: TEUR 11.770) aus langfristigen Darlehensverträgen zusammen.

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

TEUR	2005	2004
Kreditlinie	5.158	16.491
Inanspruchnahme	3.611	2.550
Verfügbare Kreditlinie	1.547	13.941

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 3,83% (2004: 6,39%).

Aus dem im Vorjahr mit der IBM Deutschland Kreditbank GmbH geschlossenen Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme in Höhe von TEUR 3.350 wurde im Geschäftsjahr ein weiterer Teilbetrag in Höhe von TEUR 1.250 ausbezahlt. Der Darlehensbetrag dient zur Finanzierung der Entwicklung einer Produktionsmaschine gemäß Joint Development Agreement mit der IBM Corporation, USA. Es wurde ein variabler Zinssatz in Höhe des Ein-Monats-Euribors zuzüglich eines risikoadäquaten Aufschlages vereinbart. Die Effektivverzinsung im Geschäftsjahr lag bei 7,55 % p.a. Die Auszahlung des Darlehens richtet sich nach dem Projektfortschritt. Zum Bilanzstichtag waren insgesamt TEUR 2.500 ausbezahlt. Das Darlehen ist spätestens am 30. Juni 2006 vollständig zurückzuführen.

Die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres waren wie folgt:

Konzerngesellschaft	2005	2004	Zinssatz	Fälligkeit
SUSS MicroTec Test Systems GmbH (EUR)	2.542	3.178	3,25 %	30.9.2009
SUSS MicroTec Lithography GmbH (EUR)	2.556	3.196	3,75 %	30.9.2009
SUSS MicroTec Lithography GmbH (EUR)	441	588	3,75 %	30.12.2008
Image Technology Inc. (USD)	474	692	9,81 %	11.4.2007
Image Technology Inc. (USD)	134	201	8,75 %	11.4.2007
Image Technology Inc. (USD)	436	655	8,75 %	11.4.2007
SÜSS MicroTec AG (EUR)	2.516	1.250	variabel	30.6.2006
Sonstige Darlehen < 1 Mio EUR	1.554	2.010		
Gesamt	10.653	11.770		
...davon kurzfristig fällig	5.503	2.348		
...davon langfristig fällig	5.150	9.422		
... fällig in 2006	5.503			
2007	1.760			
2008	1.401			
2009	1.250			
2010	170			
...später	569			
	10.653			

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Nach der zum 31. Oktober 2005 geleisteten Rückzahlung eines Teils der Wandelanleihe in Höhe von TEUR 5.634 beläuft sich der Gesamtbetrag der im November 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe zum Bilanzstichtag noch auf insgesamt TEUR 3.830. Hiervon entfallen TEUR 3.457 auf eine Wandelanleihe, die mit 6 % p.a. verzinst wird und in voller Höhe am 30. April 2006 rückzahlbar ist, sofern sie nicht während dieser Laufzeit in bis zu 919.810 Aktien der SÜSS MicroTec AG umgewandelt wird. Der Wandlungspreis beträgt hierfür EUR 9,5967 pro Aktie. Die SÜSS MicroTec AG kann den Umtausch von bis zu 30 % des Nennbetrages verlangen, wenn der Aktienkurs während 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 140 % des Wandlungspreises liegt. Ein Umtausch von bis zu 50 % des Nennbetrages kann von der Gesellschaft verlangt werden, wenn der Aktienkurs während 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 200% des Wandlungspreises liegt.

Des Weiteren entfallen TEUR 373 auf eine Optionsanleihe, die gleichfalls mit 6 % p.a. verzinst wird und, vorbehaltlich der Ausübung von Bezugsrechten auf Aktien, am 31. Oktober 2008 rückzahlbar ist. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der SÜSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie beträgt EUR 10,0561 und liegt um 5 % über dem Wandlungspreis. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich Barzahlung von EUR 9,0561 je Aktie. Die Gesellschaft kann ab dem 4. November 2004 die Ausübung von 33 1/3 % der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 135 % über dem Bezugspreis liegt. Die komplette Ausübung des Bezugsrechte kann ab 4. November 2004 verlangt werden, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 200% über dem Bezugspreis liegt.

Der Bilanzausweis der Wandel- und Optionsanleihe erfolgt nach Verrechnung mit den über die Laufzeit der Anleihe zu amortisierenden Ausgabekosten.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, Technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance Lease-Verträge, deren zugrundeliegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden. Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

TEUR	Finance Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahestehenden Personen
Abschreibungen / Aufwendungen 2005	470	2.640	1.630
Abschreibungen / Aufwendungen 2004	267	2.997	1.809
... fällig in 2006	291	2.306	1.630
2007	226	1.540	1.301
2008	194	1.340	1.301
2009	38	348	321
2010	1	321	321
... später	0	641	641
Gesamt zukünftig	750	6.496	5.515
Zinsanteil	55		
Verbindlichkeit 31.12.2005	695		
... davon kurzfristig	261		
... davon langfristig	434		



V.5 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten sind folgende Positionen enthalten:

TEUR	2005	2004
Darlehen von Mitarbeitern	96	97
Lieferantenverbindlichkeiten	0	139
Sonstiges	149	193
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	245	429

V.6 Sonstige kurzfristige Rückstellungen

Die sonstigen kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Garantierückstellungen	1.350	1.266
Abfindungen	435	1.553
Restrukturierung	0	1.569
Übrige Rückstellungen	2.183	2.243
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.968	6.631

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Der Vorjahresausweis bei den Abfindungen enthält eine bilanzielle Vorsorge für das Ausscheiden von Herrn Dr. Richter. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich die Gesellschaft mit Herrn Dr. Richter auf die endgültige Höhe der Abfindung geeinigt. Die gebildete Rückstellung wurde entsprechend verbraucht bzw. aufgelöst.

Die im Vorjahr gebildete Rückstellung für Restrukturierung stand im Zusammenhang mit der Schließung des Werkes in Aßlar (TEUR 1.369) sowie eines Vertriebsbüros in den USA (TEUR 200).

Die Restrukturierungsmaßnahmen in Aßlar wurden im Geschäftsjahr 2005 abgeschlossen und die gebildete Rückstellung in Höhe von TEUR 1.284 verbraucht und in Höhe von TEUR 85 aufgelöst. Der damit verbundene Personalabbau von 39 Mitarbeitern wurde im ersten Quartal des Berichtsjahres durchgeführt.

Die für die Schließung eines Vertriebsbüros in den USA gebildete Vorjahresrückstellung von TEUR 200 wurde im Berichtsjahr verbraucht.

Die sonstigen kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

TEUR	Stand 01.01.2005	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2005
Garantierückstellungen	1.266	-1.019	-247	1.350	1.350
Abfindungen	1.553	-900	-653	435	435
Restruktuierung	1.569	-1.484	-85	0	0
Übrige Rückstellungen	2.243	-1.140	-151	1.231	2.183
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	6.631	-4.543	-1.136	3.016	3.968

V.7 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

TEUR	2005	2004
Erhaltene Anzahlungen	25.009	27.607
Abgegrenzte Personalkosten	5.730	4.413
Fremdleistungen	2.572	1.761
Prämien und Provisionen	1.220	1.070
Passive Rechnungsabgrenzung	604	377
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschäften	536	0
Umsatzsteuer	206	211
Abgegrenzte Fördermittel	127	475
Rückkaufgarantien	0	188
Sonstiges	97	82
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	36.101	36.184

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände, Gleitzeitguthaben, Erfolgsbeteiligungen sowie für Tantiemen enthalten.



VI. SONSTIGE ANGABEN

VI.1 Finanzinstrumente

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.

Originäre Finanzinstrumente

Die geschätzten Marktwerte der originären Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde.

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Flüssige Mittel: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Finanzverbindlichkeiten: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt. Bei variabel verzinsten Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte annähernd ihren Marktwerten, da die Zinssätze auf variablen Zinsen basieren, die sich an den Marktsätzen orientieren.

Wandel- und Optionsanleihe: Zur Ermittlung des Marktwerts der auf Basis der Wandel - und Optionsanleihe bestehenden Finanzverbindlichkeiten wurde die bestehende Verzinsung mit einem Referenzzinssatz verglichen, den ein Kreditinstitut verwenden würde. Dabei wurden insbesondere die Nachrangigkeit und die fehlende Besicherung der Wandelanleihe berücksichtigt. Ebenso wurden Annahmen für das aktuelle Rating des Konzerns getroffen.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease: Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Marktwerte der originären Finanzinstrumente sind in nachfolgender Übersicht dargestellt:

TEUR	2005		2004	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.264	13.911	14.320	14.361
Verbindlichkeiten aus Anleihen	3.830	4.116	8.729	8.457
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	695	688	525	520

Für sonstige originäre Finanzinstrumente entsprechen die Zeitwerte den zu den jeweiligen Stichtagen bilanzierten Buchwerten.

Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen zu begrenzen. Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des USD und des YEN, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem EURO-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt, ihr Ansatz erfolgt zu Marktwerten gemäß den Bankenmitteilungen.

Zum 31. Dezember 2005 und 2004 bestanden folgende Devisentermingeschäfte:

	2005		2004	
	Nominalvolumen	Marktwert in TEUR	Nominalvolumen	Marktwert in TEUR
Verkauf von US-Dollar (in TUSD)	13.730	-534	3.560	182
...davon bis zu einem Jahr	13.730	-534	3.560	182
...davon bis zu zwei Jahren	0	0	0	0
Verkauf von Yen (in Mio JPY)	272,3	90	306,2	97
...davon bis zu einem Jahr	272,3	90	306,2	97
Kauf von US-Dollar (in TUSD)	2.000	15	0	0
...davon bis zu einem Jahr	2.000	15	0	0

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen ermittelt. Zum 31. Dezember 2005 wurden die Devisentermingeschäfte mit ihren Marktwerten bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die dargestellten Kontraktwerte stellen die Summe der zum 31. Dezember 2005 bestehenden Verpflichtungen dar. Die potentiellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

VI.2 Nahestehende Personen

SÜSS Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR und Hungar Mountains

Verschiedene Konzerngesellschaften (Suss MicroTec Lithography GmbH, Suss MicroTec Test Systems GmbH, Suss MicroTec Inc.) mieten ihre Geschäftsräumlichkeiten von der SÜSS Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR oder der Grundstücksverwaltungsgesellschaft Hungar Mountains, USA. Die daraus resultierenden Mietaufwendungen und die sich aus den Verträgen ergebenden zukünftigen Mindestleasingraten sind in V.4 dargestellt.

TEUR	2005	2004
Mietaufwendungen	1.630	1.809



Familie Süss

Die Familie Süss als ehemalige Gesellschafter und heutige Aktionäre des Unternehmens hat Bezüge in verschiedenster Form, u.a. als Pensionsansprüche und Mietzahlungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der Familie Süss dar. Die Pensionsansprüche sind in V.2 Pensionsrückstellungen dargestellt.

TEUR	2005	2004
Gehälter und Pensionen	330	353

CMS Hasche Sigle

Das Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Schücking ist Gesellschafter der CMS Hasche Sigle, einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Gruppe nimmt Rechtsberatung von dieser Kanzlei in Anspruch.

TEUR	2005	2004
Beratungsaufwendungen	74	42

Leistungen an nahestehende Personen

TEUR	2005	2004
Gehälter und Pensionen	330	353
Beratungsaufwendungen	74	42
Mietaufwendungen	1.630	1.809
Summe	2.034	2.204

Hinsichtlich der Vergütungen an den Aufsichtsrat und den Vorstand verweisen wir auf VI.6.

VI.3 Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Bestellobligo	13.465	5.728
Mietverpflichtungen	7.277	9.498
Sonstiges	160	394
Summe	20.902	15.620

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

Die Verpflichtungen aus Mietverträgen beinhalten in Höhe von TEUR 5.515 (2004: TEUR 7.751) Verpflichtungen gegenüber nahestehenden Personen.

Die Gesellschaft ist im Mai des Vorjahres im Zusammenhang mit der Einbringung von Geschäftsanteilen in die SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2000 vom Rechtsbeistand der einbringenden Partei darauf hingewiesen worden, bei der steuerlichen Behandlung der

Einbringung eine angeblich im Zusammenhang mit dem Einbringungsvertrag geschlossene Abrede nicht beachtet zu haben. Gegenwärtig ist nicht abzusehen, ob es in dieser Angelegenheit zu einer streitigen Auseinandersetzung kommt. Der Vorstand, der sich auf die Angaben seines Rechtsbeistandes stützt, sieht die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage der Gegenpartei eher gering und hat daher keine Rückstellung für ein mögliches Prozessrisiko gebildet.

VI.4 Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cash Flow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Ein Teil von TEUR 1.907 (2004: TEUR 0) der ausgewiesenen flüssigen Mittel dient zum Bilanzstichtag als Sicherheit für Finanztermingeschäfte bei Banken.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

VI.5 Segmentberichterstattung

Informationen zu den Segmenten

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IAS 14 („Segment Reporting“) nach Produktlinien als primärem Berichtsformat und nach Regionen als sekundärem Berichtsformat abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder, Device Bonder und Test Systeme aufgeteilt. Zudem werden im Segment Sonstige weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bei Stuttgart angesiedelt. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind vor allem am Standort Waterbury, Vermont, in den USA konzentriert. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa und in Asien ansässig. Insbesondere der sogenannte Bond Cluster, der vakuumfreies Bonden ermöglicht, stellt ein wesentliches Standbein dieses Segmentes dar. Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6 und 8 Zoll Wafer-Anwendungen angeboten.



Das Segment Device Bonder befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb der Produktlinie Device Bonder. Die Segmentaktivitäten sind in St. Jeoire, Frankreich, ansässig. An diesem Standort befinden sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Aufgrund der technischen Komplexität und der geringen Größe des Marktes sind keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

Das Segment Test Systeme ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind dort angesiedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment. Die Test Systeme sind im Wesentlichen für Laboranwendungen, insbesondere z. B. für die Fehleranalyse, aber auch teilweise für Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme) bestimmt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

Sonstige Erläuterungen zur Segmentberichterstattung

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. Infolge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Im Geschäftsjahr 2005 wurden von der SÜSS MicroTec AG TEUR 2.814 (2004: TEUR 3.012) an das Segment Lithografie, TEUR 685 (2004: TEUR 807) an das Segment Substrat Bonder, TEUR 377 (2004: TEUR 525) an das Segment Device Bonder und TEUR 1.272 (2004: TEUR 1.164) an das Segment Test Systeme weiterbelastet.

Die dargestellte Ergebnisgröße stellt den jeweiligen Ergebnisbeitrag der Segmente dar. Das Segmentergebnis entspricht dabei dem Ergebnis vor Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung und aus Anlagenabgängen, vor Zinserträgen und -aufwendungen sowie vor Ertragsteuern.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch der Personalaufwand aus den Aktienoptionsplänen sowie die Auflösung von Rückstellungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inkl. Geschäfts- oder Firmenwert, Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres enthalten insgesamt außerplanmäßige Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von TEUR 1.839. Sie sind vollständig dem Segment Device Bonder zuzuordnen.

Für die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.

VI.6 Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec AG im Jahr 2005 waren:

Herr **Dr. Stefan Schneidewind**, Dipl.-Ingenieur, Moritzburg/OT Reichenberg, Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche: Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Materialwirtschaft und Logistik, Produktion und Facility Management, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz, Vertrieb und Marketing, Konzernstrategie

Herr **Stephan Schulak**, Dipl.-Betriebswirt FH, Rohrbach, Mitglied des Vorstands

Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Investor Relations, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

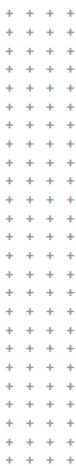
Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr TEUR 672. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak insgesamt TEUR 46 bzw. TEUR 36 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausbezahlt. Für Herrn Dr. Schneidewind hat die Gesellschaft zusätzlich Kosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung in Höhe von TEUR 22 getragen.

Für den Jahresbonus 2005 von Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von TEUR 150 gebildet.

Zudem wurden an Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak jeweils 40.000 Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben. Der Marktwert pro Option betrug bei Ausgabe EUR 1,6152.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

	Dr. Stefan Schneidewind	Stephan Schulak
Barvergütung (TEUR)		
Fixum	288	234
Erfolgsbezogen	83	67
Summe	371	301
Aktioptionen		
Anzahl	40.000	40.000
Ausübungspreis	4,95	4,95



Weiterhin wurden aufgrund der in 2000, 2001, 2003, 2004 und 2005 an Vorstände gewährten Optionen TEUR 122 als Personalaufwand in der Holding erfasst.

Aus einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung wurde im Geschäftsjahr an Herrn Dr. Richter eine Abfindungszahlung in Höhe von TEUR 850 sowie eine Tantiemehzahlung in Höhe von TEUR 42 für das am 31. Dezember 2004 abgelaufene Geschäftsjahr geleistet. Zudem wurde die weitere Nutzung des Dienstwagens bis zum Ablauf des Leasingvertrages Mitte Juni 2005 vereinbart. Dafür fielen Leasingzahlungen in Höhe von TEUR 9 an. Die Herrn Dr. Richter insgesamt gewährten 145.000 Aktienoptionen sind nicht mit dem Ende der Vorstandsbestellung verfallen. Sie können gemäß der geltenden Ausübungsvoraussetzungen bis zum 30. Juni 2008 ausgeübt werden.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von TEUR 6 (2004: TEUR 3).

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2005:

Dr. Winfried Süß, München, Aufsichtsratsvorsitzender

weitere Mandate: ISIT, Itzehoe, (Kurator)

Thomas Schlytter-Henrichsen, Kronberg/Taunus, Geschäftsführer, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. e. h. Horst Görtz, Neu-Anspach, Kaufmann

Peter Heinz, Waterbury, Vermont, USA, Diplom-Kaufmann (ab 21. Juni 2005)

weitere Mandate: H&H Associates Inc., Waterbury, Vermont, USA (Mitglied im Aufsichtsrat)

Prof. Dr. Anton Heuberger, München, Professor an der TU CAU Kiel

weitere Mandate: West Steag Partners AG, Essen (Mitglied im Beirat)
 IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)
 Sollith Batteries GmbH, Itzehoe, (Mitglied im Beirat)
 Sensor Dynamics, Graz, Österreich (Mitglied im Aufsichtsrat)

Dr. Christoph Schücking, Frankfurt/Main, Rechtsanwalt und Notar

weitere Mandate: Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt a. M. (stellvertretender Vorsitzender im Gesellschafterausschuss)
 Kennametal GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)
 Kennametal Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)
 Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)
 Freudenberg & Co., Weinheim/Bergstraße (Mitglied im Gesellschafterausschuss)

Dr. Thomas Sesselmann, Tittmoning, Geschäftsführer (bis 21. Juni 2005)

weitere Mandate: Heidenhain Holding Inc., Wilmington, DE., USA (Mitglied Board of Directors)
Heidenhain Holding K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)
ACU-RITE Companies Inc., Jamestown, NY, USA (Mitglied Board of Directors)
Heidenhain K.K., Nagoya, Japan (Mitglied Board of Directors)
SUMTAK Corporation, Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr insgesamt EUR 42.180. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats verzichtete auf seine Bezüge. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten je EUR 7.669 und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhielt EUR 11.504.

Aus seiner Zeit als Geschäftsführer der heutigen Süss MicroTec Lithography GmbH besteht für Herrn Dr. Süss, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, zum Bilanzstichtag eine Pensionsrückstellung in Höhe von TEUR 2.243 (2004: TEUR 2.079).

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

	2005		2004	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Dr. Stefan Schneidewind	6.571	69.648	0	35.648
Stephan Schulak	13.000	80.286	0	80.286
Dr. Winfried Süss	1.131.000	0	1.025.000	0
Thomas Schlytter-Henrichsen	6.909	0	6.909	0
Dr. e. h. Horst Görtz	3.894	0	3.894	0
Peter Heinz	1.338	0	0	0
Prof. Dr. Anton Heuberger	0	0	0	0
Dr. Christoph Schücking	500	0	500	0
Dr. Thomas Sesselmann	0	0	0	0

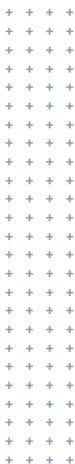
VI.7 Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 684 Mitarbeiter (2004: 733 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2005	2004
Verwaltung	92	106
Marketing und Vertrieb	250	239
Produktion und Technik	332	386
Summe	674	731

In den At-equity bewerteten Gesellschaften waren durchschnittlich Mitarbeiter 0 (2004: 0 Mitarbeiter) tätig.



VI.8 Honorare des Abschlussprüfers

Der im Geschäftsjahr 2005 für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honoraraufwand nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB beträgt TEUR 456 (2004 TEUR 347) und setzt sich wie folgt zusammen:

TEUR	2005	2004
Abschlussprüfung	359	322
Steuerberatung	52	25
Sonstige Leistungen	45	0
Gesamt	456	347

Die Position Abschlussprüfung enthält das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die Prüfung der Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften.

In der Position Steuerberatung ist das Honorar für die steuerliche Beratung der SÜSS MicroTec AG in ausgewählten steuerlichen Einzelfragen enthalten.

VI.9 Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben die nach §161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 4. Juli 2003) im Dezember 2005 abgegeben und im Internet unter www.suss.de dauerhaft zugänglich gemacht.

VI.10 Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG

Die Nobel SA, 64 rue Galilée, 75008 Paris, hat der Gesellschaft gem. § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG mitgeteilt, dass sie per 9. Mai 2005 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte an der SÜSS MicroTec AG unterschritten hat. Ihr Stimmrechtsanteil beträgt nun 4,69 %.

Am 11. Mai 2005 teilte Julius Baer Multistock, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, der SÜSS MicroTec AG mit, dass sie per 4. Mai 2005 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte an der Gesellschaft unterschritten hat und seit diesem Zeitpunkt einen Stimmrechtsanteil von 4,97 % hält.

Garching, 15. März 2006

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind

Stephan Schulak

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

„Wir haben den von der Süss MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

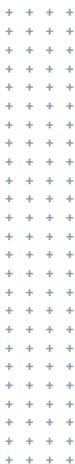
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 15. März 2006

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schumacher
Wirtschaftsprüfer

Querfurth
Wirtschaftsprüfer



GLOSSAR

300 MM-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (mehr als 90 %) der heute verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 200 Millimeter. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf eine Wafer hergestellt werden können (und je mehr Chips auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro einzelner Chip). Aktuell vollzieht sich der Übergang von 200 mm zu 300 mm Durchmesser der Wafer. Dies erfordert eine Anpassung der Herstellungs- und Prozesstechnologien in der Halbleitertechnik.

ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Bei neueren Chip-Designs ist die Zahl der Anschlusskontakte pro Chip inzwischen auf über 1.000 angestiegen. Unter „Advanced Packaging“ versteht man weiterentwickelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im so genannten „Frontend“ der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

ATOM

Kleinstes stabiles Element, das in der Natur vorkommt. Je nach Größe und Eigenschaft werden Atome in verschiedenen Elementen geordnet (Periodensystem der Elemente).

BACKEND

Zweiter (hinterer) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen durchführen lassen (Packaging Foundries).

BIOCHIP

Kleiner Chip aus Silizium, Glas, Kunststoff oder Papier, der in zahlreiche Mikrostrukturen unterteilt ist, auf denen sich spezielle Sonden aus biologisch aktiven Molekülen befinden.

BLUETOOTH

Technologie zur drahtlosen Übermittlung von Sprache und Daten über kurze Distanzen durch kurze Radiowellen. Wird überwiegend zur drahtlosen Kommunikation von verschiedenen elektronischen Geräten untereinander eingesetzt, z. B. Mobiltelefon mit Kopfhörer oder PC mit Drucker etc.

BONDEN

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. „Adhesives Bonden“ bedeutet das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte

Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwache atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (vander-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Bei einem anschließenden Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

BUMP

(Engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold o. Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugelchen auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

CHIP

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlusskontakte, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

CLUSTER

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen, die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern beschickt wird.

COMPOUND SEMICONDUCTOR

Siehe Verbindungshalbleiter.

COST OF OWNERSHIP (COO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders in Rahmen von Massenproduktionen von größter Bedeutung.

C4NP

IBM hat in den späten sechziger Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem „IBM System 3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen „IBM C4“ Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. „C4“ bedeutet Controlled Collapse Chip Connection und wird teilweise auch synonym für Flip-Chip-Bonding verwendet. „C4NP“ ist die Technologie der nächsten Generation des bewährten C4-Prozesses. „NP“ steht dabei für New Process.

DIE

„Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse eingebaut wurden. Sie entstehen auf dem Wafer, indem der Die die vielen Prozessschritte durchläuft. Die Dies befinden sich also während des gesamten Fertigungsprozesses auf dem Wafer. Erst wenn sie fertig sind, wird der Wafer in die einzelnen ICs zerschnitten und diese werden dann in die Gehäuse gesetzt. Diese gehäuseten Dies werden dann oft Chips genannt. „Die“, „IC“ und „Chip“ werden oft synonym verwendet.

DRAM

Dynamic Random Access Memory. Weltweit verbreitetster Speicherchip.

FAB

Fabriken, in denen ICs auf Wafern produziert werden. Die Errichtung einer großen Fab, mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Milliarden Dollar.

FLIP-CHIP-BONDING

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d. h., der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

FOTORESIST

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese veränderten Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

FOUNDRY

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für Vertrieb und Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

FRONTEND

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Hier werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

GAAS

Galliumarsenid; Halbleiterwerkstoff, der für die Herstellung von Mikrochips für optoelektronische und Hochfrequenz-Anwendungen verwendet wird. Aufgrund der gegenüber Silizium höheren Elektronenmobilität ermöglicht dieser Werkstoff die Realisierung schnellerer Mikrochips und damit leistungsstärkerer Geräte.

HALBLEITER

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher integrierter Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

LCD-TFT

LCD (Liquid Crystal Display). TFT (Thin-Film Transistor).

LCDs sind Flüssigkristalldisplays, bestehend aus zwei Glasplatten mit stromführenden Leiterbahnen. Das Flüssigkristall zwischen den Platten lässt normales Licht durch. Wird ein elektrisches Feld in den Glasplatten erzeugt, lassen die Kristalle an dieser Stelle kein Licht mehr durch, es entsteht ein schwarzer Punkt. TFT ist eine spezielle Technologie der elektrischen Ansteuerung der LCDs. Hier ist – anders als bei den alternativen „Passiv Matrix LCD“ – jeder einzelne Bildpunkt (Pixel) über einen Transistor ansteuerbar. Diese sog. aktive Matrix ermöglicht eine bessere Bildqualität als die Passiv Matrix LCDs.

LED

Light Emitting Diode; Leuchtdiode. LEDs sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnfach so große Lebensdauer wie eine normale Glühbirne.

LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Silizium-Wafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske entsprechen den Strukturen, die in diesem Schritt auf die ICs gebracht werden sollen. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet, an lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Die Belichtung des Fotoresist führt zu einer chemischen Veränderung, die ein Auflösen des Fotoresist in einem Entwicklungsbad erlaubt. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in der Größenordnung von 0,13 bis 0,6 Mikrometer. Im Backend, beim Advanced Packaging, werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis zu einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

MASKE

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs gebraucht werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise. Die Maske wird dann beim Lithografie-Schritt eingesetzt, um bestimmte Bereiche zu belichten und so die zu ätzenden Bereiche zu definieren.

MEMS

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektrische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

MIKROMETER/MIKRON

Metrisches Längenmaß. Symbol: μm . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haars beträgt ca. 60 μm .



MIKROSYSTEM

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

MIKROSYSTEMTECHNIK (MST, MEMS, MOEMS)

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definition des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology, oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) der Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslösen des Airbags eingesetzt, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahl Druckers.

MOLEKÜL

Mehrere Atome können sich zu einem Molekül verbinden und dadurch völlig andere Eigenschaften annehmen.

NANOIMPRINTING

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

NANOTECHNOLOGIE

(Griech.: nānos = Zwerg) ist ein Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9} m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometer-Bereich zu schaffen.

OPTOELEKTRONIK

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit so genannten III/V-Materialien wie z. B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

PACKAGING FOUNDRIES

Siehe Backend.

PDA

Personal Digital Assistant. Elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch.

PLASMA(BEHANDLUNG)

Ein Plasma ist ein Gas, in dem Atome, Ionen und freie Elektronen gleichzeitig nebeneinander existieren. Durch elektrische Felder können Elektronen und Ionen beschleunigt werden und beim Auftreffen auf eine Oberfläche Veränderungen bewirken. Darüber hinaus können Plasmen Strahlung

erzeugen, die, je nach Wellenlänge, zur Strahlungsbehandlung von Materialien eingesetzt werden kann.

SENSOR

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

SILIZIUM

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

SYSTEMS-ON-CHIP

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich ist und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht Systems-on Chips immer größere Wichtigkeit.

TOOL

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zur einer Produktionslinie kombiniert werden.

VERBINDUNGSHALBLEITER

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

WAFER

Runde Scheiben aus Reinst-Silizium, auf denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 Millimeter vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300 mm Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200 mm Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

WIRE-BONDING

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

WIRELESS LAN

Direkt in Deutsch übersetzt bedeutet der Begriff „Kabelloses lokales Netzwerk“. Damit wird Bezug genommen auf die in jedem Bürogebäude vorhandenen Computernetzwerke. Beim Wireless LAN werden die Kabel durch eine Technik ähnlich dem Handynetz ersetzt.

YIELD

Die Ausbeute – ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

IMPRESSUM

Herausgeber: SÜSS MicroTec AG

Redaktion: Investor Relations, Group Accounting & Financial Reporting

Wirtschaftsprüfer: KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Konzept und Gestaltung: IR-One AG & Co., Hamburg

Druck: Hartung Druck + Medien GmbH, Hamburg

KONTAKT

SÜSS MicroTec AG

Schleißheimer Straße 90

85748 Garching, Deutschland

Fon: + 49 (0) 89 - 32007 - 0

E-mail: info@suss.de

Investor Relations

Fon: + 49 (0) 89 - 32007 - 314

E-mail: ir@suss.de

++++++
++++++
++++++

BILDNACHWEIS

Mit freundlicher Genehmigung von:

S. 4: Transparent: Bosch GmbH

S. 9: Transparent: Infineon Technologies AG

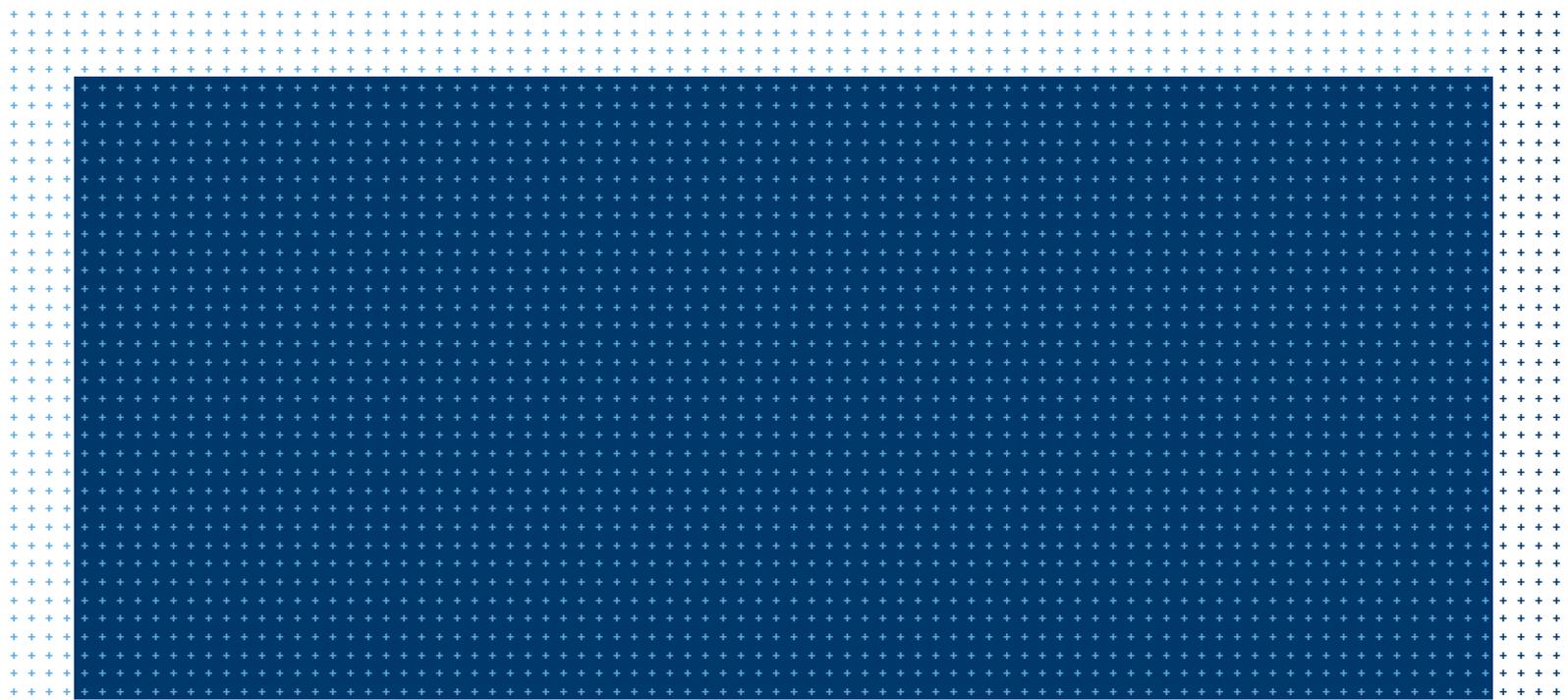
S. 19: Zumtobel Staff GmbH

S. 19: Transparent: Osram GmbH

S. 29: Motorola GmbH

S. 29: Transparent: Freescale Semiconductor Inc.

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.



- + www.suss.de -

